


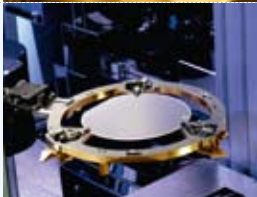

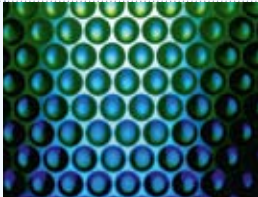
GESCHÄFTSBERICHT 2008



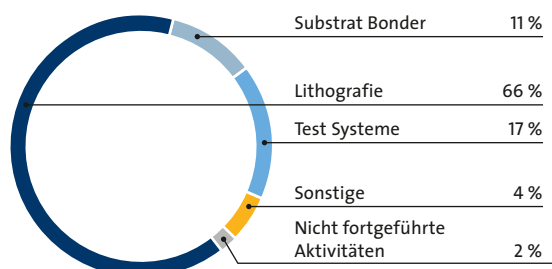
# SÜSS MICROTEC AUF EINEN BLICK

in Mio. €	2008	2007	Veränderung
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
Auftragseingang	139,0	149,7	-7,1 %
Auftragsbestand zum 31.12.	69,7	77,5	-10,1 %
Umsatz gesamt	149,3	145,6	2,5 %
<i>Umsatz Europa</i>	50,2	48,2	4,1 %
<i>Umsatz Nordamerika</i>	39,3	41,2	-4,6 %
<i>Umsatz Japan</i>	15,4	17,9	-14,0 %
<i>Umsatz sonstiges Asien</i>	44,4	38,3	15,9 %
<i>Umsatz Rest der Welt</i>	0,0	0,0	0,0 %
Umsatzrendite	-9,3 %	3,1 %	-12,4 %-Punkte
Rohertrag	46,6	60,9	-23,5 %
Rohertragsmarge	31,2 %	41,8 %	-10,6 %-Punkte
Herstellungskosten	102,7	84,7	21,3 %
Forschungs- und Entwicklungskosten	10,0	12,1	-17,4 %
EBITDA	7,3	10,6	-31,1 %
EBITDA-Marge	4,9 %	7,3 %	-2,4 %-Punkte
EBIT	-11,0	6,0	-183,3 %
EBIT-Marge	-7,4 %	4,1 %	-11,5 %-Punkte
Ergebnis nach Steuern	-13,9	4,5	-308,9 %
Ergebnis je Aktie	-0,82	0,26	-315,4 %
<b>Bilanz</b>			
Eigenkapital	90,6	102,6	-11,7 %
Eigenkapitalquote	59,0 %	62,9 %	-3,9 %-Punkte
Eigenkapitalrentabilität	-15,3 %	4,4 %	-19,7 %-Punkte
Bilanzsumme	153,6	163,1	-5,8 %
Net Cash	9,4	7,6	23,7 %
Free Cashflow	1,9	-7,7	124,7 %
<b>Weitere Kennzahlen</b>			
Investitionen	9,4	11,1	-15,3 %
Investitionsquote	6,3 %	7,6 %	-1,3 %-Punkte
Abschreibungen	18,4	4,7	391,5 %
Mitarbeiter zum 31.12.	674	709	-4,9 %

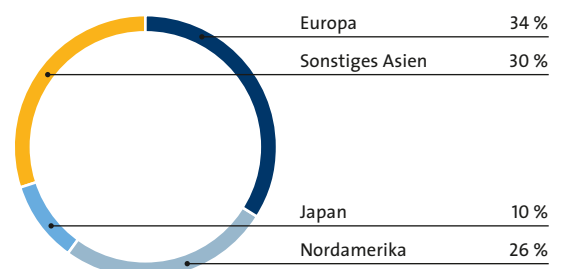
# SÜSS MICROTEC-SEGMENTE

Segmente	Produktlinien	Adressierte Märkte
<p><b>Lithografie</b></p> <p>Umsatz: 98,8 Mio. € Ergebnis: 18,6 Mio. €</p>	<p>Mask Aligner Entwicklungssysteme Spin- und Spray-Coater</p> 	<p>Advanced Packaging Mikrosystemtechnik (MEMS) Verbindungshalbleiter 3D-Integration</p>
<p><b>Substrat Bonder</b></p> <p>Umsatz: 16,1 Mio. € Ergebnis: -6,8 Mio. €</p>	<p>Substrat (Wafer) Bonder</p> 	<p>Mikrosystemtechnik (MEMS) Verbindungshalbleiter 3D-Integration</p>
<p><b>Test Systeme</b></p> <p>Umsatz: 25,0 Mio. € Ergebnis: -2,4 Mio. €</p>	<p>Test Systeme</p> 	<p>Halbleiterindustrie Mikrosystemtechnik (MEMS)</p>
<p><b>Sonstige</b></p> <p>Umsatz: 6,5 Mio. € Ergebnis: -20,5 Mio. €</p>	<p>Masken Mikrooptik und -linsen C4NP</p> 	<p>Mikrooptik Halbleiterindustrie Advanced Packaging (C4NP)</p>

UMSATZ NACH SEGMENTEN  
in %



UMSATZ NACH REGIONEN  
in %



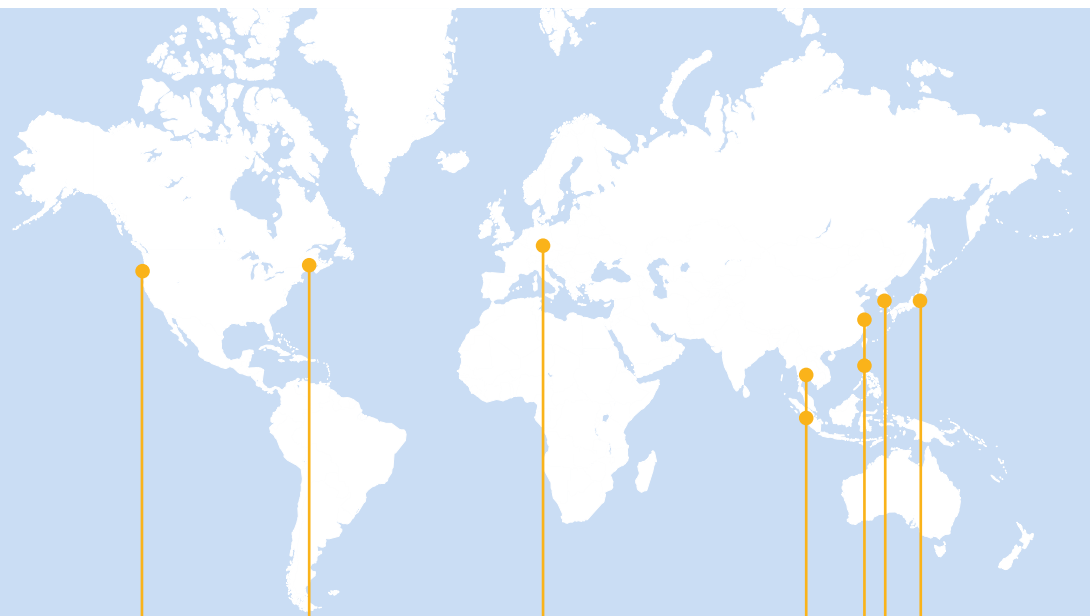
# INHALTSVERZEICHNIS

BRIEF AN DIE AKTIONÄRE .....	2
BERICHT DES AUFSICHTSRATS .....	6
SÜSS-MÄRKTE .....	12
INVESTOR RELATIONS .....	28
CORPORATE GOVERNANCE .....	32
KONZERNLAGEBERICHT .....	43
KONZERNABSCHLUSS .....	81
KONZERNANHANG .....	96
SERVICE .....	154

Our Solutions Set Standards

# SÜSS MICROTEC – WELTWEIT GUT AUFGESTELLT

- Holding
- Produktion
- Vertrieb



- Palo Alto, US
- Waterbury, US
- Garching, DE
- Vaihingen, DE
- Oberschleißheim, DE
- Sacka, DE
- Neuchâtel, CH
- Lyon, FR
- Coventry, UK
- Bangkok, TH
- Singapur, SG
- Shanghai, CN
- Hsin Chu, TW
- Seoul, ROK
- Yokohama, JP

## Nordamerika

Mitarbeiter 2008: 153  
Umsatz 2008: 39,3 Mio. €

## Europa

Mitarbeiter 2008: 418  
Umsatz 2008: 50,2 Mio. €

## Japan

Mitarbeiter 2008: 44  
Umsatz 2008: 15,4 Mio. €

## Sonstiges Asien

Mitarbeiter 2008: 59  
Umsatz 2008: 44,4 Mio. €

# BRIEF AN UNSERE AKTIONÄRE

## Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

2008 war kein einfaches Jahr für die SÜSS MicroTec-Gruppe. Die Krise an den Kreditmärkten, die im Sommer 2007 als „Subprime“-Krise begann, weitete sich im Laufe des Jahres 2008 zur globalen Finanzmarktkrise aus und hat sich insbesondere im zweiten Halbjahr auf die Realwirtschaft niedergeschlagen. Die massiven Auswirkungen zeigten sich zuerst in der Automobilindustrie, aber auch andere Industriesegmente wurden von der globalen Unsicherheit beeinträchtigt. So verzeichnete die weltweite Halbleiterindustrie im Jahr 2008 den ersten Umsatzrückgang im Jahresvergleich seit ihrer Krise im Jahr 2001. Von der Nachfrageschwäche waren laut der SIA (Semiconductor Industry Assoziation) alle Bereiche, insbesondere jedoch die Speicherchip-Hersteller betroffen.

### Das Geschäftsjahr in Zahlen

In diesem schwierigen Umfeld ist es uns gelungen im Jahr 2008 sowohl unsere Umsätze als auch das EBIT vor Sonderbelastungen zu steigern. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 149,3 Millionen Euro und übertraf damit den Vorjahreswert von 145,6 Millionen Euro um 2,5 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde im Jahr 2008 durch Sonderbelastungen in Höhe von 18,3 Millionen Euro insbesondere im immateriellen Anlagevermögen geprägt. Diese einmaligen Abschreibungen waren bis auf 0,8 Millionen Euro jedoch nicht liquiditätswirksam. Vor Berücksichtigung der Sonderbelastungen erhöhte sich das EBIT im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 7,3 Millionen Euro (Vorjahr: 6,0 Millionen Euro). Inklusiv dieser Sonderbelastungen erwirtschaftete die SÜSS MicroTec-Gruppe hingegen ein EBIT von minus 11,0 Millionen Euro. Während Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2008 von den Folgen der Finanzkrise noch unberührt blieben, zeigte sich die zunehmende Investitionszurückhaltung unserer Kunden in der Halbleiterindustrie bereits ab der zweiten Jahreshälfte in deutlich reduzierten Auftragseingängen. Insgesamt erzielte das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Auftragseingang von 139,0 Millionen Euro nach 149,7 Millionen Euro im Vorjahr. Der Auftragsbestand belief sich zum Jahresende auf 69,7 Millionen Euro.

### Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen

Nach einem auftragsseitig starken ersten Halbjahr 2008 haben wir bereits zur Jahresmitte 2008 deutlich geringere Auftragseingänge antizipiert. Unsere Prognose hat sich leider mehr als bestätigt. Mit der Verschärfung der Finanzkrise im September 2008 und den zunehmenden Rezessionsängsten haben wir daher frühzeitig mit der Umsetzung von Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen begonnen. Diese Maßnahmen umfassten sowohl einen unternehmensweiten Einstellungsstopp, generelle Einschränkungen

der Reisetätigkeit, sehr restriktive Budgetierung von Ausgaben für externe Dienstleister sowie die Neu-Analyse und Genehmigung aller Investitionsprojekte. Darüber hinaus wurde die Mitarbeiterzahl im Konzern von vormals 709 auf 674 zum Jahresende reduziert. Zusätzlich sind die Verträge mit rund 50 Leiharbeitern weltweit zum 31. Dezember 2008 beendet worden.

Unser besonderes Augenmerk galt 2008 der Verbesserung der Liquidität und dabei insbesondere dem Management unseres Working Capital. Unterstützend wirkte sich dabei bereits das zum Juli 2008 „live“ gegangene ERP-System auf SAP-Basis aus. Dass wir diesbezüglich auf einem guten Weg sind, zeigt sich u. a. an der positiven Entwicklung unserer Nettoliquidität. Diese verbesserte sich zum Jahresende bereits signifikant auf 9,4 Millionen Euro. Zum Vergleich: am 30.09.08 betrug diese noch 1,5 Millionen Euro. Hieran erkennt man, dass unsere Maßnahmen bereits deutlich Wirkung zeigen. Alles in allem konnten wir unsere Gewinnschwelle zum Geschäftsjahresende auf unter 120 Millionen Euro senken.

#### Meilensteine 2008

Innerhalb der Organisation ergaben sich zudem zahlreiche weitere Neuerungen. So wurden neben der erfolgreichen Einführung des SAP-Systems an den ersten drei deutschen Niederlassungen, die Produktionsstandorte Garching und Vaihingen sowie Waterbury (USA) im abgelaufenen Jahr vom TÜV SÜD gemäß ISO 9001 zertifiziert. Darüber hinaus ist mit dem neugewählten Aufsichtsrat die Struktur des Gremiums verschlankt und verjüngt worden.

Das Unternehmen fokussiert sich mit seinen innovativen Lösungen auf die wachstumsstarken Märkte MEMS, Advanced Packaging, 3D-Integration und Verbindungshalbleiter. Ausgehend von unserem technologisch führenden Produktspektrum an Spezialmaschinen haben wir unser Produktportfolio im Jahr 2008 verjüngt und unsere weltweite Marktposition weiter ausgebaut.

Insgesamt wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr fünf neue Produkte sowie vier neue Module erfolgreich in den Markt eingeführt. Mit der MA300 Gen2 sowie der MA/BA8 Gen3 wurde jeweils die nächste Generation der etablierten Mask bzw. Bond Aligner im Markt positioniert. Das Produktportfolio des Bereichs Lithografie wurde um Nanoimprint-Lösungen für Strukturen <100nm erweitert. Basis ist die eigenentwickelte NIL-Technologie (Nanoimprint-Lithografie) und die gemeinsam mit Philips Research und MiPlaza vorangetriebene SCIL (Substrate Conformal Imprint Lithography) Nanoimprint-Lösung.

Die beiden Neuentwicklungen im Bereich Substrat Bonder, der CBC200 sowie der XBC300, zielen auf die Wachstumsmärkte Advanced Packaging und 3D-Integration und sind für die Produktionsbereiche unserer Kunden zukunftsweisend. Mit der vollständig überarbeiteten Testsystemsteuerung ProberBench™ wurde zudem die zweite Generation einer windowsbasierten Software vorgestellt, die, erweitert um verschiedene Automatisierungstechniken, wesentlich zur Produktivitätssteigerung bei unseren Kunden beiträgt.

#### Ausblick

Neben der Weiterentwicklung unseres Produktportfolios werden unsere Anstrengungen im Jahr 2009 insbesondere der weiteren Kostenreduzierung und der Stärkung der Nettoliquidität gelten. Gleichzeitig werden wir unser weltweites Kundenserviceprogramm weiter ausbauen. Das Ziel ist es, unsere Kunden mit kosteneffizienten Lösungen und einer hervorragenden Unterstützung rund um unsere innovativen Produkte an das Unternehmen zu binden.

Das Jahr 2009 wird jedoch eine Herausforderung für uns und unsere Branche werden. Wir gehen derzeit fest davon aus, im laufenden Geschäftsjahr einen deutlichen konjunktur- und branchenbedingten Umsatzrückgang hinnehmen zu müssen. Dies wird sich auch im Ergebnis 2009 niederschlagen. Eine valide quantifizierbare Prognose ist aufgrund der Unsicherheiten auf den Finanz- und Realmärkten hingegen derzeit nicht möglich. Wir werden uns daher im Rahmen der Quartalsberichterstattungen konkreter zum laufenden Geschäftsjahr äußern.

Abschließend möchten wir uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit für ihren außerordentlichen Einsatz im vergangenen Jahr bedanken. Unser besonderer Dank gilt zudem Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, für Ihr Engagement und Vertrauen in unser Unternehmen.

Wir freuen uns darauf, dass Sie uns auf diesem Weg weiterhin begleiten.

Garching, im März 2009



Frank Averdung  
Vorstandsvorsitzender



Michael Knopp  
Vorstand



Christian Schubert  
Vorstand





von links: Michael Knopp, Christian Schubert, Frank Averdung

# BERICHT DES AUFSICHTSRATS

## Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr intensiv mit der Lage und den Perspektiven des Unternehmens befasst und dabei die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Wir haben den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. Dabei waren wir in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, unmittelbar und frühzeitig eingebunden.

Der Vorstand hat uns regelmäßig sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Form zeitnah und umfassend über die Lage des Unternehmens unterrichtet, vor allem über die Entwicklung der Geschäfts- und Finanzlage (einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements), über die Personalsituation sowie über grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung und -strategie. In den Fällen, in denen die aktuelle Geschäftsentwicklung nicht mit den Plan- und Zielvorgaben übereinstimmte, wurden uns die Abweichungen detailliert erläutert und von uns anhand der erhaltenen Unterlagen überprüft. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats stand ich außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in ständigem Kontakt mit dem Vorstand und wurde über die wesentlichen Entwicklungen im Unternehmen laufend informiert.

Mit dem Beschluss der Hauptversammlung zur Verkleinerung des Aufsichtsrats auf nunmehr drei Mitglieder ist die Frequenz der Plenumsitzungen gestiegen und hat sich der Dialog des Aufsichtsrats mit dem Vorstand quantitativ und qualitativ nochmals intensiviert. Die enge Kommunikation zwischen Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Beratung und Kontrolle seitens des Aufsichtsrats reflektieren auf pragmatische Art und Weise die gestiegenen Herausforderungen, die der globale Wettbewerb und die weltweite Konjunktur-entwicklung im Geschäftsjahr 2008 an das Unternehmen gestellt haben.

In insgesamt neun ordentlichen Sitzungen sowie einer außerordentlichen Sitzung hat sich der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2008 eingehend mit der wirtschaftlichen Lage und der operativen sowie der strategischen Entwicklung des Unternehmens und seiner Geschäftsfelder befasst. Bei den Aufsichtsratssitzungen waren stets alle Aufsichtsratsmitglieder anwesend.

Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind und über die die Hauptversammlung zu informieren ist, sind im Berichtsjahr nicht aufgetreten.



**Dr. Franz Richter**  
Aufsichtsratsvorsitzender

## Arbeit der Ausschüsse

Bis zum Ende der Hauptversammlung am 19. Juni 2008 verfügte der Aufsichtsrat über fünf Ausschüsse: Prüfungsausschuss, Personalausschuss, Technologieausschuss, Finanzierungsausschuss sowie Nominierungsausschuss. Der Nominierungsausschuss bestand aus zwei, der Technologieausschuss aus vier Aufsichtsratsmitgliedern. Die übrigen Ausschüsse setzten sich jeweils aus drei Aufsichtsratsmitgliedern zusammen. Die personelle Besetzung dieser Ausschüsse ist dem Corporate Governance Bericht auf der Seite 38 dieses Geschäftsberichts zu entnehmen.

Der Personalausschuss hat im Berichtsjahr zweimal, am 15. Februar 2008 (Telefonkonferenz) sowie am 26. März 2008, getagt. Der Nominierungsausschuss trat in Vorbereitung auf die anstehenden Aufsichtsratsneuwahlen im Vorfeld der Hauptversammlung insgesamt sechsmal (15. Februar, 22. Februar, 7. März, 11. März, 12. März und 15. April 2008) zusammen. Der Bilanzausschuss tagte im Berichtsjahr am 26. März 2008 und beschäftigte sich im Wesentlichen mit der Prüfung des Jahres- sowie des Konzernabschlusses der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2007. Die Ausschüsse haben dem Plenum regelmäßig berichtet.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 wurde der Aufsichtsrat auf drei Mitglieder verkleinert. Die diesbezügliche Satzungsänderung wurde am 10. Juli 2008 in das Handelsregister eingetragen. Nach Beratungen im Aufsichtsratsplenum sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass die Bildung von Ausschüssen aufgrund der nunmehr geringen Mitgliederzahl nicht länger notwendig ist. Diesbezügliche Abweichung von der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex haben wir in der gemeinsam mit dem Vorstand am 7. November 2008 verfassten Entsprechenserklärung ausgewiesen und auf der Website der Gesellschaft öffentlich zugänglich gemacht.

## Sitzungen und Beratungsschwerpunkte im Aufsichtsrat

In der Sitzung am 26. März 2008 billigte der Aufsichtsrat nach eingehender Prüfung den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2007. Der Abschlussprüfer nahm an dieser Sitzung teil und informierte den Aufsichtsrat über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung. Des Weiteren erfolgte die Besprechung der Tagesordnungspunkte sowie der Beschlussvorschläge für die ordentliche Hauptversammlung am 19. Juni 2008. Weiterhin war die steuerliche Optimierung der Konzernstruktur Thema der Beratungen im Plenum. Im Wesentlichen handelte es sich hierbei um die Einbringung der Anteile an der Tochtergesellschaft Image Technology Inc., Palo Alto, USA, in die Süss MicroTec Inc., Waterbury, USA.

Am 19. Juni 2008, im Vorfeld der ordentlichen Hauptversammlung, befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Bericht des Vorstands zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2008 und stimmte dem Abschluss des neugefassten Mietvertrags mit der Süss Grundstücksverwaltungs GbR für den Produktionsstandort Garching bei München zu.

Am 19. Juni 2008, im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung, trat der neu gewählte Aufsichtsrat erstmals zusammen. In seiner konstituierenden Sitzung wählte der Aufsichtsrat Herrn Dr. Franz Richter zum Vorsitzenden sowie Herrn Dr. Stefan Reineck zu seinem Stellvertreter.

Die Diskussion strategischer Projekte, insbesondere die Zukunftsfähigkeit einzelner Geschäftsbereiche im Konzern sowie der im Zuge einer Portfoliooptimierung geplante Verkauf des Geschäftsbereichs Test Systeme waren Thema der Sitzung am 25. Juni 2008.

In der Sitzung am 25. Juli 2008 befassten wir uns mit dem Bericht des Vorstands zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2008 und haben uns darüber hinaus die Entwicklungen betreffend C4NP sowie die Initiativen zur Restrukturierung der Süss MicroTec Inc., Waterbury, USA, und der Vertriebsgesellschaften in Asien näher erläutern lassen. Des Weiteren stimmten wir nach umfassender Beratung dem geplanten Verkauf des Geschäftsbereichs Test Systeme zu.

Restrukturierungs- sowie Kostensenkungsmaßnahmen waren auch Thema auf der Aufsichtsratsitzung am 5. September 2008. Dort stimmten wir der Veräußerung des von Süss MicroTec Inc. an der Süss Test Systems GmbH gehaltenen Anteils von 50 % an die SÜSS MicroTec AG zu. Dieser Schritt erfolgte aus Gründen der Vereinfachung der Konzernstruktur. Darüber hinaus war die Besprechung strategischer Kooperationsprojekte sowie des aktuellen Forecast für das Geschäftsjahr 2008 Bestandteil dieser Aufsichtsratsitzung.

Hauptgegenstand der Sitzung am 2. Oktober 2008 war der Bericht des Vorstands zum Stand der SAP-Einführung nach dem am 1. Juli 2008 erfolgten Going Live bei drei Konzerngesellschaften. Weiterhin beschäftigten wir uns mit der Geschäftsentwicklung der SÜSS MicroTec-Gruppe im dritten Quartal 2008 sowie den möglichen Sonderbelastungen der SÜSS MicroTec-Gruppe. In diesem Zusammenhang haben wir auch die Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise auf die SÜSS MicroTec AG erörtert. Darüber hinaus beschloss der Aufsichtsrat in dieser Sitzung die Abberufung von Herrn Dr. Stefan Schneidewind aus dem Vorstand der SÜSS MicroTec AG sowie die sofortige Bestellung von Herrn Christian Schubert in den Vorstand der Gesellschaft.

In der Sitzung am 7. November 2008 hat uns der Vorstand über die endgültigen Finanzzahlen des dritten Quartals sowie über den aktualisierten Forecast 2008 informiert. Im Anschluss daran standen Beratungen zur Finanzierung der SÜSS MicroTec-Gruppe sowie zur Neufassung der Entsprechungserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex auf der Tagessordnung. Darüber hinaus stimmten wir der Verlängerung des Mietvertrags für eine kleine Lagerhalle am Firmensitz in Garching zu.

Gegenstand der außerordentlichen Sitzung am 21. November 2008, die in Form einer Telefonkonferenz stattfand, waren Beratungen hinsichtlich der geplanten Bestellung eines Vorstandsvorsitzenden.

Themenschwerpunkt der Sitzung am 12. Dezember 2008 waren der Geschäftsverlauf im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2008 sowie die Planungen für das Jahr 2009. In dem Zusammenhang erläuterte der Vorstand detailliert den Stand der Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen im Konzern sowie die Fortschritte bei der Optimierung des Einkaufs- und Bestandsmanagements. Darüber hinaus waren Strategieüberlegungen für das Jahr 2009 sowie die Diskussion der Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf die Geschäftstätigkeit der SÜSS MicroTec AG Themen unserer Sitzung.

## Corporate Governance und Entsprechenserklärung

Der Aufsichtsrat hat sich mit der Umsetzung des Deutschen Corporate Governance Kodex befasst. Über die Corporate Governance bei SÜSS MicroTec berichten Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam im Corporate Governance Bericht auf den Seiten 32 bis 42 des Geschäftsberichts.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind nach Überzeugung des Aufsichtsrats hinreichend unabhängig.

## Jahres- und Konzernabschlussprüfung

Am 19. Juni 2008 wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, von der Hauptversammlung zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 gewählt. Die Beauftragung durch den Aufsichtsrat erfolgte am 4. Dezember 2008. Der Abschlussprüfer hat den nach HGB aufgestellten Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG und den nach IFRS aufgestellten Konzernabschluss sowie den gemeinsamen Lagebericht für die AG und den Konzern unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Zum bestehenden Risikofrüherkennungssystem stellte der Abschlussprüfer fest, dass der Vorstand die nach § 91 Abs. 2 AktG geforderten Maßnahmen getroffen hat und das Überwachungssystem seine Aufgaben erfüllen kann.

Jahres- und Konzernabschluss nebst Lageberichten wurden jedem Aufsichtsratsmitglied nach Aufstellung durch den Vorstand ausgehändigt. Die Berichte des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers wurden uns rechtzeitig übermittelt.

Der Abschlussprüfer hat an den Bilanzsitzungen des Bilanzausschusses und des Aufsichtsrats am 24. März 2009 teilgenommen und berichtete dort über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung. Insbesondere hat er Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns abgegeben und uns für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft, der Konzernabschluss sowie der gemeinsame Lagebericht wurden von uns sorgfältig geprüft. Es bestanden keine Einwände. Die Berichte des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers haben wir nach eingehender Prüfung zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. Der vom Vorstand aufgestellte Konzernabschluss wurde ebenfalls gebilligt. Dem gemeinsamen Lagebericht für die AG und den Konzern und insbesondere der Beurteilung der weiteren Entwicklung des Unternehmens haben wir zugestimmt.

## Personalien

Mit Wirkung zum 2. Oktober 2008 hat der Aufsichtsrat den Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Stefan Schneidewind aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die weitere strategische Ausrichtung der Gesellschaft abberufen. Parallel dazu bestellten wir Herrn Christian Schubert als neues Mitglied in den Vorstand der SÜSS MicroTec AG.

Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endete mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Juni 2008. Die Herren Dr. Winfried Süß, Gerhard Rauter, Prof. Dr. Anton Heuberger, Peter Heinz und Heinz-Peter Verspay sind aus dem Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ausgeschieden. Herr Dr. Stefan Reineck, der bereits seit Oktober 2007 dem Aufsichtsrat der Gesellschaft angehörte, wurde in den Aufsichtsrat wiedergewählt. Neu wurden Herr Jan Teichert und Herr Dr. Franz Richter zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG gewählt. Der neu konstituierte Aufsichtsrat wählte Herrn Dr. Franz Richter zum Vorsitzenden und Herrn Dr. Stefan Reineck zum stellvertretenden Vorsitzenden.

Unser persönlicher Dank gilt den ausgeschiedenen Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern für ihre wertvollen Beiträge zum Unternehmenserfolg. Darüber hinaus bedanken wir uns beim Vorstand, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Arbeitnehmervertretungen für das außerordentliche Engagement im abgelaufenen, schwierigen Geschäftsjahr.

Garching, 24. März 2009

Für den Aufsichtsrat



Dr. Franz Richter  
Aufsichtsratsvorsitzender



## WACHSTUMSMARKT

# LED +18 %

Hohe Leuchtkraft, geringer Energieverbrauch, lange Lebensdauer sowie ein breites Farbspektrum machen LEDs nicht nur für Straßenbeleuchtungen und Werbedisplays attraktiv. Insbesondere in neuen Flachbildschirmen und LCD-Fernsehern findet die LED-Technologie heute verstärkt Einsatz. Durchschnittlich rund 18 % soll der LED-Markt über die nächsten vier Jahre weltweit wachsen.





# DER MARKT FÜR VERBINDUNGSHALBLEITER

## LEDS – KOMPAKT, LANGLEBIG, FARBECHT.

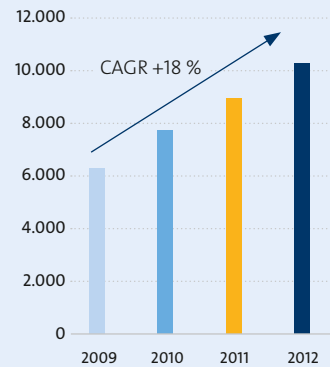
Vor rund 130 Jahren revolutionierte die Glühbirne von Edison unseren Alltag und blieb lange Jahre konkurrenzlos im Beleuchtungsmarkt. Erst im Jahr 1962 stellte General Electric eine Technologie vor, die das Potenzial zur Nachfolgerin der Glühbirne besaß: die Leuchtdiode (Light Emitting Diode = LED). Die hohen Herstellungskosten sowie die anfangs begrenzte Farbvielfalt bremsen jedoch den frühen Markterfolg. Erst zehn Jahre nach Erfindung der ersten „roten“ Leuchtdiode gelang es auch gelbe, grüne und orange Leuchtdioden zu fertigen. Es dauerte dann aber noch bis in die neunziger Jahre hinein, bis es schließlich auch gelang, blaue und weiße LEDs herzustellen. Die Erweiterung des Farbspektrums sowie vor allem Effizienzsteigerungen in den Herstellungsprozessen und die damit einhergehende preiswertere Fertigung der Halbleiter, auf der die LED-Technologie beruht, waren hingegen die Voraussetzung für den anschließenden Markterfolg der Technologie. Die Nachfolgerin der Glühbirne basiert auf den optoelektronischen Eigenschaften von Verbindungshalbleitern, die den elektrischen Strom mit sehr hoher Effizienz in Licht umwandeln.

Bereits heute hat die Leuchtdiode zu einschneidenden Veränderungen in der Beleuchtungswelt geführt. Nicht mehr nur in Verkehrsampeln, Außenbeleuchtungen und Reklametafeln finden die wartungsarmen LEDs Einsatz. Dank ihres geringen Gewichts, ihrer hohen Belastbarkeit sowie ihrer Unempfindlichkeit gegenüber Stößen und Vibrationen, empfehlen sie sich insbesondere für den Einsatz in mobiler Kleinelektronik, wie PDAs, MP3-Playern und Handys sowie in der Fahrzeugbeleuchtung. Darüber hinaus finden LEDs aufgrund ihrer deutlich höheren Lichtausbeute und ihres breiteren sowie exakt kalibrierbaren Farbspektrums insbesondere im Markt für moderne Flachbildschirme und Laptopdisplays zunehmend Anwendung. Aber auch in öffentlichen sowie privaten Haushalten setzt sich das „schönere“ Licht, aufgrund neuer ästhetischer Lampen- und Beleuchtungsformen, zunehmend durch (z. B. in Museen und Galerien als Vitrinenbeleuchtung). Unterstützt wird dieser Trend nicht zuletzt durch die anhaltende Umweltdiskussion: Leuchtdioden verbrauchen bei gleicher Helligkeit rund 80 Prozent weniger Strom als herkömmliche Halogenlampen und haben eine 50-fach bzw. 6-fach so lange Lebensdauer wie Glühbirnen bzw. Leuchtstoffröhren.

Mit Verabschiedung der EU-Verordnung vom 8. Dezember 2008 erhält der Markt für LEDs zudem zusätzliche Unterstützung. Laut der neuen EU-Verordnung sollen Glühbirnen ab dem Jahr 2009 schrittweise durch die

**DER LED-MARKT**

in Mio. USD




Quelle: Yole Développement, Januar 2009

effizienteren Energiesparlampen ersetzt werden. Bereits ab dem 1. September 2009 dürfen matte und klare Glühbirnen ab 100 Watt nicht mehr vertrieben werden. Für kleinere klare Glühlampen gilt dies spätestens ab dem Jahr 2012. Ab September 2016 gelten dann für alle Haushaltslampen Effizienzanforderungen der Effizienzklasse B, denen selbst dann auch viele herkömmliche Halogenlampen nicht mehr genügen dürften. Diese europaweite Verordnung wird dazu führen, dass weltweit vorhandene Fertigungskapazitäten schon bald nicht mehr ausreichen werden.

Das Marktforschungsinstitut iSuppli Corporation schätzt daher, dass der Markt für LEDs auch im wirtschaftsschwachen Jahr 2009 und entgegen dem Trend im Halbleitermarkt um rund 3 Prozent wachsen wird. Wesentlicher Wachstumstreiber wird laut iSuppli vor allem der LCD-TV Markt sein. Das französische Marktforschungsinstitut Yole Développement prognostiziert über die nächsten vier Jahre ein durchschnittliches jährliches Wachstum im weltweiten LED-Markt von rund 18 Prozent mit einem weltweiten Umsatz im Jahr 2012 von rund 10 Milliarden USD.

Mit der Entwicklung und Produktion von Anlagen, die die wirtschaftliche Herstellung von höherwertigen und lichtstarken LEDs (sogenannten Ultra High Brightness LEDs = UHB LEDs) in verschiedenen Farben ermöglichen, arbeitet SÜSS MicroTec bereits seit Jahren an der Zukunft des neuen Lichts mit. Dabei verfügt SÜSS MicroTec in allen Produktlinien, Mask Aligner, Coater, Developer, Bonder und Test Systeme, über spezielle Handlungslösungen für die zum Einsatz kommenden extrem empfindlichen Verbindungshalbleiter. Bei der Fertigung der eigentlichen LED-Chips, bei der unterschiedliche Materialschichten übereinander gestapelt werden, sind Wafer Bonder von SÜSS MicroTec führend. Dank des patentierten Multi-Bond-Verfahrens können Bonder von SÜSS MicroTec bis zu acht Waferpaare gleichzeitig in einem einzigen Produktionsschritt verbinden. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal für SÜSS MicroTec, das dazu beiträgt den Durchsatz zu erhöhen und die Produktionskosten niedrig zu halten.

 Weiterführende Informationen finden Sie unter [www.suss.com](http://www.suss.com)  
> Märkte > Verbindungshalbleiter/LED

Bei der hochvolumigen Herstellung von LEDs greifen Produktionskunden, gerne auf die integrierten Lithographielösungen von SÜSS MicroTec zurück. So werden mit dem LithoFab200, einem kombinierten Coater, Entwickler und Mask Aligner, schon seit Jahren sogenannte High Brightness und Ultrabrightness LEDs in Großserie hergestellt. Dank des effizienten Zusammenspiels von Coater, Developer und Mask Aligner werden Prozessschritte minimiert, Durchlaufzeiten erhöht und die Produktionskosten für den Kunden gesenkt.



## WACHSTUMSMARKT

# MEMS +25 %

Sie messen und steuern unseren mobilen Alltag, bieten in Autos mehr Sicherheit und sorgen, in modernen Spielekonsolen verbaut, für mehr Spaß: MEMS-Bauteile. Die sensiblen Sensoren erschließen dank ihrer zuverlässigen Funktionsweise und kostengünstigen Herstellung immer mehr Anwendungsgebiete. Für die nächsten vier Jahre wird dem MEMS-Markt ein durchschnittliches Wachstum von rund 25 % vorausgesagt.



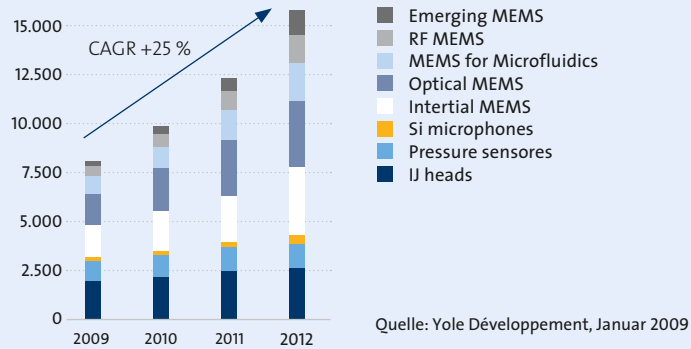
# DER MARKT FÜR DIE MIKROSYSTEMTECHNIK

## MEMS – KOMPAKT, EMPFINDLICH, KOSTENGÜNSTIG.

Der Markt für die Mikrosystemtechnik (MEMS – Micro Electro Mechanical Systems) ist einer der wichtigsten für die SÜSS MicroTec-Gruppe. MEMS-Bauteile integrieren sowohl mechanische als auch elektronische Komponenten auf einem gewöhnlichen Silizium-Wafer und haben dank ihrer zuverlässigen Funktionsweise, ihrer Kompaktheit und der günstigen Herstellung auf vielfältige Weise Einzug in unser tägliches Leben erhalten. Im Auto sorgen Mikrosysteme in Form von Reifendruck- oder Airbagsensoren für mehr Sicherheit oder verhelfen uns als Regensensor zu mehr Komfort. Integriert in Blutzuckermessgeräten von Diabetikern oder in Endoskopsystemen und sonstigen Instrumenten der minimal-invasiven Chirurgie kann moderne Mikrosystemtechnik sogar Leben retten. Aber auch Zuhause finden die kleinen Bauteile verstärkt Anwendung, z. B. wirken sie als Antenne in Mobiltelefonen oder als Bildstabilisator in Fotokameras und neuerdings als Beschleunigungsmesser in modernen Spielekonsolen wie der Nintendo Wii. Die empfindlichen Trägheitssensoren erlauben es Systemplanern, ihren Produkten immer neue Fähigkeiten hinzuzufügen, und erobern so stetig neue Anwendungsgebiete. Unserem Auge bleiben die mikroelektronischen Bauteile hingegen nahezu verborgen. Mit einer Größe von nur wenigen Mikrometern – ein Mikrometer entspricht einem tausendstel Millimeter – sind die Bauteile mit dem bloßen Auge nur schwer erkennbar.

Während das menschliche Auge Strukturen kleiner 5 Mikrometern erst gar nicht erfassen kann, erfolgt die Herstellung der winzigen Bauteile auf immer geringerem Raum. Auf einer Waferfläche von 1 cm<sup>2</sup> können aktuell bis zu etwa 100 Millionen elektrische Bauelemente enthalten sein. Um die Wirkungsweise eines jeden einzelnen dieser zahlreichen Mikrochips (auch IC genannt – Integrated Circuit) zu verstehen, kann man sich ihn als Schaltstelle oder gar gleich als Gehirn eines Systems vorstellen. Die mikromechanischen oder mikroelektronischen Komponenten hingegen verkörpern die Sinnesorgane, die die Reize aus ihrer Umwelt wahrnehmen und an das „Gehirn“ weitergeben. Je nach Design nehmen MEMS-Bauteile mechanische, thermische, biologische, chemische, optische oder auch magnetische Phänomene aus ihrer Umgebung auf und leiten diese an den IC weiter. Dieser verarbeitet die Informationen und löst die gewünschte Aktion (z. B. Aufblasen des Airbags) aus.

**DER MEMS-MARKT**  
in Mio. USD



Dank ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten wächst der Markt für Mikrosystemtechnik seit vielen Jahren kontinuierlich. Waren in den vergangenen Jahren insbesondere Tintendruckköpfe und Drucksensoren die starken Wachstumstreiber im MEMS-Markt, so werden in den kommenden Jahren laut dem Marktforschungsinstitut Yole Développement insbesondere neue Technologien wie beispielsweise Siliziummikrophone, Mikrobrennstoffzellen und Energiespeicherchips die maßgeblichen Wachstumstreiber sein. Über die nächsten vier Jahre prognostiziert Yole Développement daher ein durchschnittliches jährliches Wachstum im MEMS-Markt von rund 25 Prozent.

SÜSS MicroTec bietet speziell für die MEMS-Fertigung Maschinen wie Spin-Coater, Mask Aligner, Substrat Bonder und Testsysteme an, die dank höchster mechanischer Präzision und exakter Prozesskontrolle eine hochvolumige und kostengünstige Produktion bei unseren Kunden unterstützen. Im Geschäftsjahr 2008 neu vorgestellt, wurde der vollautomatische Wafer (Substrat) Bonder CBC200, der speziell für die MEMS-Fertigung konzipiert wurde und sich dank seiner Eigenschaften, extremen Druck- und Temperaturverhältnissen von 90 kN bzw. bis zu 600°C standzuhalten, besonders für die Herstellung von Mikrosystemtechnik für die Automobil- und Elektronikindustrie empfiehlt.

Ebenfalls neu im Programm ist der halbautomatische Mask Aligner MA / BA8 Gen3, der neben innovativen Anwendungen wie das Prägen von Mikrolinsen oder Nanotechnologie auch sehr erfolgreich für den Bereich MEMS eingesetzt wird. Neben hoher Präzision, Effizienz und einer stark erweiterten Funktionalität zeichnet sich die dritte manuelle Mask Aligner Generation von SÜSS MicroTec durch die Fähigkeit aus, selbst bei sehr dicken Lackschichten wie Gräben oder steilen Kanten noch einzigartige Belichtungsergebnisse zu erzielen. Eine Fähigkeit, die im Bereich MEMS, wo es darum geht sehr tiefe Strukturen im Wafer herzustellen, zur Kernkompetenz von SÜSS MicroTec gehört.

Hand icon: Weiterführende Informationen finden Sie unter [www.suss.com](http://www.suss.com)  
> Märkte > MEMS/Nanotechnologie

Hinzu kommt, dass in der Mikrosystemtechnik häufig neue Werkstoffe und Materialien eingesetzt werden, die zuerst eine Erprobungsphase in der Forschung durchlaufen müssen, bevor sie in der Volumenproduktion eingesetzt werden können. Der neue MA / BA8 wurde speziell für diesen Bereich, die sogenannte angewandte Forschung, entwickelt. Da manuelle und Produktions-Systeme von SÜSS MicroTec generell auf denselben Technologien basieren, können Prozesse aus dem Forschungslabor direkt und ohne Probleme in die Massenfertigung übernommen werden. Damit ist SÜSS MicroTec in der Lage seine MEMS-Kunden von der Entwicklung eines Prozesses bis zur Serienfertigung mit hochwertigem Equipment zu begleiten.

## WACHSTUMSMARKT

# ADVANCED PACKAGING +20 %

Kleiner, leichter, leistungsstärker – die neuen Multifunktionshandys geben wir nicht mehr aus der Hand. Dank moderner Fertigungsverfahren wie dem Advanced Packaging sind Chip-Hersteller in der Lage, zunehmend mehr Leistung auf immer kleinerem Raum unterzubringen. Über die nächsten vier Jahre soll der Markt für Advanced Packaging-Anwendungen durchschnittlich 20 % wachsen.





# DER MARKT FÜR ADVANCED PACKAGING

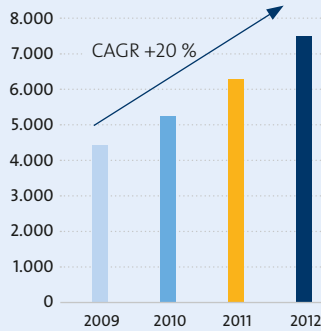
## ADVANCED PACKAGING – MARKT UND FERTIGUNGSTECHNOLOGIE ZUGLEICH

Kaum einer kann sich heute noch vorstellen, ohne Handy aus dem Haus zu gehen. Längst ist das Handy von einem ehemaligen reinen „Mobiltelefon“ zu einem praktischen Multimedia- und Business-Tool herangereift und erfüllt bei ständig reduzierter Größe immer mehr Funktionen. Moderne Handys ersetzen nicht nur Fotoapparate und Videokameras, sondern gleichen Termine und Kontakte mit dem PC ab, spielen MP3s ab, navigieren uns durch den Stadtverkehr und empfangen E-Mails oder ermöglichen den Zugang zum Internet. Für die Halbleiterhersteller sind die hohen Leistungsanforderungen hingegen eine echte Herausforderung an das Chipdesign: Gesteigerte Leistung auf immer geringer werdendem Raum umzusetzen erfordert eine stetige Weiterentwicklung der Fertigungstechnologien.

Eine dieser neueren Fertigungstechnologien, das Advanced Packaging, betrifft den Bereich der Chip-Verpackung und ist gleichzeitig einer der beiden wichtigsten Märkte für SÜSS MicroTec. Das Advanced Packaging ist eine alternative Verpackungstechnik zum klassischen „Umverdrahten“ (engl. Wire-Bonding), bei der die ICs platzsparend und direkt, mit hoher Anschlussdichte mit dem jeweiligen Substrat verbunden werden. Während beim klassischen Wire-Bonding die Mikroprozessoren zunächst aus dem Wafer ausgesägt, mit ihrem Gehäuse verdrahtet und getestet werden, findet beim Advanced Packaging die Kontaktierung des Halbleiterchips mit dem Substrat (auch Leiterplatte oder Platine genannt) schon auf Wafer-Ebene und damit noch vor der Vereinzelung statt. Anstelle der üblichen Leitungsdrähte werden beim Advanced Packaging sogenannte Lotkügelchen (engl. Bumps) submikrometergenau auf die fertiggestellten Mikroprozessoren aufgebracht, die dann als elektrischer Kontakt dienen. Die Vorteile dieser Technologie liegen im Erreichen von höheren Packungsdichten, der Platzeinsparung sowie der verbesserten elektrischen Leitung und der optimierten Wärmeableitung. Zur Anwendung kommen Advanced Packaging-Prozesse insbesondere bei der Herstellung von Hochleistungsmikroprozessoren, Graphikchips, Image Sensoren (Bildsensoren) und „Wireless Anwendungen“, die wiederum Einzug in modernen Computern, Mobiltelefonen, PDAs und Spielekonsolen wie der Sony Playstation oder der Microsoft X-Box erhalten.

MARKT FÜR WAFER LEVEL (ADVANCED) PACKAGING

in Tsd.  
200 mm Wafern




Quelle: TechSearch International, September 2008

Ein Wafer hat bis zum Zeitpunkt der „Verpackung“ meist mehrere Bearbeitungswochen und bis zu 250 Fertigungsschritte durchlaufen. Aufgrund dieser bereits erfolgten hohen Wertschöpfung kann ein Wafer dann durchaus den Wert eines durchschnittlichen Eigenheims besitzen. Die Anforderungen an das „Verpackungs“-Equipment, das dann zum Einsatz kommt, sind in Folge dessen extrem hoch: äußerste Präzision und Zuverlässigkeit sind gefragt, damit eine möglichst geringe Fehlerquote und damit eine möglichst hohe Ausbeute erreicht wird.

Die von SÜSS MicroTec eigens für Advanced Packaging-Prozesse entwickelten Lithografie-Systeme werden bereits seit einem Jahrzehnt erfolgreich im Markt eingesetzt und seitdem ständig weiterentwickelt. SÜSS MicroTec liefert innerhalb der Produktlinien Mask Aligner, Coater und Developer sowohl Einzelsysteme als auch ganze Systemlösungen, sogenannte Cluster, in denen mehrere Prozessschritte integriert sind. Im Vergleich zu den Belichtungssystemen der konkurrierenden Steppertechnologie bieten die Mask Aligner von SÜSS MicroTec einen höheren Durchsatz bei gleichzeitig geringeren Anschaffungskosten. Aufgrund ihrer innovativen, hochauflösenden Optik und ihrer hohen Justiergenauigkeit sind SÜSS-Mask Aligner mittlerweile in der Lage immer kleinere Strukturen, bis in den Submikrometerbereich hinein, zu übertragen. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, den steigenden Forderungen der Industrie nach immer kleineren und leistungsfähigeren Bauteilen auch in Zukunft entsprechen zu können. Optimal ergänzt werden die Belichtungssysteme durch die Spin Coater von SÜSS MicroTec, die zu den effektivsten und flexibelsten Produktionssystemen im Wafer Level Packaging Segment zählen. Dank ihrer Fähigkeit Wafer mit unterschiedlichen Größen gleichzeitig, ohne Zeitaufwand durch kostenintensives Umrüsten der Maschine zu verarbeiten, erhöhen sie den Durchsatz insbesondere bei Kunden, die unterschiedliche Prozesse auf ihren Systemen fahren.

In den letzten Jahren hat sich durch das Advanced Packaging der Druck auf Skalierung, Gewicht, Zuverlässigkeit, Kosten und Geschwindigkeit der elektronischen Bauteile stark verschärft. Hinzu kommen neue Ansprüche an die Umweltverträglichkeit der Materialien. Dies führte zu einer allmähliche Verlagerung vom traditionellen Drahtbonden zum Advanced Packaging als bevorzugte Methode für das Verbinden von Halbleiterchips mit einem Chipträger oder einer Leiterplatte. Dieser Trend wird sich laut des Marktforschungsinstituts TechSearch auch in kommenden Jahren weiter fortsetzen, wenn auch die Prognosen aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Weltwirtschaft schwierig bleiben.

 Weiterführende Informationen finden Sie unter [www.suss.com](http://www.suss.com)  
> Märkte > Wafer Level Packaging





## WACHSTUMSMARKT

# 3D-INTEGRATION +82 %

Wenn Raum knapp wird, baut man in die dritte Dimension. In unseren modernen, leichten mobilen Endgeräten ist der Platz für Speicherchips ein zunehmend rares Gut. Die dreidimensionale Integration vieler verschiedener Bauelemente gilt als zukunftsweisend für die Chipindustrie. Schätzungen zufolge soll dieser junge Markt in den kommenden vier Jahren durchschnittlich mit 82 % wachsen.

# DER MARKT FÜR 3D-INTEGRATION

## 3D-INTEGRATION – STAPELN STATT SKALIEREN FÜR MEHR LEISTUNG

Im Jahr 1965 stellte Gordon Moore die These auf, wonach sich die Komplexität integrierter Schaltkreise alle zwei Jahre verdoppeln sollte. Bislang behielt Moore mit seiner These recht. Die stetige Nachfrage nach immer leistungsfähigeren und dabei schlankeren sowie leichteren mobilen Endgeräten, stellt immer höhere Anforderungen an die Halbleiterhersteller und führte zu stetig höheren Skalierungen. Schließlich galt es, auf immer geringerem Raumangebot eine steigende Zahl an Funktionen unterzubringen. Dieser Trend ist heute ungebrochen. Mit Strukturgrößen von aktuell 32nm (Nanometer) ist die Branche jedoch an einem Punkt angelangt, von wo aus weitere Komplexitätssteigerungen wesentlich schwerer umsetzbar und vor allem nur zu einem überproportionalen Kostenaufwand möglich sein werden. Die Migration von 32nm auf 16nm könnte daher bis zum Jahr 2019 dauern. Bei der Suche nach alternativen Fertigungstechnologien haben sich dreidimensionale Chipdesigns zu einer echten Alternative gegenüber herkömmlichen 2D-Designs herauskristallisiert.

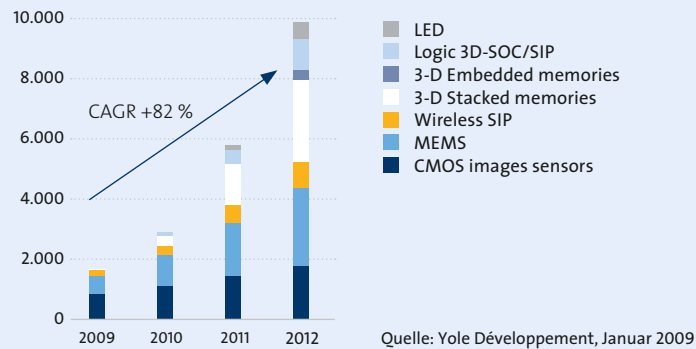
Bei der sogenannten 3D-Integration werden einzelne Bauteile übereinander gestapelt und elektrisch miteinander verbunden. Dabei lässt sich zwischen zwei verschiedenen Verfahren unterscheiden: dem 3D-Packaging und 3D-Interconnect. Beim 3D-Packaging werden die betreffenden Bauteile noch auf Wafer Level Packaging-Ebene gestapelt und mittels Umverdrahtung (engl. Wire-Bonding) miteinander verbunden. Beim sogenannten 3D-Interconnect werden die vertikal angeordneten Bauteile hingegen mittels Durchkontaktierungen („Through Silicon Vias“) durch das in der Regel stark gedünnte Silizium miteinander verbunden.

Die Vorteile dieser 3D-Technologie, insbesondere beim 3D-Interconnect, liegen in der gesteigerten Leistungsfähigkeit je Grundflächeneinheit, dem reduzierten Energieverbrauch sowie in dem geringeren Packaging-Aufwand. Darüber hinaus bietet das 3D-Interconnect eine höhere Flexibilität hinsichtlich der zu integrierenden Bauteile. So könnten sich zukünftig auf diese Weise unterschiedliche Bauteile, wie z. B. Speicherchips, Logicchips und Bildsensoren, in einem Verbund integrieren lassen.

Während die heterogene Integration noch Zukunftsmusik ist, werden jedoch schon heute CMOS-Bildsensoren sowie Flash-Speicher mittels 3D-Technologie gefertigt. Treiber dieser neuen Technologie ist vor allem der stetig wachsende Markt für moderne Unterhaltungselektronik. Mobiltelefone sind hierfür ein klassisches Beispiel. Während die ersten Handys nicht viel mehr als die reine Telefonfunktion boten, sind heute rund

### DER MARKT FÜR 3D-INTEGRATION

in Mio. Stk.



80 Prozent aller Mobiltelefone mit einer Foto- oder sogar Videokamera ausgestattet. Im Gegensatz zu den ersten Kamerahandys bieten die heutigen Modelle nahezu dieselbe Auflösung und Bildqualität wie traditionelle Fotoapparate und verfügen zudem standardmäßig über Funktionen wie Autofokus, Optischer Zoom und Bildstabilisatoren sowie ein integriertes Xenon-Blitzlicht. Diese gestiegene Komplexität ist technologisch nur mithilfe der 3D-Integration möglich. Hersteller von CMOS-Bildsensoren gehören daher zu den ersten Unternehmen, die bereits mit 3D-Technologie produzieren.

Die weltweite Stückzahl 3D-gefertigter Bauteile fiel im Jahr 2008 mit rund 850 Millionen Stück noch verschwindend gering aus, was u. a. daran liegt, dass sich derzeit noch kein Produktionsstandard für die 3D-Integration herausgebildet hat. Die Verfügbarkeit von 300mm-3D-Produktionsanlagen für die Volumenproduktion ist laut dem französischen Marktforschungsinstitut Yole Développement jedoch nur eine Frage der Zeit. Bis zum Jahr 2012 prognostiziert das Marktforschungsinstitut hingegen ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 82 Prozent auf rund 9,8 Milliarden. Den Schätzungen der Analysten zufolge könnte die Technologie im Jahr 2015 bereits rund 6 Prozent des gesamten Halbleitermarkts und gut ein Viertel des Speichermarktes ausmachen.

SÜSS MicroTec bietet bereits heute Lösungen für die 3D-Integration an. Zur Herstellung der Through-Silicon-Vias („TSVs“) gehören das Ätzen und das anschließende Füllen des durchkontaktierten Via-Bereichs. Bevor die Vias jedoch geätzt werden können, wird die Ätzmaske mittels Coating, Justage und Belichtung hergestellt. Für diese Prozessschritte werden die hochpräzisen Mask Aligner und Coater von SÜSS MicroTec zunehmend erfolgreich eingesetzt.

Im Geschäftsjahr 2008 brachte SÜSS MicroTec auch die zweite Generation seines MA300 Produktions Mask Aligners auf den Markt, der speziell für 3D-Anwendungen optimiert wurde. Damit verfügt SÜSS MicroTec bereits jetzt über ein System für das Bearbeiten großer 300mm Wafer im Bereich der 3D-Integration. Der neue MA300 wurde dabei mit einer zusätzlichen Rückseitenjustage ausgestattet, die ihm erlaubt, auch beidseitig strukturierte Wafer zu verarbeiten, während eine zusätzliche Infrarot (IR)-Justagefunktionen ihm ermöglicht, auch intransparente, aber IR-durchlässige Materialien zu händeln. Eine wichtige Funktion, vor allem für das Prozessieren von gedünnten Wafern.

Hand icon: Weiterführende Informationen finden Sie unter [www.suss.com](http://www.suss.com)  
> Märkte > 3D-Integration

Erweitert wurde das Produktportfolio für 3D-Anwendungen zudem um die neue 300mm Wafer Bonder-Produktserie. Der speziell für die Herstellung von CMOS-Bildsensoren konzipierte XBC300 zeichnet sich durch einen hohen Durchsatz sowie die Fähigkeit aus, eine Reihe von Bond-Prozessen auf der aktuell marktweit kleinsten Stellfläche ausführen zu können.

# INVESTOR RELATIONS

## Die SÜSS MicroTec-Aktie

Das Jahr 2008 war ein bewegtes, wenn auch verlustreiches Börsenjahr. Der DAX verlor zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2008 gut 40 % an Wert. Der MDAX sowie der TecDAX büßten in Folge der internationalen Finanzkrise sowie den zunehmenden Rezessionsängsten sogar rund 43 bzw. rund 48 % ihres Werts ein. Die SÜSS MicroTec-Aktie war mit einem Kurs von 4,29 Euro in das Geschäftsjahr 2008 gestartet und konnte sich zunächst in dem bereits schwierigem Marktumfeld gut behaupten. In den ersten sechs Monaten des Jahres entwickelte sich die Aktie sogar besser als der Auswahlindex für Technologiewerte TecDAX sowie der Branchenindex Prime IG Semiconductor. Ab August konnte sie sich allerdings dem allgemeinen Abwärtstrend an den Börsen nicht entziehen. Die im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der vorläufigen Neunmonatszahlen am 22. Oktober 2008 bekannt gegebene Anpassung der Jahresergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2008 führte zu einem weiteren Vertrauensverlust und in deren Folge zu deutlichen Kursabschlägen. Zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2008 notierte die SÜSS MicroTec-Aktie bei 1,36 Euro und somit rund 68 % unter dem vergleichbaren Vorjahres-Stichtag. Demgegenüber verzeichneten die beiden Vergleichsindizes TecDax und IG Prime Semiconductor im entsprechenden Zeitraum Rückgänge von rund 48 % bzw. 83 %.

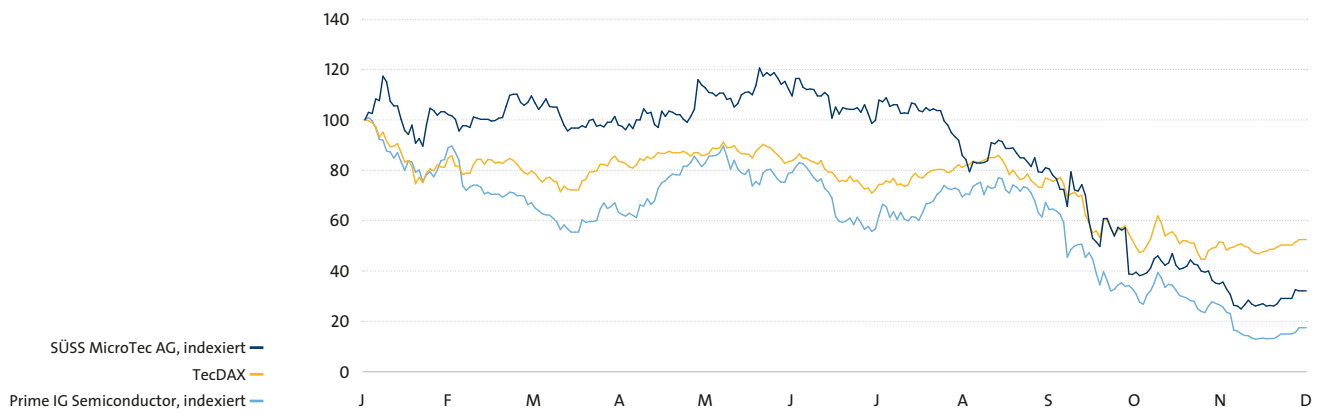
Die Liquidität der SÜSS MicroTec-Aktie an allen deutschen Börsenplätzen lag mit einem durchschnittlichen Umsatz von 46.325 Stück pro Tag deutlich unter ihrem Vorjahreswert (2007: 110.882 Stück pro Tag). Der durchschnittliche Kurs der Aktie belief sich im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 auf 3,70 Euro.

Weitere Einzelheiten zur Kursentwicklung enthalten die nachfolgenden grafischen Darstellungen.



### DIE KURSENTWICKLUNG DER SÜSS MICROTEC-AKTIE IM JAHR 2008

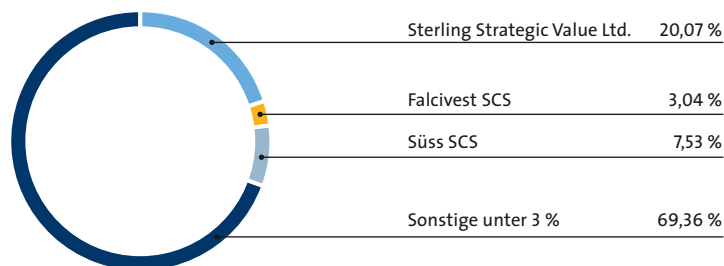
Kurs der SÜSS MicroTec-Aktie am 2. Januar 2008: 4,29 €



### VERGLEICH DER KURSENTWICKLUNG VON SÜSS MICROTEC, TECDAX UND PRIME IG SEMICONDUCTOR im Geschäftsjahr 2008

	01.01.2008	31.12.2008	Veränderungen
SÜSS MicroTec	4,29 €	1,36 €	-68, %
TecDAX	974,19 €	508,31 €	-47,8 %
Prime IG Semiconductor	124,17 €	21,06 €	-83,0 %

### AKTIONÄRSSTRUKTUR ZUM 31. DEZEMBER 2008 in %



## DIE SÜSS MICROTREC-AKTIE IM ÜBERBLICK

Wertpapierkennnummer	722670
ISIN-Nummer	DE0007226706
Reuters-Kürzel	SMHG.F
Bloomberg-Kürzel	SMH GR
Börsensegment	Prime Standard
Anzahl der ausgegebenen Aktien (Stand 31. Dezember 2008)	17.019.126
Wertpapiergattung	Nennwertlose Stückaktien
Designated Sponsor	HSBC Trinkaus & Burkhardt
Beginn der Börsennotierung	18.05.1999
Jahresanfangs-/ -schlusskurs in €	4,29 € / 1,36 €
Jahreshoch-/ tief in €*	5,18 € / 1,05 €
Prozentuale Jahresentwicklung	-68,3 %
Kapitalmaßnahmen 2008	–

\* XETRA Schlusskurs

## Im Dialog mit dem Kapitalmarkt

Im Jahr 2008 hat SÜSS MicroTec seine Investor Relations-Arbeit weiter optimiert. Der Schwerpunkt lag dabei auf zielgerichteten Maßnahmen wie auch der weiteren Verbesserung des Online-Angebots auf der Unternehmens-Website. Um größtmögliche Transparenz und gleiche Chancen für alle zu gewährleisten, folgt unsere Unternehmenskommunikation dem Anspruch, alle Zielgruppen gleichberechtigt und zeitnah zu informieren. Im Internet können sich Aktionäre und potenzielle Anleger jederzeit über aktuelle Entwicklungen im Konzern informieren. Sämtliche Presse- und Ad-hoc-Mitteilungen der SÜSS MicroTec AG werden auf der Website der Gesellschaft in deutscher und englischer Sprache publiziert. Die Satzung der Gesellschaft sowie die Konzernabschlüsse und Zwischenberichte stehen ebenfalls dort zum Download bereit. Über die wiederkehrenden Termine wie die Hauptversammlung oder die Erscheinungstermine der Quartalsberichte unterrichten wir unsere Aktionäre, Investoren, Analysten sowie die interessierte Öffentlichkeit regelmäßig in einem Finanzkalender, der im Geschäftsbericht, in den Zwischenberichten sowie auf der Website unserer Gesellschaft veröffentlicht ist.

Darüber hinaus nutzte der Vorstand auf insgesamt drei Kapitalmarktkonferenzen sowie in über 50 Einzelgesprächen und auf Roadshows die Gelegenheit, institutionelle Investoren und Analysten über die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens zu informieren. Neben der jährlichen Analysten- und Investorenkonferenz zum Jahresabschluss finden anlässlich der Veröffentlichung der Quartalsberichte zudem Telefonkonferenzen für Analysten und Investoren statt. Präsentationen wesentlicher Veranstaltungen sowie Veranstaltungsmitschnitte im Video- oder Audioformat stehen, sofern verfügbar, auf der Website der Gesellschaft frei einsehbar zur Verfügung.

Trotz des schwierigen Börsenjahres und der negativen Entwicklung der SÜSS MicroTec-Aktie, konnte die SÜSS MicroTec AG wie in den Vorjahren auch im Geschäftsjahr 2008 auf eine gute Coverage bauen. Zu den sieben Häusern, die regelmäßig Studien zur SÜSS MicroTec AG herausgeben, zählen die Deutsche Bank AG, die DZ Bank AG, die Credit Suisse AG, die Crédit Agricole Cheuvreux AG, die Close Brothers Seydler Research AG, Fairresearch GmbH & Co. KG sowie SES Research GmbH.

## Hauptversammlung

Im Berichtsjahr fand die ordentliche Hauptversammlung am 19. Juni 2008 im Haus der Bayerischen Wirtschaft statt. Insgesamt waren rund 100 Aktionäre, Bankenvertreter und Gäste der Einladung nach München gefolgt, um sich über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr und die Zukunftsperspektiven der SÜSS MicroTec AG persönlich zu informieren. Im Mittelpunkt des Rechenschaftsberichts des Vorstands standen dabei zum einen die Hintergründe für die im Oktober 2007 veröffentlichte Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2007 sowie die erfolgreichen Markteinführungen neuer Produkte.

Die Fragen der Aktionärsvertreter und Aktionäre in der anschließenden Aussprache konzentrierten sich vor allem auf den Verlauf des vergangenen Geschäftsjahres sowie die strategische Ausrichtung und die Perspektiven des Unternehmens vor dem Hintergrund der Aufsichtsratsneuwahlen. Ausführlich beantworteten sowohl der Vorstand als auch der scheidende Aufsichtsrat sowie die vorgeschlagenen Kandidaten die ihnen gestellten Fragen.

Erstmals in der Unternehmensgeschichte von SÜSS MicroTec als börsennotiertes Unternehmen wurden im Rahmen der Hauptversammlung auch Anträge von Aktionärsseite eingebracht, welche die Vertagung der Tagesordnungspunkte 8 und 9 sowie eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat zum Gegenstand hatten. Diese Anträge wurden alle in den vorgezogenen Sonderabstimmungen von der Hauptversammlung abgelehnt.

In den Aufsichtsratsneuwahlen lag für das Münchner Unternehmen auch ein historisch bedeutsamer Moment: im Zuge der Neuwahlen legte Herr Dr. Winfried Süß, Sohn des Firmengründers Karl Süß, nach nunmehr 50 Jahren Tätigkeit und Engagement für SÜSS MicroTec (vormals Karl Süß) altersbedingt sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender nieder. Die vorgeschlagenen Kandidaten Dr. Franz Richter, Dr. Stefan Reineck sowie Jan Teichert wurden von der Hauptversammlung in den jeweiligen Einzelabstimmungen mit großer Mehrheit in den Aufsichtsrat gewählt.

# CORPORATE GOVERNANCE

Die Corporate Governance bei SÜSS MicroTec orientiert sich am Deutschen Corporate Governance Kodex, der sich als Maßstab guter Unternehmensführung in Deutschland bewährt hat.

Es besteht keine gesetzliche Pflicht, den dort aufgeführten Standards nachzukommen, jedoch sind börsennotierte Gesellschaften verpflichtet, im Sinne eines „comply or explain“ jährlich eine Entsprechenserklärung zu den aktuellen Kodex-Empfehlungen abzugeben.

Eine verantwortungsbewusste, transparente und nachhaltig wertschaffende Unternehmensführung kommt bei SÜSS MicroTec seit jeher ein hoher Stellenwert zu. Unser Ziel ist es, das Vertrauen, das uns die Anleger, Finanzmärkte, Geschäftspartner, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit entgegenbringen, zu bestätigen und die Corporate Governance im Konzern fortlaufend weiterzuentwickeln. Deshalb begrüßen Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG grundsätzlich sämtliche Initiativen und Empfehlungen zum Thema Corporate Governance Kodex.

## Entsprechenserklärung

SÜSS MicroTec folgt bereits seit Jahren den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex mit nur wenigen Ausnahmen. Auch im Berichtsjahr haben sich Vorstand und Aufsichtsrat intensiv mit der Erfüllung der Kodex-Vorgaben befasst, insbesondere mit den neuen Anforderungen vom 6. Juni 2008. Auf Basis dieser Beratungen haben Vorstand und Aufsichtsrat am 7. November 2008 die Entsprechenserklärung nach § 161 Aktiengesetz (AktG) abgegeben, nach der die SÜSS MicroTec AG den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 14. Juni 2007 mit den zwei Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung und der erfolgsorientierten Vergütung des Aufsichtsrats – entsprach und zukünftig auch der aktualisierten Fassung vom 6. Juni 2008 mit den folgenden drei Ausnahmen entsprechen wird:

**+ Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen**

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in **Ziffer 3.8** bei Abschluss einer Directors' and Officers' Liability Insurance (Vermögensschadenshaftpflichtversicherung) einen angemessenen Selbstbehalt für die Organe der AG zu vereinbaren. Die SÜSS MicroTec AG verfügt bereits seit mehreren Jahren über eine D&O-Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt. Das verantwortungsvolle Handeln aller geschäftsführenden Organe wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbsthalts nicht zusätzlich gefördert.

**+ Bildung von Ausschüssen**

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in **Ziffer 5.3** in Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Aufsichtsratsmitglieder die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschüssen. Da der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG seit Mitte des Jahres 2008 aus drei Aufsichtsratsmitgliedern besteht, sieht der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG die Bildung von entsprechenden Ausschüssen für nicht notwendig an. Insbesondere ist der Aufsichtsrat der Auffassung, dass bei dieser Mitgliederzahl durch Bildung von Ausschüssen die Arbeit des Gremiums unnötig erschwert werden würde.

**+ Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern**

In **Ziffer 5.4.6** empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex eine erfolgsorientierte Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern sowie eine Vergütung für die Mitgliedschaft und den Vorsitz in Ausschüssen. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist im § 13 der Satzung festgelegt. Die Satzung der SÜSS MicroTec AG sieht aktuell keine erfolgsorientierte Vergütung des Aufsichtsrats vor.

Der Wortlaut der aktuellen Entsprechenserklärung sowie alle vorhergehenden Erklärungen gemäß § 161 AktG sind auf der Internetseite der SÜSS MicroTec AG unter [www.suss.com](http://www.suss.com) > **Investor Relations** > **Corporate Governance** > **Entsprechenserklärung** veröffentlicht.

Des Weiteren gelten hinsichtlich der im Kodex enthaltenen Anregungen, von denen ein Unternehmen auch ohne Erklärungspflicht abweichen kann, für die SÜSS MicroTec AG folgende Einschränkungen:

- + Abweichend von **Ziffer 2.3.3** des Deutschen Corporate Governance Kodex ist der Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung nicht erreichbar, da sich dies mit vertretbarem finanziellen Aufwand nicht mit der rechtlich erforderlichen Sicherheit gewährleisten lässt.
- + In **Ziffer 2.3.4** regt der Kodex an, den Aktionären der Gesellschaft die Verfolgung der Hauptversammlung über moderne Kommunikationsmedien (z. B. Internet) zu ermöglichen. Im Hinblick auf die zusätzlichen Kosten, die durch die Nutzung dieser Technologie entstehen können, wird derzeit von der Umsetzung dieser Anregung abgesehen.
- + Da der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG nicht mitbestimmt ist, findet abweichend von **Ziffer 3.6 Abs. 1** des Deutschen Corporate Governance Kodex keine getrennte Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen statt.

## Kommunikation und Transparenz

Um größtmögliche Transparenz und gleiche Chancen für alle zu gewährleisten, folgt unsere Unternehmenskommunikation dem Anspruch, alle Zielgruppen gleichberechtigt und zeitnah zu informieren. Im Internet können sich Aktionäre und potenzielle Anleger jederzeit über aktuelle Entwicklungen im Konzern informieren. Sämtliche Presse- und Ad-hoc-Mitteilungen der SÜSS MicroTec AG werden auch auf der Website der Gesellschaft in deutscher und englischer Sprache publiziert. Die Satzung der Gesellschaft sowie die Konzernabschlüsse und Zwischenberichte stehen ebenfalls zum Download bereit. Über die wiederkehrenden Termine wie den Termin der Hauptversammlung oder die Erscheinungstermine der Zwischenberichte unterrichten wir unsere Aktionäre, Analysten, Medien sowie die interessierte Öffentlichkeit regelmäßig in einem Finanzkalender, der im Geschäftsbericht, in den Zwischenberichten sowie auf der Website unserer Gesellschaft veröffentlicht ist. Darüber hinaus finden im Rahmen der Investor Relations-Aktivitäten regelmäßig Gespräche mit Analysten und Investoren statt. Die jährliche Hauptversammlung wird bei SÜSS MicroTec mit dem Ziel vorbereitet, sämtliche Aktionäre vor, während und nach der Versammlung zügig, umfassend und effektiv zu informieren. Außerdem wollen wir ihnen die Anmeldung zur Hauptversammlung und die Ausübung ihrer Rechte erleichtern. So können Aktionäre ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung entweder selber oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl ausüben oder durch einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Weisungen zur Stimmrechtsausübung können schriftlich entweder vor oder während der Hauptversammlung direkt vor Ort erteilt werden. In der Einladung zur HV werden zudem die anstehenden Tagesordnungspunkte und die Teilnahmebedingungen ausführlich erläutert. Alle Dokumente und Informationen zur Hauptversammlung stehen auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung und können ebenfalls in Kopie bei der IR-Abteilung angefordert werden.

## Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat

Das vom deutschen Aktiengesetz (AktG) geforderte zweistufige System sieht eine strikte Trennung von Führung und Kontrolle in Unternehmen vor. Die Verantwortlichkeiten beider Organe, Vorstand und Aufsichtsrat, sind per Gesetz klar definiert. Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung, entwickelt die strategische Ausrichtung des Unternehmens, stimmt diese mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für deren Umsetzung. Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Geschäftsführung und bestellt die Vorstandsmitglieder. Grundlegende Unternehmensentscheidungen benötigen seine Zustimmung.

Die Unternehmensführung der SÜSS MicroTec AG ist durch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt. Beide Organe arbeiten im Interesse des Unternehmens und mit dem gemeinsamen Ziel eng zusammen, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern.

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG informiert den Aufsichtsrat dazu regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen werden dabei erläutert und begründet. Wie es der Deutsche Corporate Governance Kodex vorsieht, gehören dem Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG mit den Herren Dr. Franz Richter und Dr. Stefan Reineck nicht mehr als zwei ehemalige Vorstandsmitglieder an, womit eine unabhängige Beratung und Überwachung des Vorstands gewährleistet ist.

Im aktuellen Geschäftsjahr bestanden keinerlei Berater- oder sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft. Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen sind, traten im Geschäftsjahr 2008 nicht auf.

## Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat

Mit Wirkung zum 2. Oktober wurde Christian Schubert in den Vorstand der SÜSS MicroTec AG berufen. Der Diplom-Kaufmann folgte damit auf Dr. Stefan Schneidewind, der nach vier Jahren Vorstandstätigkeit bei SÜSS MicroTec aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens vom Aufsichtsrat der Gesellschaft abberufen wurde. Herr Schubert übernahm das Vorstandsamt interimistisch und wird bis zum Ende seiner Bestellung am 31. Mai 2009 im Vorstand verbleiben und sich dabei insbesondere der weiteren Optimierung des Einkaufs- und Beschaffungswesens sowie der Materialwirtschaft widmen.

Mit Wirkung zum 1. Februar 2009 wurde Herr Frank Averdung in den Vorstand und zum neuen Vorstandsvorsitzenden der SÜSS MicroTec AG berufen. In dieser Funktion verantwortet der ehemalige Geschäftsführer der Carl Zeiss SMS GmbH (SMS – Semiconductor Metrology Systems), Jena, die Bereiche Vertrieb, Marketing, Produktion und Konzernstrategie.

Im Geschäftsjahr 2008 standen die turnusmäßigen Neuwahlen des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG an, in deren Verlauf auch eine Verkleinerung des Aufsichtsrats von sechs auf zukünftig drei Mitglieder erfolgte. Mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Juni 2008 sind die Herren Dr. Winfried Süß, Gerhard Rauter, Peter Heinz, Prof. Dr. Anton Heuberger, Dr. Stefan Reineck und Heinz-Peter Verspay mit Ablauf ihrer Amtsperiode aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Die vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat, Dr. Franz Richter, Dr. Stefan Reineck und Jan Teichert, wurden jeweils mit großer Mehrheit von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.

## Vergütungsbericht

Eine transparente und verständliche Darstellung der Vorstandsvergütung ist für SÜSS MicroTec seit Jahren ein wesentliches Element guter Corporate Governance. Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder besteht aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Vergütungsbestandteilen. Die erfolgsunabhängigen Teile bestehen aus dem Grundgehalt sowie Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und Zuschüssen zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. der Verantwortung bestimmt. Darüber hinaus sind den Mitgliedern des Vorstands Versorgungszusagen (Alters-, Berufsunfähigkeits- und Witwenrente) in Form von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherungen) gemacht worden. Weitere geldwerte Leistungen wurden nicht gewährt.

Die erfolgsbezogenen Vergütungskomponenten des Vorstands unterteilen sich in eine variable Vergütung, die sich an individuell festgelegten Zielen orientiert, und eine am langfristigen Erfolg des Unternehmens ausgerichtete aktienbasierte Vergütung bestehend aus Aktienoptionen. Für die Festlegung der individuellen Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat zuständig. Das Aufsichtsratsplenum beschließt und überprüft auf regelmäßiger Basis das Vergütungssystem für den Vorstand und beschließt über die Vorstandsverträge.

Im Zuge dieser Beratungen hat der Aufsichtsrat im Berichtsjahr beschlossen, in Vorstandsverträgen, die nach dem 7. November 2008 abgeschlossen werden, für den Fall, dass die Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund vorzeitig endet, eine Ausgleichszahlung vorzusehen. Diese ist auf maximal zwei Jahresvergütungen einschließlich Nebenleistungen begrenzt (Abfindungs-Cap) und vergütet nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels („Change-of-Control“-Regelung) ist in den Vorstandsverträgen nicht enthalten.

Im Geschäftsjahr 2008 hat die SÜSS MicroTec AG folgende Vergütungen an die Vorstandsmitglieder gezahlt:

Vorstand	Grundgehalt in €* -----	Variable Vergütung für 2007 in € -----	Aktien- optionen in Stück -----	Sonstige Leistungen in €** -----	Aufwand für Alters- versorgung in € -----
Dr. Stefan Schneidewind <sup>a</sup>	214.705,50	141.360,77	–	4.746,15	1.611,00
Michael Knopp	206.925,00	28.752,72	–	6.328,20	2.148,00
Christian Schubert <sup>b</sup>	62.242,05	0,00	–	–	–

\* Im Grundgehalt enthalten sind jeweils Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie ein Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit

\*\* Zuschuss zur freiwilligen Rentenversicherung  
a Vorstandsmitglied bis 2. Oktober 2008  
b Vorstandsmitglied seit 2. Oktober 2008



Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 13 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Sie wurde auf der Hauptversammlung am 19. Juni 2008 neu beschlossen. Die Satzungsänderung wurde am 10. Juli 2008 in das Handelsregister eingetragen.

Bis zum 19. Juni 2008 galt folgende Vergütungsregelung: Jedes der insgesamt sechs Aufsichtsratsmitglieder erhielt neben dem Auslageersatz eine feste Vergütung in Höhe von 15.000,00 € pro Geschäftsjahr zuzüglich Sitzungsgeldern, wobei der Aufsichtsratsvorsitzende jeweils das Dreifache und sein Stellvertreter das Anderthalbfache der Vergütung eines einfachen Mitglieds erhielt. Seither erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 13 der Satzung folgende Vergütung:

Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500,00 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000,00 €, sein Stellvertreter 40.000,00 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000,00 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung.

An die dem Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2008 angehörenden Mitglieder des Aufsichtsrats hat die SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2008 folgende Vergütungen gezahlt:

Aufsichtsrat bis 19. Juni 2008	Vergütung gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 der Satzung in €	Sitzungsgeld gemäß § 13 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 der Satzung in €	Auslageersatz und 19 % MwSt. abzgl. 30 % AR-Steuer etc. (§ 13 Abs. 4 der Satzung) in €
Dr. Winfried Süß (Aufsichtsratsvorsitzender)	22.500,00	10.500,00	0,00 abzgl. 840,00 D&O- Versicherung = -840,00
Gerhard Rauter (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)	11.250,00	3.000,00	412,00 abzgl. 420,00 D&O- Versicherung = 8,00 4.338,08 abzgl. 3.798,00 AR- Steuer und 280,00 D&O- Versicherung = 260,08
Peter Heinz, MBA	7.500,00	4.500,00	1.390,00 zzgl. 1.995,00 MwSt. abzgl. 280,00 D&O- Versicherung = 3.105,00
Prof. Dr. Anton Heuberger	7.500,00	3.000,00	3.666,28 zzgl. 3420,00 MwSt. abzgl. 280,00 D&O- Versicherung = 6.806,28
Dr. Stefan Reineck	7.500,00	10.500,00	161,25 zzgl. 1.995,00 MwSt. abzgl. 280,00 D&O- Versicherung = 1.836,25
Heinz-Peter Verspay	7.500,00	3.000,00	

Aufsichtsrat seit 19. Juni 2008	Vergütung gemäß § 13 Abs. 1 der Satzung in €	Sitzungsgeld gemäß § 13 Abs. 2 der Satzung in €	Auslagenersatz und 19 % MwSt. abzgl. 30 % AR-Steuer etc. (§ 13 Abs. 3 der Satzung) in €
Dr. Franz Richter (Aufsichtsratsvorsitzender seit 19. Juni 2008)	22.500,00	9.000,00	19.431,83 zzgl. 5.985,00 MwSt. abzgl. 1.298,00 D&O- Versicherung = 24.118,83
Dr. Stefan Reineck (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender seit 19. Juni 2008)	20.000,00	9.000,00	7.925,18 zzgl. 5.510,00 MwSt. abzgl. 649,00 D&O- Vericherung = 12.786,18
Jan Teichert (Aufsichtsratsmitglied seit 19. Juni 2008)	17.500,00	9.000,00	51,00 zzgl. 5.035,00 MwSt. abzgl. 433,00 D&O- Versicherung = 4.653,00

Im Geschäftsjahr 2008 haben weder die früheren noch die aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vergütung bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten.

**PERSONELLE ZUSAMMENSETZUNG DES AUFSICHTSRATS UND SEINER  
AUSSCHÜSSE SOWIE FUNKTIONEN DER EINZELNEN MITGLIEDER**  
bis zum 19. Juni 2008

	Aufsichtsrat	Audit Committee	Nominie- rung	Personal	Technologie	Finanzie- rung
Dr. Winfried Süß	Vorsitzender	Mitglied	Vorsitzender	Vorsitzender	Vorsitzender	Mitglied
Gerhard Rauter	Stellver- tretender Vorsitzender			Mitglied	Mitglied	
Peter Heinz	Mitglied	Vorsitzender			Mitglied	Vorsitzender
Prof. Dr. Anton Heuberger	Mitglied				Mitglied	
Dr. Stefan Reineck	Mitglied		Mitglied	Mitglied		
Heinz-Peter Verspay	Mitglied	Mitglied				Mitglied

## Directors' Dealings und Anteilsbesitz

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach § 15a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) gesetzlich verpflichtet, den Erwerb und die Veräußerung von Aktien der SÜSS MicroTec AG oder sich darauf beziehende Finanzinstrumente offenzulegen, sofern der Wert der Geschäfte, die ein Organmitglied und ihm nahestehende Personen innerhalb eines Kalenderjahres getätigt haben, die Summe von 5.000 € erreicht oder übersteigt. Diese Pflicht gilt gleichermaßen für bestimmte Mitarbeiter mit Führungsaufgaben und die mit ihnen in enger Beziehung stehenden Personen. Im Geschäftsjahr 2008 sind der SÜSS MicroTec AG folgende Mitteilungen über Geschäfte von Organmitgliedern und diesen nahe stehende Personen gemeldet worden, die auch auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht sind:

- + Michael Knopp (Finanzvorstand):  
Kauf von 7.500 SÜSS MicroTec-Stückaktien zum Preis von insgesamt 7.875,00 € am 5. Dezember 2008
- + Michael Knopp (Finanzvorstand):  
Kauf von 10.000 SÜSS MicroTec-Stückaktien zum Preis von insgesamt 17.372,71 € am 30. Oktober 2008
- + Dr. Stefan Reineck (Mitglied des Aufsichtsrats seit Beginn des Geschäftsjahres und Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender seit 19. Juni 2008):  
Kauf von 5.000 SÜSS MicroTec-Stückaktien zum Preis von insgesamt 8.150,00 € am 28. Oktober 2008
- + Heinz-Peter Verspay (Aufsichtsratsmitglied bis zum 19. Juni 2008):  
Kauf von 2.000 SÜSS MicroTec-Stückaktien zum Preis von insgesamt 8.740,00 € am 31.03.2008

## Aktienoptionsprogramme

Die SÜSS MicroTec AG sieht in der Aufstellung von Aktienoptionsplänen ein wichtiges Element für die Mitarbeiterbeteiligung an dem Erfolg des Unternehmens sowie die Möglichkeit, Führungskräfte langfristig an das Unternehmen zu binden. Die Gesellschaft verfügt derzeit über drei Aktienoptionsprogramme. In allen Fällen können die Optionen an Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung von nachgeordneten verbundenen Unternehmen i.S. der §§ 15 ff. AktG sowie an Führungskräfte der SÜSS MicroTec AG und mit ihr verbundener nachgeordneter Unternehmen i.S. der §§ 15 ff. AktG ausgegeben werden.

### Aktioptionsprogramm 2002

Aus dem von der Hauptversammlung am 14. Juni 2002 beschlossenen Aktioptionsprogramm 2002 waren zu Beginn des Geschäftsjahres 2008 26.150 Optionen (davon 0 Optionen an Mitglieder des Vorstands) ausstehend.

Im Geschäftsjahr 2008 wurden insgesamt 0 Bezugsrechte ausgeübt. 6.100 Optionen aus dem Aktioptionsprogramm 2002 sind im Berichtsjahr verfallen. Am Ende des Geschäftsjahres standen insgesamt noch 20.050 Optionen aus dem Optionsprogramm 2002 aus. Davon können 4.500 Optionen bis zum Ausübungszeitraum Mai 2009 zu einem Ausübungspreis von 1,11 € und 15.550 Optionen zu einem Ausübungspreis i. H. v. 3,44 € bis zum Ausübungszeitraum August 2010 ausgeübt werden, wenn eines der nachfolgend beschriebenen Erfolgsziele erreicht wird: (i) wenn der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 7,5 % p. a. gestiegen ist und sich der Börsenkurs der Gesellschaft in diesem Zeitraum gleich oder besser entwickelt hat als der Nemax oder sein Nachfolgeindex TecDax oder (ii) wenn der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 10 % p. a. gestiegen ist.

### Aktioptionsprogramm 2005

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2008 standen unter dem von der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 beschlossenen Aktioptionsprogramm 2005 insgesamt 642.800 Optionen aus. Im Berichtsjahr 2008 wurden 0 Optionen an Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Insgesamt sind 75.200 Optionen des Aktioptionsprogramms 2005 im Geschäftsjahr 2008 verfallen. Optionen aus diesem Programm wurden im Geschäftsjahr 2008 nicht ausgeübt. Die Anzahl der noch ausstehenden Optionen betrug zum Ende des Geschäftsjahres 567.600 Stück, davon wurden bisher insgesamt 220.000 an Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Die ausgegebenen Optionen können nach Ablauf der 2-jährigen Wartezeit ausgeübt werden, sofern eines der nachfolgend beschriebenen Erfolgsziele erreicht wird: (i) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie ist im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 7,5 % p. a. gestiegen und der Börsenkurs der Gesellschaft hat sich in diesem Zeitraum gleich oder besser entwickelt als der TecDax oder (ii) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie ist im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 10 % p. a. gestiegen. Die Ausübungs- bzw. Bezugspreise betragen 4,95 € für 136.500 am 31. August 2005 ausgegebene Optionen, 7,35 € für 159.000 am 8. Juni 2006 ausgegebene Optionen sowie 8,39 € für 317.300 am 23. Mai 2007 und 8,42 € für 30.000 am 22. August 2007 ausgegebene Optionen.

### Aktioptionsprogramm 2008

Das von der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 beschlossene Aktioptionsprogramm 2008 sieht vor, dass die Optionen nach Ablauf einer 2-jährigen Wartezeit ausgeübt werden können, wenn folgende Erfolgsziele erfüllt sind: (i) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und dem ersten Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktioption ausgeübt wird, um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist und der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDax entwickelt hat oder (ii) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und dem ersten Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktioption ausgeübt wird, um mindestens 0,833 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist.

Bis zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2008 wurden 0 Optionen aus dem Optionsprogramm 2008 (davon 0 an Mitglieder des Vorstands) ausgegeben.

## Rechnungslegung und Abschlussprüfung

SÜSS MicroTec erstellt den Konzernabschluss sowie die Zwischenberichte nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union für börsennotierte Gesellschaften anzuwenden sind. Der Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Am 19. Juni 2008 bestellte die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2008 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München (vormals: KPMG Deutsche Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München) zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der SÜSS MicroTec AG. Als Nachweis seiner Unabhängigkeit hat der Abschlussprüfer gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben.

## Besitz von Aktien und Bezugsrechten

Die im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG besitzen zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2008 folgende Anzahl an Aktien und Bezugsrechten:

	Anzahl der Aktien zum 31.12.2008	Veränderung gegenüber 31.12.2007	Anzahl der Aktienoptionen zum 31.12.2008	Veränderung gegenüber 31.12.2007
<b>Aufsichtsrat</b>				
Dr. Franz Richter <sup>*</sup>	101.040	+101.040	–	–
Dr. Stefan Reineck <sup>*</sup>	6.600	+5.000	40.000	–
Jan Teichert <sup>*</sup>	–	–	–	–
Dr. Winfried Süß <sup>**</sup>	–	-1.131.000	–	–
Gerhard Rauter <sup>**</sup>	–	–	–	–
Peter Heinz <sup>**</sup>	–	-1.338	–	–
Prof. Dr. Anton Heuberger <sup>**</sup>	–	–	–	–
Heinz-Peter Verspay <sup>**</sup>	–	–	–	–
<b>Vorstand</b>				
Michael Knopp	22.500	+17.500	30.000	–
Christian Schubert <sup>***</sup>	–	–	–	–
Dr. Stefan Schneidewind <sup>****</sup>	18.278	–	150.000	–

<sup>\*</sup> Aufsichtsratsmitglied seit 19. Juni 2008

<sup>\*\*</sup> Aufsichtsratsmitglied bis 19. Juni 2008

<sup>\*\*\*</sup> Vorstandsmitglied seit 2. Oktober 2008

<sup>\*\*\*\*</sup> Vorstandsmitglied bis 2. Oktober 2008

## Organe

Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG und deren Mandate:

**Michael Knopp** –

**Christian Schubert** –

**Dr. Stefan Schneidewind** –

**Dr. Franz Richter** Replisaurus Technologies, Inc., Kista, Schweden  
(Chairman of the Board of Directors)  
Siltronic AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats)  
EpiSpeed AG, Zug, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)  
Industrieverband SEMI, San Jose, Kalifornien, USA  
(Mitglied im „International Board of Directors“)  
und Vorstand der Thin Materials AG, München

**Dr. Stefan Reineck** AttoCube Systems AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  
NanoScape AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  
Aleo solar Aktiengesellschaft, Prenzlau (Mitglied des Aufsichtsrats)  
TF Instruments Inc. Monmouth Junction, New Jersey, USA  
(Mitglied im Board)  
Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA (Mitglied im Board)  
Johanna Solar Technology GmbH, Brandenburg an der Havel  
(Beiratsvorsitzender)  
und Berufsaufsichtsrat sowie Gesellschafter der RMC  
Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Kirchartd

**Jan Teichert** Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG

# KONZERNLAGEBERICHT

<b>44</b>	<b>Geschäft und Rahmenbedingungen</b>
44	Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit
48	Unternehmenssteuerung, Ziele und Strategie
48	Forschung und Entwicklung
52	Überblick über den Geschäftsverlauf
<b>60</b>	<b>Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage</b>
60	Ertragslage
61	Finanz- und Vermögenslage
63	Investitionen
63	Die Holding – SÜSS MicroTec AG
66	Mitarbeiter im Konzern
<b>67</b>	<b>Angaben gemäß § 315 Abs. 4 HGB</b>
<b>68</b>	<b>Corporate Governance</b>
<b>68</b>	<b>Nachtragsbericht</b>
<b>69</b>	<b>Risikobericht</b>
69	Allgemeine wirtschaftliche Risiken und Branchenrisiken
71	Betriebliche Risiken
71	Finanzmarktrisiken
74	Organisation und Dokumentation des Risikomanagements
75	Risikoidentifikation
75	Risikobewertung
75	Risikohandhabung
<b>75</b>	<b>Prognosebericht</b>
76	Halbleiterindustrie
76	Halbleiter-Equipment-Industrie
77	Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten
<b>80</b>	<b>Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns</b>
<b>80</b>	<b>Vorausschauende Aussagen</b>

# KONZERNLAGEBERICHT

und Lagebericht der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2008

## GESCHÄFT UND RAHMENBEDINGUNGEN

### Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit

#### Geschäftstätigkeit und Geschäftsfelder

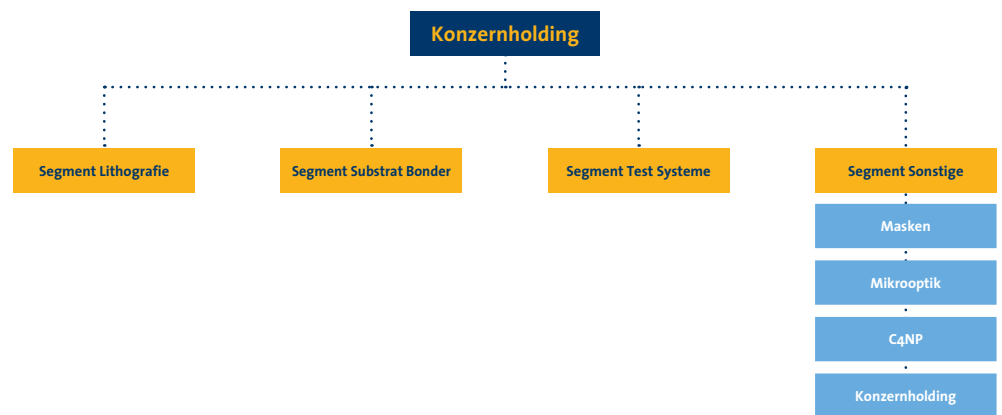
Der SÜSS MicroTec-Konzern fertigt und vertreibt Anlagen und Prüfsysteme für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Spezialmärkte bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung.

Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten. Hier bildet und nutzt die Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen.

Der Konzern ist in vier Segmente eingeteilt, wobei das Segment „Sonstige“ aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden. Der folgende Lagebericht bezieht sowohl die fortgeführten als auch die nicht fortgeführten Aktivitäten des Konzerns in die Betrachtung mit ein. Zu den nicht fortgeführten Aktivitäten des Geschäftsjahres 2008 zählt das Segment Device Bonder, von welchem sich die SÜSS MicroTec AG im Jahr 2007 getrennt hat. Im Wege eines Asset Deals wurden die wesentlichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Device Bonder-Geschäfts der Suss MicroTec S.A.S. veräußert.



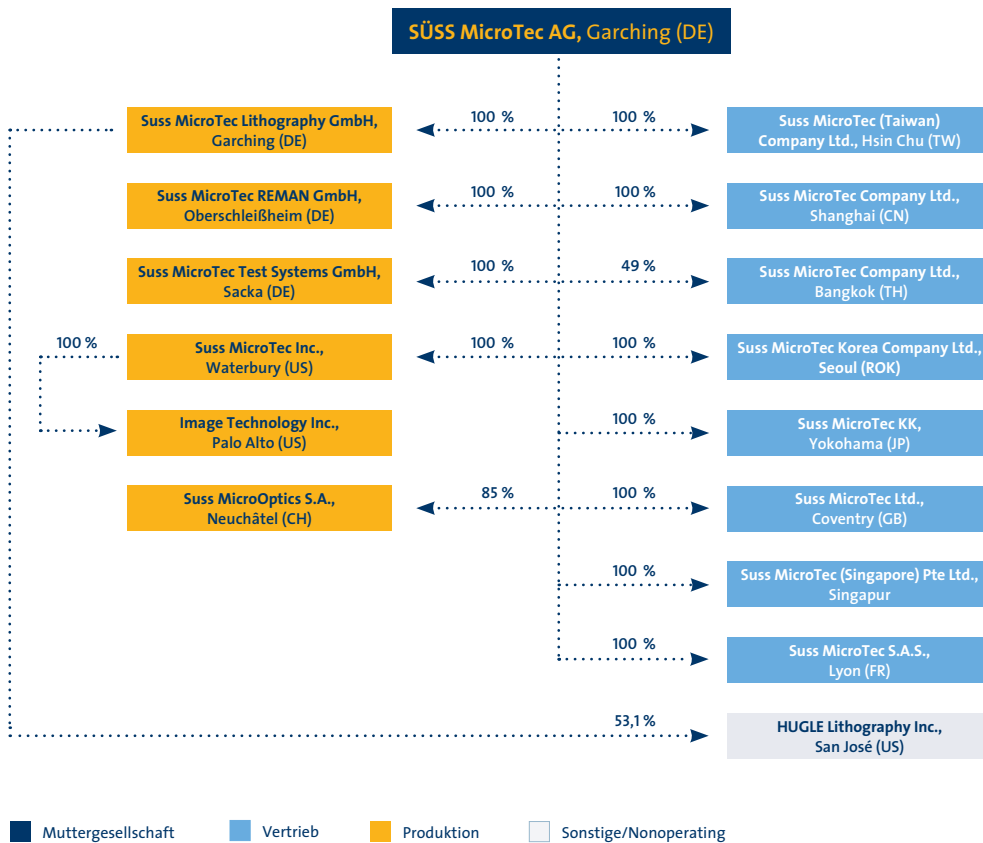
Dabei wurde zwischen den Kaufvertragsparteien vereinbart, dass der zum Übertragungstichtag (16. Juli 2007) vorhandene Auftragsbestand an Device Bondern von der Süss MicroTec S.A.S. abgewickelt wird. Die Restabwicklung des Auftragsbestands dauerte bis in das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2008.



### Rechtliche Konzernstruktur

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec AG als Management- und Finanzierungsholding, sowie den in der Regel mehrheitlich in Besitz der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebstätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, England, Frankreich, der Schweiz, Japan, China, Singapur, Thailand und Taiwan. Im Berichtsjahr wurde zudem eine Tochtergesellschaft in Korea gegründet, an der die SÜSS MicroTec AG mit 100 % beteiligt ist. Bei der Süss MicroTec Korea Co. Ltd. handelt es sich um eine reine Vertriebsgesellschaft, welche die Präsenz des Konzerns in Korea verstärkt.

Im Zuge der Vereinfachung der Beteiligungsstruktur im Konzern wurden die beiden zur MFI Technologies Group zählenden Gesellschaften MFI Technologies Inc., Vancouver, und MFI Technologies Corporation, USA, die seit Jahren weder über einen aktiven Geschäftsbetrieb verfügen noch werthaltige Vermögensgegenstände halten, abgewickelt.



Daneben bestehen noch geringfügige Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:

- 10 % Zentrum für Technologiestrukturentwicklung, Glaubitz (DE)
- 10 % ELECTRON MEC S.R.L., Mailand (IT)

Diese geringfügigen Beteiligungen haben unwesentliche Bedeutung für das operative Geschäft sowie die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns.

## Leitung und Kontrolle

### Personalveränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat

Mit Wirkung zum 2. Oktober wurde Christian Schubert in den Vorstand der SÜSS MicroTec AG berufen. Der Diplom-Kaufmann folgte damit auf Dr. Stefan Schneidewind, der nach vier Jahren Vorstandstätigkeit bei SÜSS MicroTec aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens vom Aufsichtsrat der Gesellschaft abberufen wurde. Herr Schubert übernahm das Vorstandsamt interimistisch und wird bis zum Ende seiner Bestellung am 31. Mai 2009 im Vorstand verbleiben und sich dabei insbesondere der weiteren Optimierung des Einkaufs- und Beschaffungswesens sowie der Materialwirtschaft widmen.

Am 25. November 2008 wurde Frank Averdung vom Aufsichtsrat der Gesellschaft in den Vorstand und zum neuen Vorstandsvorsitzenden der SÜSS MicroTec AG berufen. Herr Averdung hat sein Amt zum 1. Februar 2009 aufgenommen und verantwortet in dieser Funktion die Bereiche Vertrieb, Marketing, Produktion und Konzernstrategie.

Im Geschäftsjahr 2008 standen zudem die turnusmäßigen Neuwahlen des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG an, in deren Zuge auch eine Verkleinerung des Aufsichtsrats von sechs auf nunmehr drei Mitglieder erfolgte. Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Juni 2008 haben die Herren Dr. Winfried Süß, Gerhard Rauter, Peter Heinz, Prof. Dr. Anton Heuberger und Heinz-Peter Verspay ihre Mandate niedergelegt. Ihnen folgten die Herren Dr. Franz Richter, Dr. Stefan Reineck und Jan Teichert nach, die jeweils mit großer Mehrheit von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt wurden.

### Vergütungsstruktur für die Organmitglieder

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Festvergütung sowie eine variable Vergütung, die bei Erreichen individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In den Festbezügen enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens mit privater Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Den Mitgliedern des Vorstands sind zusätzlich Versorgungszusagen in Form von Direktversicherungen gemacht worden. Neben diesen festen und variablen Vergütungskomponenten erhalten die Mitglieder des Vorstands eine dritte, am langfristigen Unternehmenserfolg orientierte aktienbasierte Vergütung bestehend aus Aktienoptionen gemäß dem jeweils gültigen Aktienoptionsprogramm.

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 13 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Sie wurde auf der Hauptversammlung am 19. Juni 2008 neu beschlossen. Bis zum 19. Juni 2008 galt folgende Vergütungsregelung: Jedes der insgesamt sechs Aufsichtsratsmitglieder erhielt neben dem Auslagensatz eine feste Vergütung in Höhe von 15.000,00 € pro Geschäftsjahr zuzüglich Sitzungsgeldern, wobei der Aufsichtsratsvorsitzende jeweils das Dreifache und sein Stellvertreter das Anderthalbfache der Vergütung eines einfachen Mitglieds erhielt. Seither erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 13 der Satzung folgende Vergütung:

Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500,00 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000,00 €, sein Stellvertreter 40.000,00 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000,00 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung.

## Unternehmenssteuerung, Ziele und Strategie

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere an Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Performance der Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellungskosten) sowie des Segmentergebnisses gemessen. Die Ermittlung des Segmentergebnisses wurde im Berichtsjahr geändert. Es enthält nun auch Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung und aus Anlagenabgängen. In der Summe entsprechen die Ergebnisse der Segmente nun dem operativen Ergebnis (EBIT) des Konzerns.

Weitere Steuerungskennzahl ist die Net Cash-Position (Flüssige Mittel abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt.

SÜSS MicroTec hat als Strategie die Besetzung lukrativer Spezialmärkte in der Industrie der Halbleiteraus-rüster. Ziel ist es, durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top 3-Anbieter in den relevanten Märkten zu agieren. Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunftssträchtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

## Forschung und Entwicklung

Im Folgenden werden die wesentlichen neuen Produkte und Entwicklungen der jeweiligen Segmente bzw. Untereinheiten dargestellt und erläutert.

### Lithografie

Im Geschäftsjahr 2008 wurden insgesamt zwei neue Aligner-Plattformen sowie zwei neue Technologien für Anwendungen im Bereich der Nanoimprint-Lithografie in den Markt eingeführt.

Die zweite Generation des MA300 Produktions-Mask Aligners wurde speziell für Anwendungen, wie 3D-Packaging, Wafer Bumping und Wafer Level Packaging in der Volumenproduktion entworfen, eignet sich darüber hinaus aber auch für alle weiteren Lithografie-Anwendungen, bei denen Strukturen zwischen 3 und 100 µm belichtet werden müssen. Das mit einer höheren Leistungsfähigkeit ausgestattete 300 mm-System wurde mit einer hochpräzisen Vorderseitenjustage ausgestattet und verfügt zusätzlich über eine Rückseiten- und Infrarot (IR)-Justageeinheit, die die Verarbeitung von beidseitig strukturierten Wafern sowie IR-durchlässiger Materialien wie z. B. Klebstoffen ermöglicht.

Darüber hinaus wurde die dritte Generation der manuellen Aligner-Plattform MA/BA8 vorgestellt. Der neue Mask und Bond Aligner wurde für die industrielle Forschung und anwenderunterstützte Produktion entwickelt und eignet sich für die Verarbeitung nahezu aller Arten von Wafer- und Substratmaterialien. Das flexibel einsetzbare System kann zudem schnell und einfach auf die Anforderungen neuer Technologien wie UV-Nanoimprint-Lithografie, Mikrolinsen-Imprinten, UV-Bonden und erweiterte Bond-Justage umgerüstet werden.

Zu den neuen Technologien, die SÜSS MicroTec im abgelaufenen Geschäftsjahr in das Produktportfolio aufgenommen hat, zählt auch das erste Nano Imprint Lithografie-Tool (NIL). Das neue NIL-Modul lässt sich mit geringem Aufwand auf alle manuellen Mask Aligner von SÜSS MicroTec nachrüsten und ermöglicht so insbesondere privaten und öffentlichen Forschungseinrichtungen einen kostengünstigen Einstieg in die Nanostrukturierung und das Prägen von Strukturen, die kleiner als 100nm (Nanometer) sind.

Unter dem Namen SCIL (Substrate Conformal Imprint Lithography) wurde eine weitere Technologie für das Prägen von Nanostrukturen in den Markt eingeführt. Die gemeinsam mit Philips Research und MiPlaza im niederländischen Eindhoven entwickelte Technologie ermöglicht erstmals großflächige und reproduzierbare Prägeprozesse mittels weicher Stempel im sub-50nm-Bereich. Das für die industrielle und universitäre Forschung sowie anwendergestützte Produktion konzipierte Zubehör kann auf jeden manuellen Mask Aligner von SÜSS MicroTec nachgerüstet werden und wird exklusiv über SÜSS MicroTec vertrieben. Eine entsprechende Lizenzvereinbarung wurde zwischen Philips Research und SÜSS MicroTec geschlossen.

#### Substrat Bonder

Im Geschäftsjahr 2008 konnten die Entwicklungen für den CBC200, einem 200mm-Produktions-Wafer Bonder, erfolgreich abgeschlossen werden. Das speziell für den Mikrosystemtechnik (MEMS)-Markt und das 3D-Wafer Stacking konzipierte vollautomatische Bond-System ist speziell auf die Anwendungen des Metall-Bonden ausgerichtet, indem es extremen Druck- und Temperaturverhältnissen von bis zu 90 kN bzw. bis zu 600°C standhält.

Darüber hinaus stellte SÜSS MicroTec seine neue 300mm-Wafer Bonder-Serie vor, die speziell für die Integration und das Packaging von CMOS-Bildsensoren entwickelt wurde. Das neue XBC300 Bond-System zeichnet sich durch eine hohe Durchsatzleistung sowie die Fähigkeit aus, eine Reihe von Bond-Prozessen auf der aktuell marktweit kleinsten Stellfläche auszuführen. Beide Kriterien garantieren dem Kunden optimale Produktivität bei niedrigsten Betriebskosten.

In 2008 wurde zudem der letzte bis dahin noch nicht ISO-zertifizierte Produktionsstandort, die Süss MicroTec Inc., Waterbury, USA, für die erfolgreiche Einführung seines Qualitätsmanagement-Systems nach ISO 9001 vom TÜV Süd ausgezeichnet.

### Test Systeme

Zu den Entwicklungsprojekten im Geschäftsjahr 2008 zählte u. a. die Weiterentwicklung des Test Systems PA300 ProbeShield. Zum einen wurde die thermische Stabilität des Gerätes weiter erhöht, zum anderen wurde die Eignung für die Durchführung von Rauschmessungen (1/f-Messungen) deutlich verbessert. Diese Messungen werden in zunehmendem Maße für die Device- und Wafercharakterisierung (DWC) eingesetzt. Zur Sicherung der Marktposition wurden weitere Patente auf diesem Gebiet sowie im Bereich des Modelling angemeldet.

Darüber hinaus wurden die Chucks der für den Test optoelektronischer Bauelemente eingesetzten Produktlinie PA200Blue Ray mit dem Ziel weiterentwickelt, neue Substrattypen aufnehmen zu können.

Die Familie der Cryo- und Vakuumprober wurde durch zwei weitere Systeme, den PLV 50 und den PLC 50, ergänzt. Beide Systeme wurden speziell für den Laboreinsatz an Hochschulen und Forschungsinstituten konzipiert und ermöglichen den kostengünstigen Einstieg in Test-Anwendungen auf Wafer-Level-Ebene bis zu 100mm.

Unter dem Namen ProberBench™ Operating Environment wurde zudem eine vollständig überarbeitete Software zur Testsystemsteuerung vorgestellt. Die windowsbasierte Software wurde u. a. um verschiedene Automatisierungsoptionen erweitert, die z. B. die Einrichtung unbeaufsichtigter Prüfvorgänge über Nacht oder an den Wochenenden ermöglicht und so wesentlich zur Produktivitätssteigerung beiträgt. Ebenfalls integriert wurde das neue SPECTRUM™ Vision System, das während des Testvorgangs bis zu vier verschiedene Live-Video-Ansichten für den Operator anbietet und damit wesentlich zur Eliminierung von Prüfkarten- und Wafer-Schäden beiträgt.

### C4NP

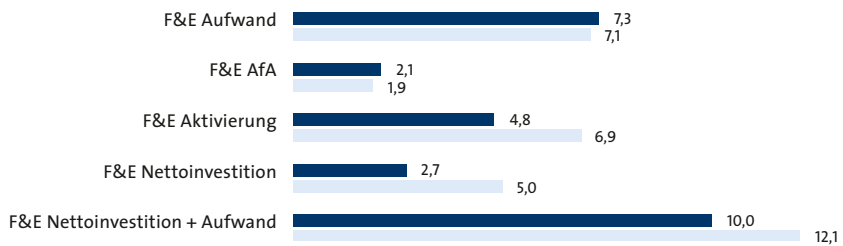
Die Entwicklung der „High-Volume-Production“-Tools für den Partner IBM konnte im Juli 2008 abgeschlossen werden. Von den insgesamt drei ausstehenden Systemen wurde eines im vierten Quartal 2008 an IBM ausgeliefert. Die Auslieferung der beiden übrigen Systeme verschob sich hingegen in das Geschäftsjahr 2009.

Der Aufwand für Forschung und Entwicklung stieg im Jahresvergleich leicht von 7,1 Mio. € auf 7,3 Mio. €. In den Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen sind im Berichtsjahr Wertminderungen in Höhe von 8,8 Mio. € enthalten. Der größte Teil dieser Wertminderungen in Höhe von 8,0 Mio. € entfiel auf das C4NP-Projekt. Zudem mussten in den Segmenten Substrat Bonder bzw. Test Systeme aktivierte Entwicklungsleistungen von 0,7 Mio. € bzw. 0,1 Mio. € wertberichtigt werden. Die Wertminderungen auf das C4NP-Projekt wurden notwendig, da es dem Konzern im Berichtsjahr nicht gelungen ist, neben der Erstinstallation bei IBM einen weiteren Kunden für die C4NP-Technologie zu gewinnen. Damit war die Erstellung eines belastbaren Umsatzszenarios für die C4NP-Maschinen nicht mehr möglich, so dass auf Basis eines im dritten Quartal durchgeführten Impairment-Tests die aktivierten Entwicklungskosten von insgesamt 8 Mio. € abgeschrieben werden mussten. Die Wertminderungen sind in der nachfolgenden Tabelle nicht enthalten.

#### F&E AUSGABEN IM JAHRESVERGLEICH

in Mio. €

■ 2008  
■ 2007



#### F&E MITARBEITER IM JAHRESDURCHSCHNITT

■ 2008  
■ 2007



## Überblick über den Geschäftsverlauf

### Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Krise an den Kreditmärkten, die im Sommer 2007 als „Subprime“-Krise begann, weitete sich im Laufe des Jahres 2008 zur globalen Finanzkrise aus und hat sich insbesondere auch im zweiten Halbjahr auf die Realwirtschaft niedergeschlagen. Dabei hat die Konjunkturdynamik vor allem in den Industrieländern wie den USA, Europa und Japan deutlich nachgelassen, aber auch in den Schwellenländern hat sich das Wachstum abgeschwächt. Das im Rahmen des ifo World Economic Survey erhobene Weltwirtschaftsklima ist Ende 2008 auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren gesunken.

Laut dem IWF hat sich das weltweite Wirtschaftswachstum im Jahr 2008 deutlich verlangsamt; das reale BIP lag nunmehr bei 3,4 %. In 2009 soll das globale Wirtschaftswachstum noch niedriger ausfallen. Die größten Risiken einer sich fortsetzenden Rezession sind dabei die erneute Ausweitung der Finanzmarktkrise sowie die deutliche Wachstumsabschwächung in China und anderen Schwellenländern sowie der Vertrauensverlust in die Finanzierungskraft der Staaten.

Die massiven Auswirkungen zeigten sich zuerst in der Automobilindustrie. Zahlreiche Autohersteller haben ihre Produktion erheblich zurückgefahren. Gegen Ende 2008 war davon bereits die gesamte Automobil-Zulieferindustrie betroffen. Aber auch andere Industriesegmente wurden von der globalen Unsicherheit beeinträchtigt und waren bei der Vergabe ihrer Aufträge dementsprechend zurückhaltend. Die Automatisierungstechnik wurde ebenso von der Krise erfasst wie der Maschinenbau. Eher stabil haben sich in Europa der private Konsum und antizyklische Märkte wie z. B. die Medizintechnik entwickelt.

Die deutsche Wirtschaft konnte im Jahr 2008 nur ein schwaches Wachstum verzeichnen. Die preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt-Rate (BIP) lag mit 1,3 % deutlich unter den Vorjahren 2007 (2,5 %) und 2006 (3,0 %). Der ifo-Geschäftsklima-Index hat sich in der zweiten Jahreshälfte 2008 kontinuierlich verschlechtert. Die Unternehmensinvestitionen werden vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise und der zunehmend restriktiveren Kreditvergabe in 2009 aller Voraussicht nach deutlich zurückgehen. Für die deutsche Wirtschaft erwartet das DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) im kommenden Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von mehr als 3 %. Der Chefsvolkswirt der Deutschen Bank hält sogar einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von 5 % für möglich (db Research, Februar 2009).

### Branchenspezifische Rahmenbedingungen

Der Vereinigung der Halbleiterindustrie Semiconductor Industry Assoziation (SIA) zufolge verzeichnete die Halbleiterbranche in 2008 den ersten Umsatzrückgang im Jahresvergleich seit der Krise im Jahr 2001. Bedingt durch die globalen Rezessionsängste gab der weltweite Halbleiterumsatz um 2,8 % auf 248,6 Mrd. US-Dollar nach (Vorjahr: 255,6 Mrd. US-Dollar). Insgesamt waren alle Bereiche von der Nachfrageschwäche betroffen. Die stärksten Rückgänge verzeichnete laut der SIA der Bereich der Speicherchips (DRAM), wo die fallenden Chippreise die Zunahme der Bestellungen ausglich. Eine deutliche Nachfrageschwäche ging jedoch auch von der Automobilindustrie sowie den Märkten für PCs, Mobiltelefonen und der Informationstechnologie für Unternehmen aus.



Nach Angaben des Fachverbands ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.) verzeichnete der deutsche Halbleitermarkt in 2008 einen Umsatzrückgang von rund 18 %. Als Ursache wurden auch hier die Folgen der globalen Wirtschaftskrise angeführt. Stärkere Impulse gingen lediglich vom Markt für Consumer Electronics aus, der in Deutschland 2008 ein Umsatzwachstum von 1,7 % auf 23,7 Mrd. € verzeichnete. Zu den Wachstumstreibern zählten hier insbesondere TV-Geräte mit LC- und Plasma-Display, portable Navigationsgeräte, digitale Audio- und Videoplayer, digitale Kameras sowie Notebooks und Spielekonsolen.

#### Unternehmensentwicklung

Trotz des seit 2007 anhaltend schwierigen Branchenumfeldes konnte die SÜSS MicroTec-Gruppe im Jahr 2008 ihre Umsätze sowie das EBIT vor Sonderbelastungen steigern. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 149,3 Mio. € und übertraf damit den Vorjahreswert von 145,6 Mio. € um 2,5 %. Der Auftrags-eingang von 139,0 Mio. € (Vorjahr: 149,7 Mio. €) spiegelt hingegen die im Zuge der weltweiten Wirtschaftskrise gestiegene Investitionszurückhaltung der Halbleiterindustrie wider.

Nachdem die SÜSS MicroTec-Gruppe beginnend mit dem vierten Quartal 2007 auch im ersten Halbjahr 2008 auftragseitig starke Quartale verzeichnen konnte, hatte das Unternehmen bereits zur Jahresmitte geringere Auftragseingänge antizipiert. Mit der Verschärfung der Finanzkrise im September 2008 und den zunehmenden Rezessionsängsten hat das Unternehmen frühzeitig mit der Umsetzung von Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen begonnen. Diese Maßnahmen umfassten sowohl einen unternehmensweiten Einstellungsstopp, generelle Einschränkungen der Reisetätigkeit (sofern sie nicht im Zusammenhang mit konkreten Kundenprojekten steht), sehr restriktive Budgetierung von Ausgaben für externe Dienstleister und Neu-Analyse und Genehmigung von Investitionsprojekten. Darüber hinaus verzichteten das Management sowie Teile der Belegschaft auf Urlaub. Im Weiteren wurde die Mitarbeiterzahl von 709 zum Vorjahresstichtag auf 674 zum Geschäftsjahresende gesenkt. Zusätzlich wurden 52 Zeitarbeiter (12 in Waterbury und 40 in Deutschland) freigesetzt.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde im Geschäftsjahr 2008 durch Sonderbelastungen insbesondere durch Wertminderungen im Bereich des immateriellen Anlagevermögens in Höhe von 18,3 Mio. € geprägt. Diese einmaligen Sonderbelastungen waren bis auf 0,8 Mio. € jedoch nicht liquiditätswirksam. Vor Berücksichtigung dieser Sonderbelastungen erhöhte sich das EBIT im Vergleich zum Vorjahr um rund 21 % auf 7,3 Mio. € (Vorjahr: 6,0 Mio. €). Inklusiv der im dritten Quartal angefallenen Sonderbelastungen betrug das EBIT hingegen -11,0 Mio. €.

In Anbetracht der konjunkturellen Eintrübung galt das Augenmerk insbesondere der Verbesserung der Liquidität sowie dem Management des Working Capitals. Hier zeigten die umgesetzten Kostensparmaßnahmen schnellen Erfolg: Die liquiden Mittel beliefen sich zum Ende des Geschäftsjahres 2008 auf 24,4 Mio. €. Die Nettoliquidität erhöhte sich im Vergleich zum 30. September 2008 signifikant um 7,9 Mio. € auf 9,4 Mio. € zum Geschäftsjahresende (Vorjahr: 7,6 Mio. €). Der Free Cashflow vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben belief sich zum Geschäftsjahresende 2008 auf 1,9 Mio. € (Vorjahr: -7,7 Mio. €).

Aufgrund der getätigten, umfangreichen Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen konnte die SÜSS MicroTec-Gruppe ihre Gewinnschwelle bereits zum Ende des Geschäftsjahres 2008 auf ein Umsatzniveau von unter 120 Mio. € senken.

Der Auftragsbestand belief sich zum 31. Dezember 2008 auf 69,7 Mio. € (Vorjahr: 77,5 Mio. €).

Das Verhältnis von neu eingegangenen Aufträgen zu realisierten Umsätzen (Book-to-Bill-Ratio) lag in 2008 bei 0,93 nach 1,03 im Vorjahr.

#### Umsätze und Auftragslage in den Regionen

Europa, Nordamerika und Asien sind die für das Geschäft von SÜSS MicroTec wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir Asien jedoch in Japan und „Sonstiges Asien“, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass unsere Kunden im Markt Advanced Packaging vornehmlich außerhalb Japans – insbesondere in Taiwan – ansässig sind. Dieser Markt ist auch schwankungsanfälliger als jener für Verbindungshalbleiter, MEMS und Test Systeme.

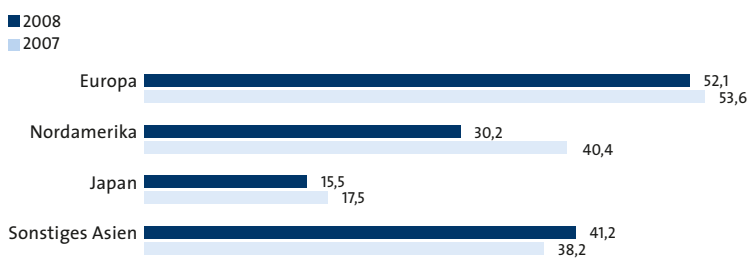
#### Auftragseingänge nach Regionen

In **Europa** sank der Auftragseingang um rund 2,8 % auf 52,1 Mio. €, nach 53,6 Mio. € im Vorjahr. Die Region **Nordamerika** verzeichnete einen Rückgang in den Auftragseingängen von 25,2 % auf 30,2 Mio. € nach 40,4 Mio. € im Jahr 2007.

Während **Japan** im Jahr 2008 mit 15,5 Mio. € rund 11,4 % weniger Aufträge als im Vorjahr (17,5 Mio. €) erzielte, konnte die SÜSS MicroTec-Gruppe in der Region **Asien** (ohne Japan) Auftragseingänge in Höhe von 41,2 Mio. € und damit 7,9 % bzw. 3,0 Mio. € mehr als im Vorjahr verzeichnen. Zu der positiven Entwicklung trug vor allem die Nachfrage von Advanced Packaging-Kunden bei, die nach ihrer Investitionszurückhaltung im Jahr 2007 im ersten Halbjahr 2008 gleich mehrere bedeutende Aufträge für Lithografie-Equipment platzierten.

#### ENTWICKLUNG DER AUFTRAGSEINGÄNGE NACH REGIONEN

in Mio. €



### Umsätze nach Regionen

Wie bereits beschrieben, konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 % auf 149,3 Mio. € gesteigert werden. Größten Anteil daran hatte die Region **Asien**. Aber auch in **Europa** verbuchte die SÜSS MicroTec-Gruppe mit 50,2 Mio. € rund 4 % mehr Umsatz als im Vorjahr.

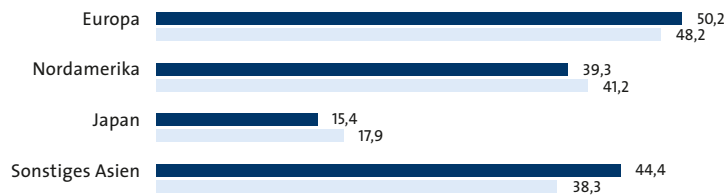
In **Nordamerika** fiel der Umsatz um rund 5 % von 41,2 Mio. € im Jahr 2007 auf 39,3 Mio. €.

In der Region **Japan** blieb der Umsatz mit 15,4 Mio. € rund 14 % unter dem Vorjahreswert von 17,9 Mio. €. Insbesondere die über das Jahr betrachtet ungünstige Wechselkurssituation des japanischen Yen wirkte sich umsatzmindernd aus.

### ENTWICKLUNG DER UMSÄTZE NACH REGIONEN

in Mio. €

■ 2008  
■ 2007



## Geschäftsentwicklung in den einzelnen Segmenten

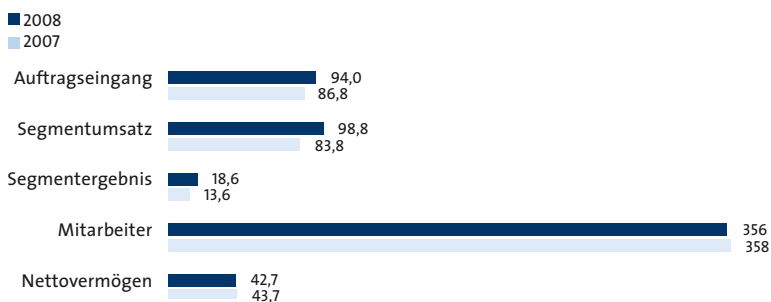
### Lithografie

Das Segment Lithografie umfasst die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner, Developer und Coater. Die Entwicklung und Produktion dieser Produktlinien sind in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Vaihingen an der Enz angesiedelt. Darüber hinaus sind wichtige Teile der Vertriebsorganisation in Nordamerika und Asien für dieses Segment tätig. Die Lithografie stellt mit einem Umsatzanteil von 66 % am Gesamtgeschäft das Kernsegment der SÜSS MicroTec-Gruppe dar. Zu den adressierten Märkten der Produktlinien zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie das Advanced Packaging und die 3D-Integration.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte sich das Segment Lithografie im Geschäftsjahr 2008 sowohl bei Umsatz und Auftragseingang, als auch im Ergebnis deutlich steigern. Der Umsatz übertraf mit 98,8 Mio. € den Vorjahreswert von 83,8 Mio. € um rund 18 %. Der Auftragseingang verbesserte sich im Jahresvergleich um rund 8 % auf 94,0 Mio. € (Vorjahr: 86,8 Mio. €). Die Nachfragesteigerung betraf dabei alle Produktlinien in gleichem Maße. Das Segmentergebnis verbesserte sich um 5,0 Mio. € bzw. 36,8 % auf 18,6 Mio. €. Die Rohertragsmarge fiel hingegen von vormals 46,9 % auf 44,4 %.

### SEGMENTÜBERSICHT LITHOGRAFIE

in Mio. €

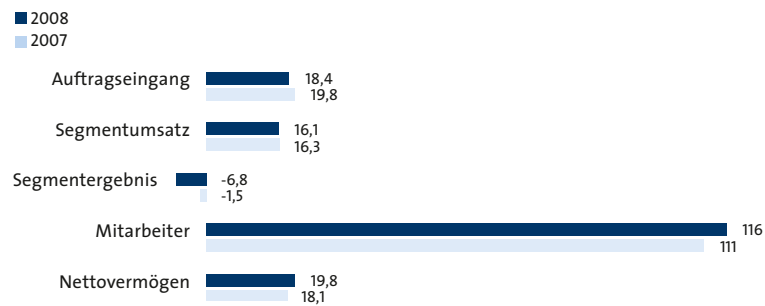


### Substrat Bonder

Das Segment Substrat Bonder beinhaltet die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb der Substrat (Wafer) Bonder, die am Standort Waterbury im US-Bundesstaat Vermont angesiedelt sind. Der Vertrieb der Bonder-Produktlinien erfolgt über Waterbury hinaus auch von kleineren Einheiten an den Standorten in Europa sowie in Asien. Zu den adressierten Märkten der Substrat Bonder zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie die 3D-Integration.

Das Segment Substrat Bonder erzielte im Geschäftsjahr 2008 mit 16,1 Mio. € einen Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 16,3 Mio. €). Der Auftragseingang ging im Jahresvergleich um rund 7 % auf 18,4 Mio. € zurück (Vorjahr: 19,8 Mio. €). Das Segmentergebnis von -6,8 Mio. € wurde im abgelaufenen Jahr durch Sonderbelastungen in Höhe von insgesamt 3,8 Mio. € geprägt. Diese Sonderbelastungen setzten sich aus Wertminderungen auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Demo-Equipment in Höhe von 1,8 Mio. € sowie Wertberichtigungen auf ein Kundenprojekt in Höhe von 1,9 Mio. € zusammen. Des Weiteren wirkten sich Abfindungszahlungen in Höhe von 0,1 Mio. € belastend auf das Ergebnis aus. Die Rohertragsmarge fiel dementsprechend von 31,3 % auf 6,0 %.

**SEGMENTÜBERSICHT SUBSTRAT BONDER**  
in Mio. €



**Test Systeme**

Das Segment Test Systeme umfasst die Entwicklung, die Produktion sowie den europaweiten Vertrieb und ist in Sacka bei Dresden angesiedelt. Mit einem Umsatzbeitrag von rund 17 % zum Gesamtgeschäft der SÜSS MicroTec-Gruppe stellen die Test Systeme das zweitgrößte Segment des Konzerns dar. Dementsprechend sind in den internationalen Vertriebsgesellschaften (Nordamerika und Asien) des Konzerns nach der Lithografie die meisten Mitarbeiter für das Segment Test Systeme tätig. Zu den adressierten Märkten der Test Systeme zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie der Halbleiter-Engineering-Bereich.

Das Segment Test Systeme erzielte in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld 2008 einen Umsatz von 25,0 Mio. € (Vorjahr: 27,8 Mio. €) sowie einen Auftragseingang von 20,8 Mio. € nach 29,9 Mio. € im Vorjahr. Anhaltender Wettbewerbsdruck und in der Folge ausgelöster Margendruck wirkten sich negativ auf das Segmentergebnis aus, das zudem durch Sonderbelastungen in Höhe von insgesamt 1,1 Mio. € geprägt ist. Diese Sonderbelastungen setzten sich vornehmlich aus Wertminderungen auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Demo-Equipment in Höhe von 0,5 Mio. € sowie Abfindungen in Höhe von 0,3 Mio. € zusammen.

#### SEGMENTÜBERSICHT TEST SYSTEME

in Mio. €

■ 2008  
■ 2007



### Segment Sonstige

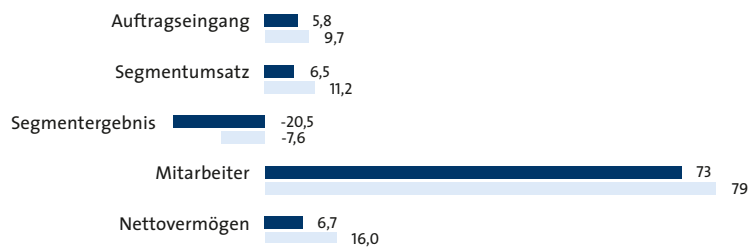
Das Segment Sonstige beinhaltet neben dem Maskengeschäft für die Halbleiterindustrie (Palo Alto, Kalifornien, USA) auch die Mikrooptik-Aktivitäten am Standort Neuchâtel, Schweiz, sowie das Geschäftsfeld C4NP. Ebenfalls im Segment Sonstige enthalten sind die größtenteils nicht auf Segmentebene zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen.

Das Geschäftsfeld Mikrooptik erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von 1,8 Mio. € nach 3,5 Mio. € im Vorjahr. Im Maskengeschäft verringerte sich der Umsatzbeitrag von 6,3 Mio. € im Vorjahr auf 3,7 Mio. €. Grund für die deutlich schwächere Entwicklung des Maskengeschäfts waren Probleme eines Schlüsselkunden sowie das anhaltend schwierige Marktumfeld. Vor dem Hintergrund dieser veränderten Umsatz- und Ertragslage wurde der dem Maskengeschäft zugeordnete Geschäfts- oder Firmenwert neu bewertet, was Auswirkungen auf das Segmentergebnis hatte. Insgesamt wurde das Segmentergebnis von -20,5 Mio. € durch Sonderbelastungen in Höhe von 12,9 Mio. € geprägt. Davon entfielen 8,0 Mio. € auf Wertminderungen für aktivierte Entwicklungsleistungen des Geschäftsfeldes C4NP sowie 4,4 Mio. € auf Wertminderungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert des Maskengeschäfts. Des Weiteren belasteten vor allem Abfindungen von 0,4 Mio. € das Segmentergebnis.

### SEGMENTÜBERSICHT SONSTIGE

in Mio. €

■ 2008  
■ 2007



## ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

### Ertragslage

Das Ergebnis des Jahres 2008 wurde durch Sonderbelastungen in Höhe von 18,3 Mio. € insbesondere im immateriellen Anlagevermögen geprägt. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) verschlechterte sich dadurch auf -11,0 Mio. € (Vorjahr: 6,0 Mio. €). Die durchaus intakte Entwicklung des operativen Geschäfts zeigt das um die Sonderbelastungen bereinigte EBIT, das bei 7,3 Mio. € oder um 1,3 Mio. € über dem Wert des Vorjahres lag.

Die einmaligen im dritten Quartal vorgenommenen Sonderbelastungen in Höhe von 18,3 Mio. € setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- + Wertminderungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen für C4NP in Höhe von 8,0 Mio. €.
- + Wertminderungen auf den Wertansatz des Geschäfts- oder Firmenwerts der US-amerikanischen Tochtergesellschaft Image Technology Inc. in Höhe von 4,4 Mio. €.
- + Wertminderungen auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Demo-Maschinen in Höhe von 2,7 Mio. €, insbesondere bei der Süss MicroTec Inc.
- + Abfindungsaufwendungen in Höhe von 0,8 Mio. €.
- + Wertberichtigung für ein Kundenprojekt in Höhe von 1,9 Mio. €.
- + Sonstiges in Höhe von 0,5 Mio. €.

Bis auf 0,8 Mio. € waren die Sonderbelastungen nicht liquiditätswirksam.

Der Rohertrag reduzierte sich um 14,3 Mio. € von 60,9 Mio. € auf 46,6 Mio. €, die Rohertragsmarge von 41,8 % auf 31,2 %. Der um Sonderbelastungen bereinigte Rohertrag lag bei 60,0 Mio. €, die Rohertragsmarge bei 40,2 %.

Der Rohertrag wurde auch im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die Entwicklung der Wechselkurse von US-Dollar und japanischen Yen negativ beeinflusst. Zudem waren abermals zusätzliche Kosten von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €) für die an IBM noch auszuliefernden C4NP-Produktionsanlagen zu buchen.

Die Kosten für Verwaltung und Vertrieb reduzierten sich im Jahresvergleich um 0,5 Mio. € von 46,8 Mio. € auf 46,3 Mio. €. Dabei verminderten sich die Kosten im Bereich Verwaltung von 20,6 Mio. € auf 19,5 Mio. €, wohingegen sich die Kosten für den Bereich Vertrieb von 26,1 Mio. € auf 26,8 Mio. € erhöhten. Die Kosten für Forschung und Entwicklung erhöhten sich leicht von 7,1 Mio. € auf 7,3 Mio. €.

Im Berichtsjahr wurde trotz des negativen Ergebnisses vor Steuern ein Steueraufwand in Höhe von 2,1 Mio. € gebucht. Dies ist vor allem auf Wertberichtigungen latenter Steueransprüche in Höhe von 2,7 Mio. € zurückzuführen (Vorjahr: Zuschreibung 1,0 Mio. €).

Im Konzern ergab sich ein Jahresergebnis in Höhe von -13,9 Mio. € (Vorjahr: 4,5 Mio. €). Das Ergebnis je Aktie betrug -0,82 € nach 0,26 € im Vorjahr.

Der Umsatz pro Mitarbeiter erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 % von 198 T€ auf 214 T€.



## Finanz- und Vermögenslage

Unser Ziel, stets eine ausreichende kurzfristige Liquiditätsreserve für das operative Geschäft zu halten, wurde auch im Jahr 2008 deutlich erreicht. Neben dem Bestand an Barmitteln in Höhe von 20,6 Mio. € (Vorjahr: 20,1 Mio. €) und kurzfristig zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren in Höhe von 3,8 Mio. € (Vorjahr: 0,0 Mio. €) kann der Konzern auf Kreditlinien in Höhe von insgesamt 10,4 Mio. € (Vorjahr: 16,2 Mio. €) zurückgreifen. Die Kreditlinien sind nicht an sogenannte „Financial Covenants“ gebunden. Zum Bilanzstichtag lagen dem Konzern Kreditzusagen von zwei Banken über eine inländische Kreditlinie in Höhe von 6,0 Mio. € vor. Mit einer dieser Banken wurden die erforderlichen Kreditverträge noch im Berichtsjahr unterzeichnet, so dass ein Teil der Linie von 3,0 Mio. € zum Bilanzstichtag effektiv zur Verfügung stand. Die Kreditvereinbarung mit der zweiten Bank des Konsortiums wurde im Januar 2009 unterschrieben. Die Linien sind banküblich besichert und zunächst bis zum 31. März 2009 befristet.

Der Zufluss an liquiden Mitteln aus dem operativen Geschäft konnte gegenüber dem Wert des Vorjahres deutlich gesteigert werden. Der operative Cashflow erhöhte sich von 1,5 Mio. € auf 9,4 Mio. €. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit ohne Berücksichtigung des Erwerbs von kurzfristig zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr von 9,2 Mio. € auf 7,5 Mio. €. Damit ergab sich ein positiver Free Cashflow in Höhe von 1,9 Mio. € (Vorjahr: -7,7 Mio. €). Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit betrug 1,4 Mio. € gegenüber 7,8 Mio. € im Vorjahr. Ursächlich für den Rückgang war die Ausgabe von Schuldscheindarlehen in Höhe von 9,0 Mio. € im Vorjahr.

Die Net Cash Position – der Saldo aus Geldmitteln und Finanzschulden – hat sich im Jahresverlauf leicht verbessert. Der zum Jahresende 2007 vorhandene positive Saldo in Höhe von 7,6 Mio. € erhöhte sich in 2008 auf 9,4 Mio. €. Der Konzern verfügt damit über ausreichenden finanziellen Spielraum, um in dem für die kommenden Quartale erwarteten sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu bestehen und notwendige Produktentwicklungen oder andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Neben dem Geschäfts- oder Firmenwert bestimmen im Wesentlichen die aktivierten Entwicklungskosten die langfristigen Vermögenswerte. Der Geschäfts- oder Firmenwert ist den Segmenten Lithografie (13,6 Mio. €, Vorjahr: 13,6 Mio. €) und Test Systeme (4,2 Mio. €, Vorjahr: 4,1 Mio. €) zugeordnet. Der dem Maskengeschäft im Segment Sonstige zugeordnete Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 4,4 Mio. € wurde im Berichtsjahr vollständig wertberichtigt. Die Position „Entwicklungskosten“ reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr von 16,2 Mio. € auf 10,3 Mio. €. Der deutliche Rückgang ist auf Wertminderungen in Höhe von 8,8 Mio. € zurückzuführen, wobei 8,0 Mio. € dem Projekt „C4NP“ zuzuordnen sind. Zum Bilanzstichtag werden keine aktivierten Entwicklungskosten mehr für dieses Projekt ausgewiesen (Vorjahr: 7,8 Mio. €). Weiterhin sind jeweils aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 3,5 Mio. € (Vorjahr: 2,9 Mio. €) für das Segment Lithografie, 6,5 Mio. € (Vorjahr: 5,1 Mio. €) für das Segment Substrat Bonder und 0,4 Mio. € (Vorjahr: 0,4 Mio. €) für das Segment Test Systeme enthalten. Darüber hinaus sind Restbuchwerte in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €) für erworbene Lizenzen und Patente der Segmente Lithografie und Substrat Bonder enthalten sowie 3,3 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €) im Segment Sonstige. Der Anstieg von letzterem ist in der begonnenen gruppenweiten Einführung des ERP-Systems SAP begründet, die mit dem Going Live von drei Konzerngesellschaften in Deutschland am 1. Juli 2008 einen erfolgreichen Zwischenabschluss fand.

Das Sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeutung für die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenintensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen ist. Das Sachanlagevermögen veränderte sich nur unwesentlich und stieg von 5,0 Mio. € im Vorjahr auf 5,4 Mio. € an. Die latenten Steueransprüche reduzierten sich im Wesentlichen in Folge des Verbrauchs aktivierter Verlustverträge bei der Süss MicroTec Lithography GmbH im Geschäftsjahr um 1,4 Mio. € und belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 9,1 Mio. €.

Zusammenfassend reduzierten sich die langfristigen Vermögenswerte vor allem aufgrund der Wertminderungen des Geschäfts- oder Firmenwerts und aktivierter Entwicklungskosten deutlich um 9,5 Mio. € von 58,1 Mio. € auf 48,6 Mio. €.

Beim Working Capital veränderte sich der Lagerbestand der Vorräte von 53,8 Mio. € auf 54,6 Mio. €, wobei der Anteil der Fertigerzeugnisse von 6,8 Mio. € auf 10,9 Mio. € anstieg. Insgesamt war die Lagerentwicklung auch im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht zufriedenstellend. Durch die im Verlauf des zweiten Halbjahres verstärkten Anstrengungen, den Lagerbestand zu senken, konnten im vierten Quartal erste sichtbare Erfolge insbesondere im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erzielt werden. Unterstützt werden diese Anstrengungen durch die konzernweit stattfindende Einführung des ERP-Systems SAP, das zum 1. Juli 2008 bei den ersten drei deutschen Gesellschaften Live gegangen ist und durch das erstmalig eine durchgehende, gesellschaftsübergreifende Steuerung der Lagerbestände ermöglicht wird.

Die Kundenanzahlungen erhöhten sich deutlich um 5,1 Mio. € von 14,3 Mio. € auf 19,4 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote reduzierte sich im Jahresvergleich von 62,8 % auf 59,0 %.

#### Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Zusammenfassend erzielte SÜSS MicroTec im Geschäftsjahr 2008 ein negatives Konzern- EBIT von 11,0 Mio. €, das von einmaligen Sonderbelastungen in Höhe von 18,3 Mio. € geprägt war. Vor der Berücksichtigung der Sonderbelastungen erreichte der Konzern ein EBIT von 7,3 Mio. € und stellt somit unter Beweis, auch in einem schwierigen Marktumfeld in der Lage zu sein, deutlich profitabel zu bleiben.

In Folge der operativen Ergebnisperformance und der verbesserten Nettoliquidität verfügt die Gesellschaft über ausreichend finanziellen Spielraum, um in dem erwarteten sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu bestehen und die notwendigen Produktentwicklungen sowie andere strategische Aktivitäten finanzieren zu können.

## Investitionen

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen in Sachanlagen keine wesentliche Komponente in der Unternehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen langfristig in einem Bereich von ca. 2 bis 3 % des Umsatzes bewegen werden. Ausnahmen stellen nur die in dem Segment Sonstige enthaltenen Produktlinien „Masken“ und „Mikrooptik“ dar. In beiden Fällen wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind. Investitionen in diesen Bereichen führen unmittelbar zu einem deutlichen Anstieg der Sachanlage-Investitionen im Konzern.

Der größere Anteil der Investitionen ist dem Bereich immaterielle Vermögenswerte zuzuordnen, da unter Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nach IFRS eine Aktivierungspflicht besteht. Dominierende Projekte in 2008 waren die Fertigungsentwicklung einer kommerziellen C4NP-Linie, die aus mehreren Maschinen besteht, sowie die Erweiterung der Produktpalette im Segment Substrat Bonder. Wir gehen langfristig davon aus, dass rund 25 bis 35 % der Ausgaben für Forschung und Entwicklung aktiviert werden und der verbleibende Betrag aufwandswirksam erfasst wird.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde mit der gruppenweiten Einführung des ERP-Systems SAP begonnen. Im Rahmen des Projekts werden in den kommenden zwei bis drei Jahren Investitionen in Soft- und Hardware von rund 3 Mio. € vorgenommen werden. Das Volumen des Gesamtprojekts beträgt 6 Mio. €.

## Die Holding – SÜSS MicroTec AG

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für Corporate Identity, Investor Relations und Marketing verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt die Holding die Finanzierung von strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der operativen Tochtergesellschaften. Wie im Falle C4NP geschehen, übernimmt die Holding auch Prinzipalfunktion, soweit dies aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen sinnvoll erscheint.

Die SÜSS MicroTec AG ist in der Regel alleinige Anteilseignerin an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften und durch Zinserträge aus den Ausleihungen an Tochterunternehmen.

## DARSTELLUNG DER FINANZIELLEN KENNZAHLEN DER HOLDING

Gesellschaft in T€	SMT AG (HGB)			
	2008	2007	Änderung	in %
Jahresfehlbetrag	-406	-2.837	2.431	86 %
Eigenkapital	96.400	96.177	223	0 %
Bilanzsumme	119.623	112.141	7.482	7 %
EK-Quote in %	81 %	86 %		
Anlagevermögen	95.881	84.406	11.475	14 %
% der Bilanzsumme	80 %	75 %		
Umlaufvermögen	23.742	27.735	-3.993	-14 %
% der Bilanzsumme	20 %	25 %		

## Wesentliche Veränderungen der Vermögens- und Finanzlage

In Folge der Einführung des ERP-Systems SAP bei drei Konzerngesellschaften erhöhten sich die immateriellen Vermögensgegenstände um 2,0 Mio. € und belaufen sich zum Stichtag auf 3,2 Mio. €.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Ausleihungen an die Suss MicroTec Inc. in Höhe von 22,2 Mio. € in Eigenkapital umgewandelt. Daraus resultiert einerseits der Anstieg der Anteile an verbundenen Unternehmen und andererseits der Rückgang der Ausleihungen an verbundene Unternehmen. Gegenläufig wirkten sich die planmäßigen Tilgungen in Höhe von 5,6 Mio. € aus.

Die kurzfristigen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen gingen um 10,8 Mio. € zurück. Der Rückgang der kurzfristigen Forderungen ist hauptsächlich auf die Rückführung kurzfristiger Darlehen der Suss MicroTec Lithography GmbH, der Suss MicroTec Inc. und der Suss MicroTec KK. zurückzuführen.

Der wesentliche Teil dieser Rückführung durch die Suss MicroTec Inc. beruht auf der Verrechnung der Kaufpreisforderung von 5,0 Mio. € aus der Übertragung der Anteile (50 %) an der Suss MicroTec Test Systems GmbH an die SÜSS MicroTec AG mit entsprechenden Darlehensverbindlichkeiten.

Die SÜSS MicroTec AG konnte im Berichtsjahr ihre Liquiditätsposition ausbauen. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem positiven Free Cashflow der über das Konzern-Cashpooling mit der AG verbundenen Tochtergesellschaften. Der Ausbau der Liquiditätsposition wird sowohl im Anstieg der Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 3,2 Mio. € als auch im Erwerb von Wertpapieren in Höhe von 3,8 Mio. € sichtbar. Bei den Wertpapieren handelt es sich ausschließlich um Anleihen von Unternehmen, die über ein Rating im Investmentgradebereich verfügen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen erhöhten sich im Berichtsjahr von 4,8 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 11,2 Mio. €. Ursächlich für diesen Anstieg war im Wesentlichen die positive Entwicklung der Finanzlage der Suss MicroTec Lithography GmbH. Die hieraus resultierenden Cashflows wurden über das bestehende Cashpooling auf Bankkonten der SÜSS MicroTec AG transferiert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten blieben im Verlauf des Jahres 2008 unverändert und bestehen weiterhin aus den im Dezember 2012 fälligen Schuldscheindarlehen.

Die Veränderung des Eigenkapitals (0,2 Mio. EUR) resultiert aus dem Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres (0,4 Mio. EUR) und den Zuführungen zur Kapitalrücklage (0,6 Mio. EUR) aufgrund bestehender Aktienoptionspläne.

### Wesentliche Ereignisse mit Einfluss auf die Ertragslage der Holding

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2008 ein Jahresfehlbetrag von 0,4 Mio. € (Vorjahr: -2,8 Mio. €).

Aufgrund des vorhandenen Gewinnabführungsvertrags mit der Suss MicroTec Test Systems GmbH, Sacka, wurde bei der Holding ein Verlust in Höhe von 2,0 Mio. € (Vorjahr: -0,04 Mio. €) ergebniswirksam gebucht. Aufgrund des im Geschäftsjahr 2008 geschlossenen Gewinnabführungsvertrags mit der Suss MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, wurde bei der Holding ein Gewinn in Höhe von 0,6 Mio. € ergebniswirksam vereinnahmt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind überwiegend Fremdwährungsgewinne in Höhe von 3,1 Mio. € enthalten (Vorjahr: 1,4 Mio. €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Weiterbelastung von Entwicklungsleistungen in Höhe von 0,7 Mio. € (Vorjahr: 2,2 Mio. €) im Rahmen des C4NP-Projekts sowie Fremdwährungsverluste in Höhe von 2,4 Mio. € (Vorjahr: 3,4 Mio. €). Die Kosten aus selbst erbrachten Entwicklungsleistungen werden gemäß den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften nicht aktiviert.

Die Erträge aus Beteiligungen in Höhe von 2,7 Mio. € (Vorjahr: 0,0 Mio. €) enthalten Ausschüttungen der beiden Tochtergesellschaften Suss MicroTec Ltd., Coventry, und Suss MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu.

Aufgrund veränderter Geschäftsmodelle mit einer Reduzierung der bisher ausgeübten Vertriebstätigkeiten bei den Tochtergesellschaften in Frankreich und England wurden im Berichtsjahr Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 1,9 Mio. € notwendig. Diese entfielen in Höhe von 1,4 Mio. € auf den Beteiligungsansatz an der Suss MicroTec SAS, Lyon, und in Höhe von 0,5 Mio. auf den Beteiligungsansatz an der Suss MicroTec Ltd., Coventry.

Die Zinsaufwendungen erhöhten sich im Geschäftsjahr um 1,0 Mio. €, was im Wesentlichen auf die Zinsen für das Schuldscheindarlehen in Höhe von 0,5 Mio. € und den negativen Marktwert des Zinsswaps für einen Teil des Schuldscheindarlehens in Höhe von 0,4 Mio. € zurückzuführen ist.

In der SÜSS MicroTec AG waren im Geschäftsjahr 2008 durchschnittlich 20 (Vorjahr: 17 Beschäftigte) Mitarbeiter tätig.

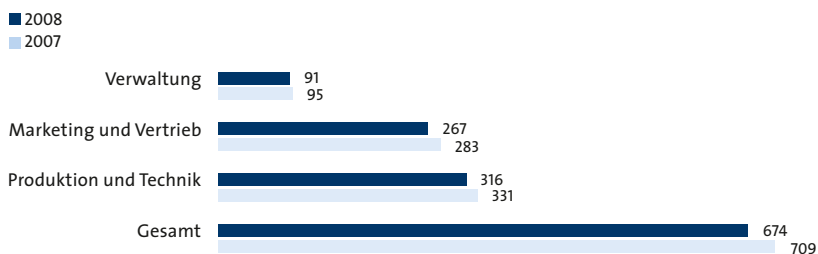
Neben der Entwicklung des US-Dollars hängt die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SÜSS MicroTec AG vor allem von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentlicher Tochtergesellschaften ab. Die Finanz- und Ertragslage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die Höhe des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und für die Ausschüttung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft.

### Mitarbeiter im Konzern

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. Auch die Anlernzeiten, insbesondere im technischen Bereich, sind aufgrund der sehr spezifischen Produkte länger als ein Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung Grundvoraussetzungen für die Erhaltung bestehender und für die Anwerbung qualifizierter neuer Mitarbeiter.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2008 waren 674 (Vorjahr: 709; -4,9 %) Mitarbeiter in den einzelnen Unternehmen des Konzerns beschäftigt.

#### ENTWICKLUNG DER MITARBEITER-ZAHLEN NACH BEREICHEN



## ANGABEN GEMÄSS § 315 ABS. 4 HGB

Das gezeichnete Kapital der SÜSS MicroTec AG in Höhe von 17.019.126 € ist aufgeteilt in 17.019.126 nennwertlose, stimmberechtigte Stückaktien. Es bestehen keine unterschiedlichen Aktiengattungen.

Es bestehen keine Beschränkungen bezüglich der Stimmrechte oder der Übertragung von Aktien.

Zum Bilanzstichtag hält Herr Tito Tettamanti eine Beteiligung am Kapital der SÜSS MicroTec AG von 20,07 % (Vorjahr: 10,34 %). Die ihm zugerechneten Stimmrechte werden dabei von der Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands, sowie der Gritlot Limited, Douglas, Isle of Man, gehalten, die von Herrn Tettamanti kontrolliert werden. Weitere direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der SÜSS MicroTec AG, die 10 % überschreiten, gibt es zum Bilanzstichtag nicht.

Sonderrechte von Aktionären, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht. Über die bestehenden Aktienoptionspläne sind Arbeitnehmer nach Ausübung ihrer Optionen am Kapital der Gesellschaft beteiligt. Die ihnen hieraus entstehenden Kontrollrechte üben sie unmittelbar aus.

Die Regelungen zur Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern der SÜSS MicroTec AG ergeben sich aus den §§ 84 f. AktG. Die Satzung enthält diesbezüglich keine weitergehenden Regelungen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt gemäß § 7 der Satzung der Aufsichtsrat. Dieser kann auch ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstands und ein weiteres Mitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.

Satzungsänderungen sind in den §§ 133, 179 AktG geregelt. Die Befugnis zu Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, wurde gemäß § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG an den Aufsichtsrat delegiert.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 19. Juni 2013 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 4.254.775 T€ durch Ausgabe von bis zu 4.254.775 neuen Stückaktien gegen Bar- und Sacheinlage zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Die von der Hauptversammlung am 16. Juni 2004 beschlossene Ermächtigung, in der Zeit bis zum 16. Juni 2009 das Grundkapital um bis zu insgesamt 6.022.358 € durch Ausgabe von bis zu 6.022.358 neuen Aktien gegen Bar- und Sacheinlage zu erhöhen, ist auf der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 aufgehoben worden.

Die im Vorjahr geschlossenen Schuldscheinverträge beinhalten eine Change-of-Control-Klausel. Demzufolge haben die Darlehensgeber die Möglichkeit zur außerordentlichen Kündigung, wenn eine oder mehrere Personen, die nicht dem Kreis der bestehenden Hauptaktionäre zuzurechnen sind, eine Anzahl von Aktien an der SÜSS MicroTec AG halten oder erworben haben, auf die 50 % oder mehr der Stimmrechte entfallen. Weitere wesentliche Vereinbarungen der SÜSS MicroTec AG, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels in Folge eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht.

Entschädigungsvereinbarungen o. ä. mit Arbeitnehmern bzw. Mitgliedern des Vorstands für den Fall eines Übernahmeangebots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen Regelungen bezüglich der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte und hieraus resultierenden Kontrollmöglichkeiten, weder durch Einrichtung besonderer Aktiegattungen noch durch Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen. Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Vorschriften über die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vorhanden. Wesentliche Geschäftsbereiche oder Aktivitäten der SÜSS MicroTec AG können mit Ausnahme des Schuldscheindarlehens im Fall eines Übernahmeangebots durch vorliegende „Change-of-Control“-Klauseln nicht wegfallen.

## CORPORATE GOVERNANCE

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG sehen sich in einem hohen Maße einer guten Corporate Governance verpflichtet. Wie bereits in den Vorjahren haben Vorstand und Aufsichtsrat deshalb am 7. November 2008 die Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG erneut abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 14. Juni 2007 mit zwei Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung und Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern – entsprochen haben und zukünftig der aktualisierten Fassung vom 6. Juni 2008 mit drei Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, Bildung von Ausschüssen und Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern – entsprechen werden. Auf den separaten Corporate Governance Bericht im Geschäftsbericht 2008 wird verwiesen (siehe Seiten 32 bis 42).

## NACHTRAGSBERICHT

Am 7. Januar 2009 hat uns Herr Dr. Winfried Süß, Deutschland, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 31. Dezember 2008 die Schwellen von 5 % und 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 0 % beträgt (0 Stimmrechte).

Am 7. Januar 2009 hat uns die Süß SCS, Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 31. Dezember 2008 die Schwellen von 3 % und 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 7,53 % beträgt (1.281.000 Stimmrechte).

Am 7. Januar 2009 hat uns die Falcivest, SCS Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 31. Dezember 2008 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,04 % beträgt (518.194 Stimmrechte).

Am 7. Januar 2009 hat uns die Falcivest SCS, Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 2. Januar 2009 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,99 % beträgt (508.194 Stimmrechte).



Am 7. Januar 2009 hat uns die Terramater (Stichting), Amsterdam, Niederlande, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 31. Dezember 2008 die Schwellen von 3 %, 5 % und 10 % überschritten hat und zu diesem Tag 10,57 % beträgt (1.799.194 Stimmrechte). Davon werden ihr 10,57 % (1.799.194 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet. Die der Terramater zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Süss SCS, Strassen, Luxemburg
- + Falcivest SCS, Strassen, Luxemburg

Am 7. Januar 2009 hat uns die Crest Capital S.A., Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 31. Dezember 2008 die Schwellen von 3 %, 5 % und 10 % überschritten hat und zu diesem Tag 10,57 % beträgt (1.799.194 Stimmrechte). Davon werden ihr 10,57 % (1.799.194 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet. Die der Crest Capital S.A. zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Süss SCS, Strassen, Luxemburg
- + Falcivest SCS, Strassen, Luxemburg

Am 23. Januar 2009 hat uns die Falcivest SCS, Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2009 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,02 % beträgt (513.194 Stimmrechte).

## RISIKOBERICHT

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

### Allgemeine wirtschaftliche Risiken und Branchenrisiken

#### Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Unser Geschäftsumfeld wird durch die regionalen wie auch die weltweiten konjunkturellen Bedingungen beeinflusst. Ausgelöst durch die Fehlentwicklung auf dem US-Hypothekenmarkt unterlagen die Kapital- und Kreditmärkte im Berichtsjahr erheblichen Schwankungen und Verzerrungen und verursachten eine weltweite Finanzkrise. Diese belastete im Berichtsjahr die globale gesamtwirtschaftliche Entwicklung insbesondere in den USA und anderen Industrienationen. Für 2009 sind weitere negative Rückkoppelungseffekte vom Finanzsektor auf den Gütermarkt zu erwarten. Sollten die beschlossenen wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen nicht dazu beitragen, dass allmählich wieder Vertrauen in den Finanzmarkt zurückkehrt, erhöht sich das Risiko einer noch tieferen und länger anhaltenden Rezession. Liquiditätsprobleme der

Banken schränken dann die Kreditvergabe weiter ein, die Investitionen geben noch stärker nach und eine höhere Arbeitslosigkeit sowie ein nachlassender Konsum würden die konjunkturellen Perspektiven auch in den Schwellenländern zusätzlich belasten.

Im Fall des Andauerns oder einer Ausweitung von Finanzmarktkrise und Rezession kann nicht garantiert werden, dass sie keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben werden. Die gegenwärtige Kreditverknappung auf den Finanzmärkten könnte beispielsweise die Finanzierungsmöglichkeiten unserer Kunden erschweren, was zur Folge haben kann, dass sich Kaufabsichten bezüglich unserer Produkte ändern, verzögern oder Transaktionen nicht durchgeführt werden. Vor diesem Hintergrund können auch Stornierungen bereits erteilter Aufträge nicht ausgeschlossen werden. Zudem kann eine unzureichende Generierung von Umsätzen oder ein erschwerter Zugang zu den Kapitalmärkten bei unseren Kunden dazu führen, dass sie nicht in der Lage sind, ausstehende Rechnungen fristgerecht oder vollständig zu begleichen. Dadurch könnten unser Ergebnis und unsere Cashflows negativ beeinflusst werden.

Zahlreiche andere Faktoren, wie Schwankungen bei den Energie- und Rohstoffpreisen sowie globale politische Konflikte, einschließlich der Situation im Nahen und Mittleren Osten und in anderen Regionen, wirken sich weiterhin auf makroökonomische Faktoren sowie die internationalen Kapitalmärkte aus. Unsicherheiten hinsichtlich der politischen und wirtschaftlichen Bedingungen können die Nachfrage nach unseren Produkten beeinträchtigen und unsere Budgetierung wie auch unsere Prognosen erschweren.

#### Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung

Die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Insbesondere die Halbleiterindustrie, die zu unseren Absatzmärkten zählt, ist von starken Marktzyklen geprägt. Diesen Risiken begegnen wir durch schlanke Strukturen, die bei schwacher Geschäftsentwicklung zügig angepasst und gegebenenfalls durch Outsourcing ergänzt werden können.

#### Marktpositionierung

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs könnten Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere, effizientere oder günstigere Lösungen für das gleiche Problem bieten würden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch gezielte Forschung und Entwicklung und durch einen laufenden Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Kunden.

#### Abhängigkeit von einzelnen „Know-how-Trägern“

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter stellt für die Gruppe ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

## Betriebliche Risiken

### Vermögens- und Ertragslage

In Folge einer sich weiter verschärfenden Rezession kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Konzern seine für 2009 gesteckten Umsatzziele nicht erreichen kann. Durchgeführte und derzeit laufende Kosteneinsparmaßnahmen könnten demzufolge nicht ausreichen, um ein positives operatives Ergebnis zu erzielen. Wir begegnen diesem Risiko durch eine konsequente Auswertung der zur Verfügung stehenden Frühindikatoren, vor allem unseres Auftragseingangs. Wir verfügen bereits heute über einen weiteren Katalog von möglichen Maßnahmen zur Absenkung unseres Break-even-Umsatzes, dessen Ergebnisauswirkungen allerdings teilweise erst in 2010 wirksam würden. Eine – über die aufgestellte Konzernplanung hinausgehende – Verschlechterung der Ertragslage könnte in der Konzernbilanz Wertminderungen im Rahmen künftiger Impairment-Tests notwendig machen. Dies hätte sowohl die Abwertung von Aktivwerten der Holding als auch des Konzerns zur Folge. Diese Wertminderungen hätten Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage, würden aber nicht liquiditätswirksam werden.

### Preisdruck

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten.

### Rechtliche Risiken, insbesondere Haftungsrisiken

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert.

## Finanzmarktrisiken

### Kreditrisiken

Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmitteln oder Erträgen. Dieser tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Fälligkeit nachzukommen, oder die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte an Wert verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gültige Richtlinie zum Thema „Credit Assessment“ implementiert. Diese Richtlinie legt für die einzelnen Vertriebs-einheiten des Unternehmens fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen im Einzelfall unter Berücksichtigung kunden- und länderspezifischer Aspekte vereinbart werden. Aufträge mit Kunden, die in sog. „Risk Countries“ angesiedelt sind, können demzufolge nur gegen Anzahlung des gesamten Auftragswerts, einer Bankgarantie oder eines Letter of Credit abgewickelt werden. Im Fall von Kunden, die in sog. „Non Risk Countries“ ansässig sind und eine bestimmte Größenordnung überschreiten, wird ein entsprechendes Kundenrating erstellt. Die Ratings beruhen auf den Angaben externer Kreditratingagenturen. Je nach Einstufung des Kunden sind für die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw. -absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 24,1 Mio. € (Vorjahr: 26,1 Mio. €) sind zum Bilanzstichtag insgesamt 13,3 Mio. € (Vorjahr: 15,4 Mio. €) der Forderungen weder überfällig noch wertgemindert. Bei diesen Forderungen lagen zum 31. Dezember 2008 keine Anhaltspunkte vor, dass Zahlungsausfälle eintreten werden.

Die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgeminderten Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag wie folgt dar:

#### Altersanalyse der überfälligen Forderungen ohne Wertberichtigung

in T€	2008	2007
1 – 30 Tage	4.962	5.103
31 – 60 Tage	3.414	2.501
61 – 90 Tage	999	1.660
<b>Überfällige Forderungen ohne Wertberichtigung</b>	<b>9.375</b>	<b>9.264</b>

Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €) des Bruttoforderungsbestands überfällig und wertberichtigt. Die Altersstruktur der überfälligen und wertberichtigten Forderungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in folgender Tabelle dargestellt:

#### Altersanalyse der überfälligen Forderungen mit Wertberichtigung

in T€	2008	2007
91 – 180 Tage	930	616
181 – 360 Tage	294	784
> 360 Tage	235	60
<b>Überfällige Forderungen mit Wertberichtigung</b>	<b>1.459</b>	<b>1.460</b>

Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden sich im Konzernanhang.

#### Liquiditätsrisiken

Die globale Finanzmarktkrise kann unsere Fremdfinanzierungsmöglichkeiten einschränken. Im Fall einer deutlichen Verfehlung unserer Planung für 2009 kann nicht ausgeschlossen werden, dass geltende Covenants aus den bestehenden Schuldscheindarlehen nicht eingehalten werden können. Insgesamt wurde im Jahr 2007 ein Schuldscheindarlehen von 9,0 Mio. € begeben.

Derzeit stellen zwei Banken im Rahmen eines Bankenkonsortiums eine Kreditlinie von 6,0 Mio. €, die zunächst bis zum 31. März 2009 befristet ist. Teile dieser Kreditlinie nutzen wir derzeit, um Anzahlungsbürgschaften im operativen Geschäft zu stellen. Sollte es nicht gelingen, die Kreditlinie über den 31. März 2009 hinaus zu verlängern, müssten wir zukünftig bei Kunden, die auf solchen Bürgschaften bestehen, auf Anzahlungen verzichten. Dies wiederum würde die vollständige Vorfinanzierung von Kundenaufträgen bedingen sowie die Wahrscheinlichkeit für Stornierungen von Aufträgen erhöhen.

Das Risiko, beim Wegfallen der Kreditlinie tatsächlich auf Kundenanzahlungen verzichten zu müssen, schätzen wir derzeit allerdings als relativ gering ein. Bereits seit mehreren Jahren besteht ein banken-unabhängiger Avalrahmen in Höhe von 4,5 Mio. € bei einer Versicherungsgesellschaft, der ebenfalls für Anzahlungsbürgschaften genutzt wird.

Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cashflows auch aus der Optimierung des Working Capital, den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Weitere Einzelheiten zur Liquiditätssituation der Gesellschaft finden sich unter Textziffer (25) des Konzernanhangs.

**Marktpreisrisiken**

Marktpreisschwankungen können für das Unternehmen signifikante Cashflow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. Änderungen der Fremdwährungskurse und der Zinssätze beeinflussen sowohl das weltweite operative Geschäft als auch die Investitions- und Finanzierungsalternativen.

SÜSS MicroTec ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufgrund der internationalen Ausrichtung Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. Vor allem der Wechselkurs des US-Dollar hat wesentlichen Einfluss auf die Ertragslage des Konzerns und der AG. Daher soll die anteilige Wertschöpfung in den Vereinigten Staaten kontinuierlich erhöht werden, um eine den Umsatzanteilen adäquate Wertschöpfung in diesem Währungsraum zu erzeugen. Die Währungssicherung erfolgt auf Basis bestehender Fremdwährungsaufträge. Für Aufträge, die binnen 3 bzw. 6 Monaten abgearbeitet werden, beträgt die Sicherungsquote rund 65 % bzw. 45 %. Darüber hinaus wird ein Sockelbetrag auf eine Laufzeit von 12 Monaten gesichert. Als Sicherungsinstrumente werden Devisentermingeschäfte genutzt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Textziffer (31).

Die Fremdwährungssensitivität wird durch die Aggregation der Fremdwährungspositionen des operativen Geschäfts und des Konzern-Treasury ermittelt. Dabei werden die Fremdwährungsrisiken durch Simulation einer 10%igen Abwertung aller Fremdwährungen gegenüber dem Euro berechnet. Diese simulierte Abwertung hätte zum Bilanzstichtag zu einer Reduzierung der Euro-Gegenwerte in Höhe von 690 T€ (Vorjahr: 11 T€) und einer entsprechenden Verminderung des Jahresergebnisses geführt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammensetzung des Fremdwährungsexposures und die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag:

in T€	2008		Summe
	USD	JPY	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.620	139	2.759
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.859	2.611	7.470
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-301	-721	-1.022
Kundenanzahlungen	-1.625	0	-1.625
<b>Netto-Exposure</b>	<b>5.553</b>	<b>2.029</b>	<b>7.582</b>
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10 %iger Aufwertung des Euro	-505	-185	-690

	2007		Summe
	USD	JPY	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	388	167	555
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.864	277	2.141
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.431	-62	-1.493
Kundenanzahlungen	-1.082	0	-1.082
<b>Netto-Exposure</b>	<b>-261</b>	<b>382</b>	<b>121</b>
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10 %iger Aufwertung des Euro	24	-35	-11

Das Zinsänderungsrisiko des Unternehmens ist begrenzt, da auf die im Vorjahr platzierten variablen Teile des Schuldscheinanlehens laufzeitkongruente Zinsswaps gelegt wurden. Ursprünglich variable Konditionen wurden dadurch in fixe Konditionen eingetauscht.

Alle weiteren wesentlichen Finanzschulden von SÜSS MicroTec basieren auf Darlehensverträgen mit festen Zinssätzen und unterliegen keinem Zinsänderungsrisiko.

#### Gesamtrisiko

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2008 keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet.

#### Risikomanagement-System

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen (KonTraG) ist das Risikomanagement-System seit langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

#### Organisation und Dokumentation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Das eingerichtete Risikomanagement-System wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

### Risikoidentifikation

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen.

Auf Basis dieser Workshops werden vierteljährlich Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

### Risikobewertung

Die Bewertung von Risiken erfolgt durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, die entsprechende Gegenmaßnahmen berücksichtigt und, wie auch die Ermittlung der maximalen Schadenshöhe, auf den Kenntnissen und Erfahrungen der Risikobeauftragten beruht und somit stets dem aktuellsten Stand entspricht. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden 12 bzw. 24 Monate.

Risiken werden für das Unternehmen als „wesentlich“ eingestuft, wenn sie entweder als Einzelrisiko oder aber kumulativ eine maximale Schadenshöhe von 1 Mio. € erreichen oder übertreffen.

### Risikohandhabung

Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen bzw. die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

## PROGNOSEBERICHT

Nach einem umsatzseitig rückläufigen Geschäftsjahr 2007 konnte sich die SÜSS MicroTec-Gruppe in 2008 entgegen dem allgemein schwachen Branchenumfeld leicht positiv entwickeln und verzeichnete ein Umsatzplus von 2,5 %. Die durch den Zusammenbruch des Subprime-Hypothekenmarkts im Jahr 2007 ausgelöste Finanzmarktkrise wirkte sich in der zweiten Jahreshälfte 2008 auch auf die Realwirtschaft insbesondere in den USA, Europa und anderen Industrienationen aus. In dem mit der Unterhaltungselektronik assoziierten Sektor der Chipindustrie zeigten sich die Auswirkungen des konjunkturellen

Abschwung bereits ab Jahresmitte 2008 deutlich anhand von Produktionsunterauslastungen und einer zunehmenden Investitionszurückhaltung. SÜSS MicroTec geht vor diesem Hintergrund ebenso wie führende Branchenvertreter für das Jahr 2009 von deutlich rückläufigen Umsätzen aus. Positive Impulse könnten von den bereits beschlossenen wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen ausgehen, die das Vertrauen der Finanzmärkte untereinander sowie das Vertrauen der Verbraucher in die Wirtschaft stärken sollen.

In diesem Prognosebericht gehen wir kurz erläuternd auf die exogenen und endogenen Faktoren ein, die wir ebenso wie führende Branchenbeobachter als maßgeblich für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens ansehen.

### Halbleiterindustrie

Vor dem Hintergrund der weltweiten Wirtschaftskrise verzeichnete die Halbleiterindustrie im Jahr 2008, erstmalig nach dem Krisenjahr 2001, einen Umsatzrückgang von 2,8 % auf 248,6 Mrd. US-Dollar (SIA, Februar 2009). Für 2009 gehen die beiden Marktforschungsinstitute Gartner und IDC (International Data Corporation) von einem weiteren weltweiten Absatzrückgang gegenüber dem Vorjahr von 24,1 % bzw. 22,0 % aus. Gartner hält im schlimmsten Fall sogar einen Rückgang des weltweiten Halbleiterabsatzes von 33 % für möglich. Hintergrund für die negative Erwartungshaltung sind deutlich reduzierte Auslieferungszahlen in den Hauptabsatzgebieten für Halbleiter sowie der rapide Preisverfall insbesondere bei den Speicherchips (DRAMs). Die Chance auf eine Branchenerholung sehen beide Marktforschungsinstitute für das Jahr 2010, für das Gartner ein positives Wachstum von 7,5 % voraussagt (Stand Februar 2009).

### Halbleiter-Equipment-Industrie

Die negative Grundstimmung sowie bestehende Überkapazitäten seitens der Chiphersteller und Auftragsfertiger (Foundries) werden sich laut führender Marktforschungsinstitute weiterhin deutlich auf die Equipment-Hersteller auswirken. Laut VLSI Research Inc. verzeichnete die Halbleiter-Equipment-Industrie in 2008 bereits einen Rückgang von 25,3 %. Für 2009 reichen die Prognosen der Marktforscher von -34 % (Gartner, Februar 2009) bis -49 % (VLSI, Januar 2009). Bei der Bewertung der Zahlen ist jedoch zu berücksichtigen, dass sie Märkte reflektieren, die für große „Frontend“-orientierte Hersteller wie Applied Materials oder ASML bestimmend sind.

SÜSS MicroTec ist hingegen im klassischen „Frontend“ der Chiphersteller kaum aktiv und ist als innovativer, spezialisierter Equipment-Hersteller hauptsächlich in den Teilmärkten MEMS, Advanced Packaging, Verbindungshalbleiter und 3D-Integration tätig. Für diese Teilmärkte gibt es hingegen nur wenige Prognosen.



## Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten

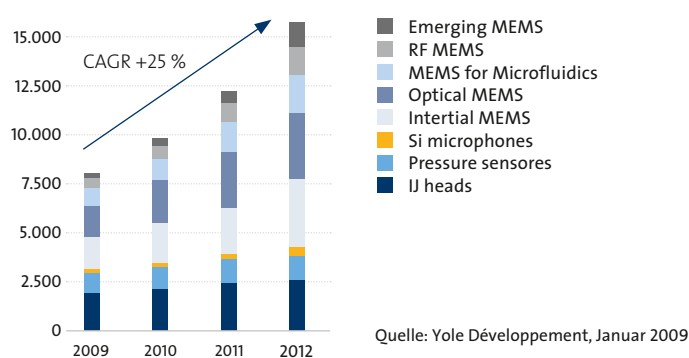
### Markt für Mikrosystemtechnik (MEMS)

Yole Développement, eines der führenden Forschungsinstitute für den MEMS-Markt, prognostiziert eine durchschnittliche Wachstumsrate von 25 % pro Jahr mit einem erwarteten Umsatz im Bereich Mikrosystemtechnik von 15,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2012 (Stand Januar 2009). Rund 40 % der Umsätze der SÜSS MicroTec-Gruppe entfallen auf den vergleichsweise kleinen, aber stetig und ohne die typischen Zyklen der Halbleiterindustrie wachsenden MEMS-Markt. Starke Treiber dieses Markts waren bislang die Automobilbranche, wo Sicherheitslösungen wie ABS (Antiblockiersystem) und ESP (Electronic Stability Program) mittlerweile zur Standardausrüstung des Produktportfolios zählen. Aber auch die Märkte für Tintenstrahldruckerköpfe und Projektionssysteme zählen zu den stetig wachsenden Anwendungsfeldern für MEMS, wenn ihre Wachstumsraten auch bedingt durch den hohen Sättigungsgrad sowie den Preisdruck limitiert sind.

Die stärksten Wachstumsraten werden aus heutiger Sicht die Märkte für Silizium-Mikrophone, Radio Frequency-MEMS, Beschleunigungsmesser sowie neuartige MEMS-Lösungen (wie Mikrobrennstoffzellen) verzeichnen. Der Bereich Consumer Products wird dabei in den nächsten Jahren im Vergleich zu den MEMS-Märkten in der Automobilbranche, der Industrie sowie der Medizintechnik überdurchschnittlich stark wachsen. Vor allem die Nachfrage der Konsumenten in der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik nach multiplen, integrierten Funktionen sollte einen starken Impuls auslösen. Auf der Angebotsseite reagieren die Hersteller auf die steigenden Anforderungen mit neuen Produkten und Applikationen. So finden Drehratensensoren und mehrachsige Beschleunigungssensoren als Instrumente in mobilen Elektronikgeräten, z. B. als Bildstabilisatoren in Handys oder in Spielekonsolen, Anwendung. Videospiel-Controller, wie sie in der Nintendo Wii oder der Sony Playstation verbaut werden, zählen über die kommenden Jahre auch laut dem Marktforschungsinstitut iSuppli zu den stärksten Wachstumstreibern.

Zu berücksichtigen ist hingegen, dass der Equipment-Markt in diesem Bereich weniger schnell wächst als der MEMS-Markt selbst, da durch die gesteigerte Produktivität der Systeme eine stets höhere Anzahl an MEMS-Bauteilen pro Maschine gefertigt werden kann.

DER MEMS-MARKT  
in Mio. USD

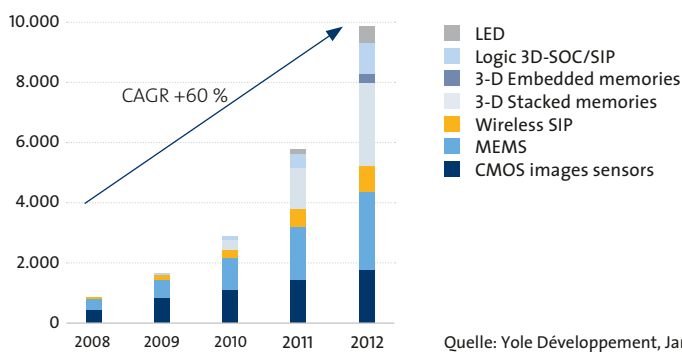


### Advanced Packaging und 3D-Integration

Für das Wafer Level Packaging (Advanced Packaging) prognostizieren die Forscher von TechSearch International Inc. (Stand September 2008) für den Zeitraum von 2008 bis 2012 einen Anstieg der Zahl der gebumpten 200mm-Wafer von 3,6 Mio. Stück auf 7,5 Mio. Stück oder eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 20 %. Bei der Interpretation der Zahlen kann jedoch nicht von einer proportionalen Erhöhung des Equipments ausgegangen werden. Für das Marktforschungsinstitut Yole Développement wird das Wachstum im Advanced Packaging in den kommenden Jahren vor allem aus dem Bereich 3D-Integration kommen. Dieser noch junge Sub-Markt des Advanced Packaging wird laut Yole Développement bis zum Jahr 2012 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 82 % aufweisen (Stand Januar 2009). Wesentliche Wachstumstreiber sind dabei vor allem CMOS-Bildsensoren sowie MEMS und wireless SIP (System-in-a-Package).

#### DER MARKT FÜR 3D-INTEGRATION

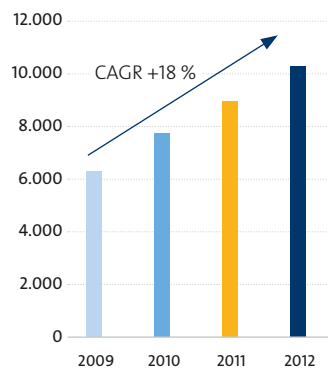
in Mio. Stk.



### Verbindungshalbleiter (LED)

Der Markt für Verbindungshalbleiter ist stark diversifiziert und daher schwer global einzuschätzen. SÜSS MicroTec konzentriert sich in diesem Markt hingegen auf das Wachstumssegment LEDs (Leuchtdioden), was sich als Wachstumstreiber gut abgrenzen lässt. LEDs sind im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen platzsparend, haben eine bis zu 50-mal so lange Lebensdauer und ermöglichen einen niedrigeren Energieverbrauch. Waren die hocheffizienten Leuchtdioden in den vergangenen Jahren noch 3- bis 4-mal so teuer wie herkömmliche Leuchtmittel, so ermöglicht modernes Equipment eine Effizienzsteigerung und damit eine zunehmend preiswertere Herstellung der Halbleiter. Wachstumsfördernd wird sich zudem die Verabschiedung der EU-Verordnung vom 8. Dezember 2008 auf den Markt für LEDs auswirken. Laut der Verordnung müssen Hersteller beginnend mit dem Jahr 2009 schrittweise herkömmliche Glühbirnen und Halogenlampen vom Markt nehmen. Yole Développement prognostiziert für den weltweiten LED-Markt daher eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 18 % mit einem Marktvolumen von 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012.

DER LED-MARKT  
in Mio. USD



Quelle: Yole Développement, LED Market Forecast, Januar 2009

### Endogene Indikatoren

Neben dem Zustand der Märkte ist für unseren Erfolg auch das Innovationspotenzial unseres Produktangebotes entscheidend. Wir wissen aus Erfahrung, dass vorübergehende Schwächen bei den Chipherstellern zumindest teilweise durch Bestellungen von Forschungskunden ausgeglichen werden können. Genau für diesen Markt haben wir im Geschäftsjahr 2008 sowohl im Bereich Lithografie als auch im Bereich Test Systeme neue Systeme in das Produktportfolio aufgenommen.

Außerdem gehen wir davon aus, dass unsere Neuentwicklungen für die 3D-Integration, die Wafer Level Redistribution, das Nanoimprinting und andere Anwendungen schon in 2009 das Interesse von Chipherstellern finden werden, die diese neuen Prozesse nach und nach in ihre Herstellung integrieren werden. Darüber hinaus planen wir für 2009 den Ausbau unserer weltweiten Kundenserviceleistungen, die auf Grundlage der bereits weltweit hohen installierten Basis wesentlich zur Grundauslastung beitragen werden.

## GESAMTAUSSAGE ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DES KONZERNS

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung unserer Zielmärkte und der damit verbundenen schwierigen Einschätzbarkeit des Investitionsverhaltens unserer Kunden ist es aktuell nur sehr schwer möglich, konkrete Prognosen für die Geschäftsjahre 2009 und 2010 abzugeben. Vor dem Hintergrund der weltweiten Wirtschaftskrise erwarten wir jedoch für 2009 einen deutlichen Umsatzrückgang im Vergleich zum Geschäftsjahr 2008.

Die aktuellen Prognosen der führenden Marktforschungsinstitute wie Gartner und VLSI Research Inc. prognostizieren für 2009 einen Marktrückgang im Bereich der Halbleiter-Equipment-Industrie zwischen 34 und 49 %.

Auch wenn sich diese Prognosen vorwiegend auf Märkte beziehen, die für große „Frontend“-orientierte Hersteller bestimmend sind und somit für die SÜSS MicroTec-Gruppe nur eine bedingte Aussagekraft haben, hat das Unternehmen bereits im zweiten Halbjahr 2008 begonnen, sich mit umfangreichen Maßnahmen zur Restrukturierung und Kostensenkung frühzeitig auf das deutlich schwierigere wirtschaftliche Umfeld einzustellen. So konnte die Gewinnschwelle bereits zum Ende des Geschäftsjahres 2008 auf ein Umsatzniveau von unter 120 Mio. € gesenkt werden. Durch weitere Maßnahmen zur Kostensenkung, dem Abbau von Urlaub und vorhandenen Überstunden auf den Langzeitkonten, aber auch dem gezielten Einsatz von Kurzarbeit stehen weitere Instrumente zur Verfügung, flexibel auf eine Verschärfung der weltweiten Wirtschaftskrise zu reagieren.

Insgesamt erwarten wir, dass das operative Geschäft ausreichend freien Cashflow generieren wird, so dass kein zusätzlicher Liquiditätsbedarf für die organische Weiterentwicklung des Basisgeschäfts auftreten sollte.

## VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Dieser Geschäftsbericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf zukünftige Entwicklungen des SÜSS MicroTec-Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 10. März 2009

Der Vorstand



Frank Averdung  
Vorstandsvorsitzender



Michael Knopp  
Vorstand



Christian Schubert  
Vorstand

# KONZERNABSCHLUSS

## 82 Konzernabschluss nach IFRS

- 82 Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
- 84 Konzernbilanz
- 86 Konzern-Kapitalflussrechnung
- 88 Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
- 90 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2008
- 92 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2007
- 94 Segmentberichterstattung

## 96 Konzernanhang

- 110 Erläuterungen zur IFRS-Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
- 117 Erläuterungen zu den Aktiva
- 121 Erläuterungen zu den Passiva
- 134 Sonstige Angaben

# KONZERNABSCHLUSS

## KONZERN-GEWINN- UND -VERLUSTRECHNUNG (IFRS)

		01.01.2008 – 31.12.2008	
in T€	Anhang Nr.	Fortgeführte Aktivitäten	Nicht fortgeführte Aktivitäten
Umsatzerlöse	(3)	146.541	2.771
Umsatzkosten	(4)	-100.048	-2.618
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>		<b>46.493</b>	<b>153</b>
Vertriebskosten		-26.761	-13
Forschungs- und Entwicklungskosten		-7.299	0
Verwaltungskosten		-19.417	-124
Wertminderungen des Geschäfts- oder Firmenwerts		-4.426	0
Sonstige betriebliche Erträge	(5)	5.608	19
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	-5.256	0
<b>Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT):</b>			
EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization)		7.303	35
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Finanzanlagen	(10)	-18.361	0
<b>Operatives Ergebnis (EBIT)</b>		<b>-11.058</b>	<b>35</b>
Finanzergebnis	(7)	-824	0
<b>Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-11.882</b>	<b>35</b>
Ertragsteuern	(8)	-2.054	0
<b>Gewinn/Verlust</b>		<b>-13.936</b>	<b>35</b>
Davon Minderheitsanteile		-30	0
Davon Süss MicroTec-Aktionäre		-13.906	35
<b>Ergebnis je Aktie</b>			
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in €	(9)	-0,82	0,00
Verwässertes Ergebnis je Aktie in €	(9)	-0,82	0,00

01.01.2007 – 31.12.2007

Konzern	Fortgeführte Aktivitäten	Nicht fortgeführte Aktivitäten	Konzern
149.312	139.155	6.399	145.554
-102.666	-80.878	-3.786	-84.664
<b>46.646</b>	<b>58.277</b>	<b>2.613</b>	<b>60.890</b>
-26.774	-24.989	-1.155	-26.144
-7.299	-6.970	-155	-7.125
-19.541	-20.258	-389	-20.647
-4.426	0	0	0
5.627	4.382	0	4.382
-5.256	-5.381	-12	-5.393
7.338	9.719	907	10.626
-18.361	-4.658	-5	-4.663
<b>-11.023</b>	<b>5.061</b>	<b>902</b>	<b>5.963</b>
-824	-205	-89	-294
<b>-11.847</b>	<b>4.856</b>	<b>813</b>	<b>5.669</b>
-2.054	-1.150	0	-1.150
<b>-13.901</b>	<b>3.706</b>	<b>813</b>	<b>4.519</b>
-30	114	0	114
-13.871	3.592	813	4.405
-0,82	0,21	0,05	0,26
-0,82	0,20	0,05	0,25

## KONZERNBILANZ (IFRS)

AKTIVA in T€	Anhang Nr.	31.12.2008	31.12.2007
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		<b>48.600</b>	<b>58.130</b>
Immaterielle Vermögenswerte	(11)	15.113	19.483
Geschäfts- oder Firmenwert	(12)	17.767	21.961
Sachanlagen	(13)	5.421	5.049
Sonstige Finanzanlagen	(14)	5	5
Steuererstattungsansprüche	(20)	573	619
Sonstige Vermögenswerte	(15)	664	519
Latente Steueransprüche	(8)	9.057	10.494
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		<b>104.960</b>	<b>105.000</b>
Vorräte	(16)	54.596	53.750
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(17)	23.142	25.582
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(18)	848	3.023
Wertpapiere	(19)	3.759	2
Steuererstattungsansprüche	(20)	298	847
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		20.603	20.092
Sonstige Vermögenswerte	(21)	1.714	1.704
<b>Bilanzsumme</b>		<b>153.560</b>	<b>163.130</b>



PASSIVA in T€	Anhang Nr.	31.12.2008	31.12.2007
<b>Eigenkapital</b>		<b>90.617</b>	<b>102.568</b>
Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG		90.370	102.291
Gezeichnetes Kapital	(22)	17.019	17.019
Rücklagen	(22)	74.142	87.383
Kumuliertes übriges Eigenkapital	(22)	-791	-2.111
Minderheitsanteile		247	277
<b>Langfristige Schulden</b>		<b>18.554</b>	<b>19.309</b>
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(23)	3.026	2.738
Rückstellungen	(24)	902	737
Finanzschulden	(25)	9.199	9.255
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(26)	0	51
Latente Steuerschulden	(8)	5.427	6.528
<b>Kurzfristige Schulden</b>		<b>44.389</b>	<b>41.253</b>
Rückstellungen	(27)	3.161	2.922
Steuerschulden	(30)	801	2.213
Finanzschulden	(25)	5.758	3.184
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(28)	5.365	4.089
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.116	8.828
Sonstige Verbindlichkeiten	(29)	24.188	20.017
<b>Bilanzsumme</b>		<b>153.560</b>	<b>163.130</b>

## KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG (IFRS)

in T€	01.01.2008 – 31.12.2008	01.01.2007 – 31.12.2007
Gewinn/Verlust (nach Steuern)	-13.901	4.519
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	12.305	3.129
Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert	4.426	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.630	1.534
Ergebnis aus dem Abgang von Vermögenswerten und Schulden eines aufgegebenen Geschäftsbereichs	0	98
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	98	333
Veränderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermögen	287	1.540
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	563	-579
Zahlungsunwirksamer Personalaufwand aus Aktienoptionsplänen	630	619
Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-135	-773
Zahlungsunwirksame Aufzinsung der Wandel- und Optionsanleihe	18	20
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	-1.628	2.090
Veränderung des Vorratsvermögens	291	-4.453
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.227	-2.988
Veränderung der übrigen Vermögenswerte	709	-718
Veränderung der Pensionsrückstellungen	288	182
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.880	2.818
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	4.119	-5.429
Veränderung der latenten Steuern	336	-472
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>9.383</b>	<b>1.470</b>
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>10.143</b>	<b>3.329</b>

in T€	01.01.2008 – 31.12.2008	01.01.2007 – 31.12.2007
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-1.801	-2.514
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-7.582	-8.605
Erwerb von kurzfristigen zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren	-3.757	0
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	12	6
Einzahlung aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen	1.906	1.956
<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit – fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>-11.222</b>	<b>-9.157</b>
<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>-13.128</b>	<b>-11.103</b>
Aufnahme von Bankdarlehen	0	8.910
Tilgung von Bankdarlehen	-680	-1.503
Tilgung der Optionsanleihe	-373	0
Veränderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	2.573	591
Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten	-117	-191
Einzahlungen aus der Ausübung von Bezugsrechten	0	32
<b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit – fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>1.403</b>	<b>7.839</b>
<b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>1.403</b>	<b>7.951</b>
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	947	-519
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>511</b>	<b>-367</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresanfang</b>	<b>20.092</b>	<b>20.459</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode</b>	<b>20.603</b>	<b>20.092</b>
Der Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit enthält:		
Zinszahlungen während der Periode	838	331
Zinseinnahmen während der Periode	639	522
Steuerzahlungen während der Periode	2.965	1.138
Steuererstattungen während der Periode	470	342

## KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (IFRS)

in T€	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklage
<b>Stand 01.01.2007</b>	<b>17.007</b>	<b>91.573</b>	<b>433</b>
Ausgabe von Stückaktien: Ausübung von Aktienoptionen	12	20	
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		619	
Jahresergebnis			
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren nach Steuereffekt			
Fremdwährungsanpassung			
<b>Stand 31.12.2007</b>	<b>17.019</b>	<b>92.212</b>	<b>433</b>
<b>Stand 01.01.2008</b>	<b>17.019</b>	<b>92.212</b>	<b>433</b>
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		630	
Jahresergebnis			
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren nach Steuereffekt			
Fremdwährungsanpassung			
<b>Stand 31.12.2008</b>	<b>17.019</b>	<b>92.842</b>	<b>433</b>

	Bilanzgewinn/ -verlust	Kumuliertes übriges Eigenkapital	Eigenkapital der Aktionäre der Süss MicroTec AG	Minderheitsanteile	Eigenkapital
	-9.667	-354	98.992	163	99.155
			32		32
			619		619
	4.405	63	4.405	114	4.519
		-1.820	63		63
	-5.262	-2.111	-1.820		-1.820
			102.291	277	102.568
	-5.262	-2.111	102.291	277	102.568
			630		630
	-13.871		-13.871	-30	-13.901
		-38	-38		-38
		1.358	1.358		1.358
	-19.133	-791	90.370	247	90.617

## ENTWICKLUNG DES KONZERN-ANLAGEVERMÖGENS

### Anlagenpiegel 2008

in T€	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					31.12.08
	01.01.08	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	
<b>I. Immaterielle Vermögenswerte</b>						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.979	169	2.823	0	1	20.970
2. Entwicklungskosten	25.800	526	4.759	0	126	30.959
3. Aktivierte Leasinggegenstände Software	146	45	0	0	0	191
	<b>43.925</b>	<b>740</b>	<b>7.582</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>52.120</b>
<b>II. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>36.372</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.604</b>
<b>III. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	3.581	256	122	0	56	3.903
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.622	546	345	-203	142	10.168
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.919	332	1.061	203	361	12.154
4. Fahrzeuge	508	7	5	0	4	516
5. Anlagen im Bau	24	-13	139	0	12	138
6. Aktivierte Leasinggegenstände						
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	324	22	90	0	0	436
Technische Anlagen und Maschinen	794	114	39	0	132	815
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	754	7	0	0	0	761
	<b>26.526</b>	<b>1.271</b>	<b>1.801</b>	<b>0</b>	<b>707</b>	<b>28.891</b>
<b>IV. Finanzanlagen</b>						
1. At-equity bewertete Beteiligungen	2.095	0	0	0	0	2.095
2. Sonstige Finanzanlagen	173	0	0	0	0	173
	<b>2.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.268</b>

Kumulierte Abschreibungen						Restbuchwerte		
01.01.08	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	31.12.08	31.12.07	31.12.08	
14.687	136	1.380	0	1	16.202	3.292	4.768	
9.609	206	10.925	0	126	20.614	16.191	10.345	
146	45	0	0	0	191	0	0	
<b>24.442</b>	<b>387</b>	<b>12.305</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>37.007</b>	<b>19.483</b>	<b>15.113</b>	
14.411	0	4.426	0	0	18.837	21.961	17.767	
2.895	185	174	0	56	3.198	686	705	
8.118	410	422	-163	142	8.645	1.504	1.523	
8.668	253	819	163	263	9.640	2.251	2.514	
405	6	29	0	4	436	103	80	
0	0	0	0	0	0	24	138	
154	14	103	0	0	271	170	165	
505	85	78	0	132	536	289	279	
732	7	5	0	0	744	22	17	
<b>21.477</b>	<b>960</b>	<b>1.630</b>	<b>0</b>	<b>597</b>	<b>23.470</b>	<b>5.049</b>	<b>5.421</b>	
2.095	0	0	0	0	2.095	0	0	
168	0	0	0	0	168	5	5	
<b>2.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.263</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

## ENTWICKLUNG DES KONZERN-ANLAGEVERMÖGENS

### Anlagenpiegel 2007

in T€	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					31.12.07
	01.01.07	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	
<b>I. Immaterielle Vermögenswerte</b>						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.629	-291	1.755	0	114	17.979
2. Entwicklungskosten	19.647	-697	6.850	0	0	25.800
3. Aktivierte Leasinggegenstände Software	154	-8	0	0	0	146
	<b>36.430</b>	<b>-996</b>	<b>8.605</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>43.925</b>
<b>II. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>37.137</b>	<b>-765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.372</b>
<b>III. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	6.051	-208	139	259	2.660	3.581
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.397	-894	736	-23	594	9.622
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.577	-229	1.356	23	808	10.919
4. Fahrzeuge	482	-4	73	0	43	508
5. Anlagen im Bau	159	-8	132	-259	0	24
6. Aktivierte Leasinggegenstände						
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	280	-34	78	0	0	324
Technische Anlagen und Maschinen	1.320	-32	0	0	494	794
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.144	-11	0	0	379	754
	<b>30.410</b>	<b>-1.420</b>	<b>2.514</b>	<b>0</b>	<b>4.978</b>	<b>26.526</b>
<b>IV. Finanzanlagen</b>						
1. At-equity bewertete Beteiligungen	2.095	0	0	0	0	2.095
2. Sonstige Finanzanlagen	173	0	0	0	0	173
	<b>2.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.268</b>



Kumulierte Abschreibungen					Restbuchwerte		
01.01.07	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	31.12.07	31.12.06	31.12.07
13.796	-240	1.239	0	108	14.687	2.833	3.292
7.968	-247	1.888	0	0	9.609	11.679	16.191
152	-8	2	0	0	146	2	0
<b>21.916</b>	<b>-495</b>	<b>3.129</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>24.442</b>	<b>14.514</b>	<b>19.483</b>
<b>14.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.411</b>	<b>22.726</b>	<b>21.961</b>
5.005	-170	248	0	2.188	2.895	1.046	686
9.140	-793	245	0	474	8.118	1.257	1.504
8.782	-195	826	0	745	8.668	1.795	2.251
420	-5	29	0	39	405	62	103
0	0	0	0	0	0	159	24
70	-13	97	0	0	154	210	170
928	-22	84	0	485	505	392	289
1.117	-11	5	0	379	732	27	22
<b>25.462</b>	<b>-1.209</b>	<b>1.534</b>	<b>0</b>	<b>4.310</b>	<b>21.477</b>	<b>4.948</b>	<b>5.049</b>
2.095	0	0	0	0	2.095	0	0
168	0	0	0	0	168	5	5
<b>2.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.263</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

## SEGMENTBERICHTERSTATTUNG (IFRS)

### Segmentinformationen nach Geschäftsfeldern

in T€	Lithografie		Substrat Bonder		Test Systeme	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007
Außenumsatz	98.843	83.836	16.145	16.313	25.046	27.810
Innenumsatz	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamter Umsatz</b>	<b>98.843</b>	<b>83.836</b>	<b>16.145</b>	<b>16.313</b>	<b>25.046</b>	<b>27.810</b>
Segmentergebnis	18.607	13.639	-6.845	-1.484	-2.357	517
Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen (-) / Erträge	-2.443	-1.148	-2.186	-383	-620	-216
Segmentvermögen	64.080	62.647	25.612	24.044	15.986	18.535
– davon Geschäfts- oder Firmenwert	13.599	13.599	0	0	4.168	4.060
Nicht zugeordnetes Konzernvermögen						
<b>Konzernaktiva</b>						
Segmentsschulden	-21.384	-18.908	-5.805	-5.917	-4.121	-4.237
Nicht zugeordnete Konzernschulden						
<b>Konzernschulden</b>						
Abschreibungen	2.195	2.721	1.914	1.173	453	324
– davon planmäßig	2.195	2.721	1.251	1.173	352	324
– davon außerplanmäßig	0	0	663	0	101	0
Investitionen	2.496	2.192	2.736	4.425	378	740
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	356	358	116	111	154	159

### Segmentinformationen nach Regionen

in T€	Umsatzerlöse		Investitionen		Vermögen	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007
Europa	50.225	48.173	6.352	5.498	74.235	79.779
Nordamerika	39.301	41.154	2.883	4.893	36.429	39.499
Japan	15.396	17.867	99	209	5.926	6.254
Sonstiges Asien	44.382	38.329	49	277	924	734
Rest	8	31	0	242	0	2.411
Konsolidierungseffekte	0	0	0	0	-1.466	-2.852
<b>Gesamt</b>	<b>149.312</b>	<b>145.554</b>	<b>9.383</b>	<b>11.119</b>	<b>116.048</b>	<b>125.825</b>

Sonstige		Fortgeführte Aktivitäten		Nicht fortgeführte Aktivitäten (Device Bonder)		Konsolidierungseffekte		Summe	
2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
6.507	11.196	146.541	139.155	2.771	6.399	-	-	149.312	145.554
6.598	6.072	6.598	6.072	0	0	-6.598	-6.072	0	0
<b>13.105</b>	<b>17.268</b>	<b>153.139</b>	<b>145.227</b>	<b>2.771</b>	<b>6.399</b>	<b>-6.598</b>	<b>-6.072</b>	<b>149.312</b>	<b>145.554</b>
-20.463	-7.611	-11.058	5.061	35	902	-	-	-11.023	5.963
-13.025	-2.212	-18.274	-3.959	-160	233	-	-	-18.434	-3.726
10.325	20.365	116.003	125.591	45	234	-	-	116.048	125.825
0	4.302	17.767	21.961	0	0	-	-	17.767	21.961
								37.512	37.305
								<b>153.560</b>	<b>163.130</b>
-3.625	-4.360	-34.935	-33.422	-354	-1.399	-	-	-35.289	-34.821
								-27.654	-25.741
								<b>-62.943</b>	<b>-60.562</b>
13.799	440	18.361	4.658	0	5	-	-	18.361	4.663
1.353	440	5.151	4.658	0	5	-	-	5.151	4.663
12.446	0	13.210	0	0	0	-	-	13.210	0
3.773	3.753	9.383	11.110	0	9	-	-	9.383	11.119
73	79	699	707	0	28	-	-	699	735

# ANHANG

## zum IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2008

### (1) Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die SÜSS MicroTEC AG (das „Unternehmen“ oder die „Gesellschaft“) mit Sitz in D-85748 Garching, Schleißheimer Str. 90, und ihre Tochtergesellschaften bilden ein international tätiges Unternehmen, das Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching, Sacka und Vaihingen in Deutschland sowie Waterbury und Palo Alto in den USA und Neuchâtel in der Schweiz. Vertrieben werden die Produkte sowohl über die Produktionsstandorte selbst als auch zusätzlich über selbstständige Vertriebsgesellschaften in Frankreich, Großbritannien, Japan, Thailand, Singapur, Taiwan, China und Korea. In den Ländern, in denen der Konzern nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb über Handelsvertretungen abgewickelt.

### (2) Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze

#### a) Grundlage der Darstellung

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den vom International Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten und veröffentlichten International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den zugehörigen Interpretationen aufgestellt, wie sie in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden sind. Die Anforderungen der IFRS wurden vollständig erfüllt und führen zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des SÜSS-Konzerns.

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des § 315a HGB aufstellen, da es sich bei der SÜSS MicroTEC AG um ein börsennotiertes Unternehmen handelt. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 315 HGB erstellt.

Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2008 werden beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht und veröffentlicht.

#### b) Nicht vorzeitig angewandte Standards und Interpretationen

Das IASB hat nachfolgende Standards, Interpretationen und Änderungen zu bestehenden Standards herausgegeben, deren Anwendung noch nicht verpflichtend ist und die vom SÜSS-Konzern auch nicht vorzeitig angewandt wurden:

#### IFRS 8 „Operating Segments“

Im November 2006 veröffentlichte das IASB IFRS 8 „Operating Segments“, wodurch IAS 14 „Segment reporting“ ersetzt wurde. Durch IFRS 8 wird die Segmentberichterstattung vom so genannten risk and reward approach des IAS 14 auf den management approach in Bezug auf die Segmentidentifikation umgestellt. Maßgeblich sind dabei die Informationen, die dem so genannten chief operating decision maker regelmäßig für Entscheidungszwecke zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig wird die Bewertung der Segmente vom financial accounting approach des IAS 14 auf den management approach umgestellt.

IFRS 8 ist verpflichtend auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen.

IFRS 8 wird bei der erstmaligen Anwendung durch die SÜSS MicroTec AG zu zusätzlichen Angaben in der Segmentberichterstattung führen.

#### Änderungen an IAS 23 „Borrowing Costs“

Die wesentliche Änderung, die vom IASB im März 2007 veröffentlicht wurde, betrifft die Streichung des Wahlrechts, Fremdkapitalkosten direkt als Aufwand zu erfassen, die direkt dem Erwerb, Bau oder der Herstellung eines qualifizierten Vermögenswerts zugeordnet werden können. Ein qualifizierter Vermögenswert liegt in diesem Zusammenhang vor, wenn ein beträchtlicher Zeitraum erforderlich ist, um den Vermögenswert in seinen beabsichtigten gebrauchsfähigen oder verkaufsfähigen Zustand zu versetzen. Unternehmen müssen demnach zukünftig solche Fremdkapitalkosten als Teil der Anschaffungskosten der qualifizierten Vermögenswerte aktivieren.

Der Standard ist erstmals auf Fremdkapitalkosten für qualifizierte Vermögenswerte anzuwenden, deren Anfangszeitpunkt für die Aktivierung am oder nach dem 1. Januar 2009 liegt.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

#### IFRIC 13 „Customer Loyalty Programmes“

Das International Financial Reporting Committee (IFRIC) hat am 28. Juni 2007 die Interpretation IFRIC 13 „Customer Loyalty Programmes“ veröffentlicht. Die Interpretation befasst sich mit der Bilanzierung und Bewertung von Kundenbindungsprogrammen. Bei diesen Kundenbindungsprogrammen erwirbt der Kunde in der Regel Punkte (Prämien), die es ihm erlauben, Güter oder Dienstleistungen kostenlos oder verbilligt vom Verkäufer oder einem Dritten zu beziehen. Offen war in diesem Zusammenhang dabei bislang die Frage, ob die Prämien eine Schuld im Zusammenhang mit einem erfolgten Verkaufsgeschäft darstellen oder ein Entgelt im Sinne einer Vorauszahlung für ein künftiges Verkaufsgeschäft sind. Gemäß der nun vorliegenden Interpretation sind die Erlöse aus dem Verkauf in zwei Komponenten aufzuteilen. Ein Teil entfällt auf das aktuelle Geschäft, durch das die Prämien entstanden sind. Der andere Teil entfällt auf das zukünftige Geschäft, das aus den einzulösenden Prämien resultiert. Der Teil der Erlöse, der der bereits erbrachten Lieferung bzw. Leistung zuzuordnen ist, ist erfolgswirksam zu erfassen. Der Teil der Erlöse, der der Prämie zuzuordnen ist, ist solange als Schuld im Sinne einer Vorauszahlung zu bilanzieren, bis die Prämie vom Kunden eingelöst wird und die Verpflichtung aus der Prämie erfüllt ist.

Die Interpretation ist spätestens mit Beginn des ersten Geschäftsjahres anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2008 beginnt.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung im Geschäftsjahr 2009 keine wesentlichen Auswirkungen.

#### IFRIC 14 „The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction“

Das International Financial Reporting Committee (IFRIC) hat am 5. Juli 2007 die Interpretation IFRIC 14 „The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction“ veröffentlicht. Die Interpretation gibt Hinweise, wie die Begrenzung nach IAS 19 „Employee Benefits“ für einen Überschuss festzulegen ist, der als Vermögenswert (defined benefit asset) angesetzt werden kann. Zudem wird erklärt, welche Auswirkungen sich auf die Bewertung von Vermögenswerten und Rückstellungen aus leistungsorientierten Plänen aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung zu einer Mindestbeitragszahlung, beispielsweise durch Gesetz oder durch die Regelungen des Plans, ergeben. Dadurch wird sichergestellt, dass Unternehmen einen Planvermögensüberschuss als Vermögenswert konsistent bilanzieren.

Die Interpretation ist spätestens mit Beginn des ersten Geschäftsjahres anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2008 beginnt.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung im Geschäftsjahr 2009 keine wesentlichen Auswirkungen.

#### IAS 1 „Darstellung des Jahresabschlusses“

Im September 2007 hat das International Accounting Standards Board (IASB) IAS 1 „Darstellung des Jahresabschlusses“ veröffentlicht. IAS 1 ersetzt IAS 1 „Darstellung des Jahresabschlusses“ (überarbeitet in 2003), in der Fassung von 2005. Die Überarbeitung zielt darauf ab, die Möglichkeit der Analyse sowie der Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen für deren Nutzer zu verbessern. IAS 1 regelt die Grundlagen für die Darstellung und Struktur des Abschlusses und enthält zudem Mindestanforderungen an den Inhalt eines Abschlusses.

Der neue Standard ist für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung im Geschäftsjahr 2009 keine materiellen Auswirkungen.

#### IFRS 2 „Share-based Payment“

Das IASB hat im Januar 2008 Änderungen von IFRS 2 „Share-based Payment“ veröffentlicht. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Definition von Ausübungsbedingungen (vesting conditions) und die Regelungen zur Annullierung (cancellation) eines Planes durch eine andere Partei als das Unternehmen. Durch die Änderungen wird klargestellt, dass Ausübungsbedingungen nur Leistungsbedingungen (service conditions) und Zielerreichungsbedingungen (performance conditions) sind.

Als Folge der geänderten Definitionen von Ausübungsbedingungen sind nun Nicht-Ausübungsbedingungen (non-vesting conditions) bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts des gewährten Eigenkapitalinstruments zu berücksichtigen. Besteht dabei für das Unternehmen oder die andere Vertragspartei ein Wahlrecht, ob eine Nicht-Ausübungsbedingung erfüllt wird, so ist die Nichterfüllung als Annullierung zu behandeln.

Die Änderungen sind auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen, anzuwenden.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung im Geschäftsjahr 2009 keine materiellen Auswirkungen.

#### IFRIC 16 „Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation“

Im Juli 2008 hat das IFRIC den IFRIC 16 „Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation“ veröffentlicht. Ziel der Interpretation ist eine Klarstellung zweier Sachverhalte, die sich im Rahmen der beiden Standards IAS 21 „The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates“ and IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“ im Zusammenhang mit der Bilanzierung der Absicherung von Fremdwährungsrisiken innerhalb eines Unternehmens und seiner ausländischen Geschäftsbetriebe ergeben.

IFRIC 16 stellt klar, was als Risiko bei der Absicherung einer Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb anzusehen ist und wo innerhalb der Unternehmensgruppe das Sicherungsinstrument zur Minderung dieses Risikos gehalten werden darf.

Die Interpretation ist für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Oktober 2008 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung im Geschäftsjahr 2009 keine Auswirkungen.

### c) Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Konzernabschluss erfüllt unter Beachtung der qualitativen Kriterien der Rechnungslegung sowie der anzuwendenden IFRS den Grundsatz des true and fair views sowie der fair presentation. Bei der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zugrunde gelegt:

#### Geschäfts- oder Firmenwert

Nach IFRS 3 wird der derivative Geschäfts- oder Firmenwert nicht planmäßig abgeschrieben, sondern wird einmal jährlich auf Wertminderung überprüft. Eine Überprüfung erfolgt auch, wenn Ereignisse oder Umstände (Triggering Events) eintreten, die auf eine mögliche Wertminderung hindeuten.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit des Goodwills erfolgt auf der Ebene zahlungsmittelgenerierender Einheiten (Cash Generating Units), die im SÜSS-Konzern den Segmenten entsprechen.

Eine Wertminderung wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch den erzielbaren Betrag der jeweiligen Cash Generating Unit gedeckt sind. Der erzielbare Betrag ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Verkaufskosten und Nutzungswert. Die SÜSS MicroTec AG hat im Berichtsjahr den erzielbaren Betrag eines Segments auf der Basis des Nutzungswerts errechnet. Dieser Wert beruht grundsätzlich auf Bewertungen mittels diskontierter Mittelzuflüsse.

#### Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden gemäß IAS 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass mit der Nutzung des Vermögenswerts ein zukünftiger wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist und die Kosten des Vermögenswerts zuverlässig bestimmt werden können. Sie werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und planmäßig linear über ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal 10 Jahre beträgt, abgeschrieben.

Entwicklungskosten im Rahmen der Produktentwicklung werden zu Herstellungskosten aktiviert, soweit eine eindeutige Aufwandszuordnung möglich und sowohl technische Realisierbarkeit als auch erfolgreiche Vermarktung sichergestellt sind. Die Entwicklungstätigkeit muss ferner mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Die aktivierten Entwicklungsleistungen umfassen alle direkt dem Entwicklungsprozess zurechenbaren Kosten einschließlich entwicklungsbezogener Gemeinkosten. Fremdkapitalkosten werden nicht aktiviert. Aktivierte Entwicklungskosten werden ab Produktionsstart planmäßig linear über den erwarteten Produktlebenszyklus von in der Regel drei bis fünf Jahren abgeschrieben.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer liegen in der SÜSS-Gruppe nicht vor.

### Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauern für die wesentlichen Anlagekategorien sind nachstehend wiedergegeben:

Grundstücke, Gebäude, Einbauten	10 – 40 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	4 – 5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 – 5 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre

Bei Anlagenabgängen werden die zugehörigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die Differenz zum Verkaufserlös als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Bei gemieteten Anlagegegenständen wird gemäß IAS 17 zwischen „Finance Lease“ und „Operating Lease“ unterschieden. Gegenstände des „Finance Lease“ werden unter Ansatz des Barwerts aller künftigen Mindestleasingzahlungen bei gleichzeitiger Passivierung der Leasingschuld aktiviert. Die aktivierten Gegenstände werden über ihre maßgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die Leasingschuld wird gemäß den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrags getilgt und verzinst. Beim „Operating Lease“ erfolgt keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der periodisierten Leasingzahlungen im Aufwand.

Eine Neubewertung der Sachanlagen gemäß den Regelungen des IAS 16 erfolgte nicht.

### Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

Eine Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte einschließlich des Geschäfts- oder Firmenwerts sowie auf Sachanlagen wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch die zu erwartenden Veräußerungserlöse bzw. die diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt sind. Ist die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Die Zuordnung des Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt auf der Grundlage der Berichtseinheiten (Segmente).

Sofern in den Folgeperioden die Gründe für die Wertminderungen entfallen sind, werden Zuschreibungen vorgenommen. Die Zuschreibung erfolgt dabei höchstens auf den Betrag, der sich ohne die Vornahme der Wertminderung ergeben hätte. Eine Zuschreibung auf abgewertete Geschäfts- oder Firmenwerte erfolgt nicht.

### Sonstige Finanzanlagen

Sonstige Finanzanlagen, auf die kein wesentlicher Einfluss ausgeübt werden kann bzw. die für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung sind, werden der Bewertungskategorie „Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte“ zugeordnet und werden zu Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Wertminderungen angesetzt, da eine zuverlässige Ermittlung des Fair Values nicht möglich ist.



### Vorräte

Die Vorräte werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Nettoveräußerungswert bewertet. Der Nettoveräußerungswert stellt dabei den voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlös abzüglich der bis zum Verkauf noch anfallenden Kosten dar. Zudem werden Bestandsrisiken des Vorratsvermögens, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und technischen Risiken ergeben, durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Herstellungskosten der unfertigen bzw. fertigen Erzeugnisse beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten. Fremdkapitalzinsen sind nicht aktiviert.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt die Ermittlung der Anschaffungskosten auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnittswerts.

Bei Wegfall der Gründe, die zu einer Wertberichtigung der Vorräte geführt haben, wird eine entsprechende Wertaufholung vorgenommen.

### Finanzinstrumente

Finanzinstrumente sind Vertragsverhältnisse, die bei der einen Partei zu einem finanziellen Vermögenswert und bei der anderen Partei zu einer finanziellen Schuld oder zu einem Eigenkapitalinstrument führen. Diese werden in die Klassen „bewertet zu Anschaffungskosten“, „bewertet zu Marktwerten“ und in „Leasingverbindlichkeiten“ eingeteilt.

Das Unternehmen erfasst Finanzinstrumente in der Bilanz, sobald die SÜSS-Gruppe Vertragspartner eines Finanzinstruments wird. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Marktwert. Die Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt entsprechend der Kategorie, der sie zugeordnet sind – den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, den Krediten und Forderungen, den finanziellen Verbindlichkeiten oder den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Die Kategorien „Held to Maturity“ sowie die „Fair Value Option“ werden nicht genutzt.

### Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie Kredite und Forderungen zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen. Diese Wertminderungen werden auf separaten Wertberichtigungskonten erfasst.

### Wertpapiere

Wertpapiere werden als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert. Sie werden zum beizulegenden Zeitwert bilanziert, sofern dieser verlässlich ermittelbar ist. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden unter Berücksichtigung latenter Steuern im Kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen. Im Falle einer Wertminderung wird das Kumulierte übrige Eigenkapital um den Wertminderungsbetrag reduziert und der entsprechende Betrag unmittelbar in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

#### Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Zahlungsmitteläquivalente umfassen alle liquiditätsnahen Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. der Anlage eine Restlaufzeit von weniger als drei Monaten haben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu Anschaffungskosten bewertet.

#### Aktienbasierte Vergütungen

Die Gesellschaft bilanziert ihre Verpflichtungen aus den bestehenden Aktienoptionsplänen gemäß IFRS 2. Der Zeitwert der ausgegebenen Aktienoptionen wird unter Berücksichtigung des Erdienungszeitraums aufwandswirksam im Eigenkapital erfasst. Die Ermittlung des Zeitwerts erfolgt dabei auf Grundlage des Black-Scholes-Modells.

#### Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wird gemäß IAS 19 („Employee Benefits“) bilanziert. Die Verpflichtungen werden mittels des Anwartschaftsbarwertverfahrens („Projected Unit Credit Method“) berechnet. Zukünftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhöhungen der Leistungen werden berücksichtigt. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt auf Basis von Pensionsgutachten unter Einbeziehung der zur Deckung dieser Verpflichtungen bestehenden Vermögenswerte (Planvermögen). Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden erst erfolgswirksam verrechnet, wenn sie außerhalb einer Bandbreite von 10 % des Verpflichtungsumfangs liegen. In diesem Fall werden sie über die künftige durchschnittliche Restdienstzeit der Belegschaft verteilt. Die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsverpflichtungen werden als Bestandteil der Zinsaufwendungen ausgewiesen.

#### Rückstellungen

Rückstellungen werden gemäß IAS 37 gebildet, wenn eine Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, deren Inanspruchnahme wahrscheinlich und wenn die voraussichtliche Höhe des notwendigen Rückstellungsbetrags zuverlässig schätzbar ist. Die Bewertung erfolgt zu Vollkosten. Langfristige Rückstellungen werden auf Grundlage angemessener Zinssätze mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt.

#### Finanzschulden

Die Finanzschulden umfassen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Anleihen und Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und aus Anleihen werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing, die der Klasse „Leasingverbindlichkeiten“ zugeordnet sind, werden gemäß IAS 17 bewertet.

#### Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

#### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

#### Nicht fortgeführte Aktivitäten

Nicht fortgeführte Aktivitäten werden ausgewiesen, sobald ein Unternehmensbestandteil mit Geschäftsaktivitäten und Cashflows, die operativ und für Zwecke der Rechnungslegung vom restlichen Unternehmen klar abgegrenzt werden können, als zur Veräußerung klassifiziert wird oder bereits abgegangen ist und der Geschäftsbereich einen gesonderten wesentlichen Geschäftszweig darstellt.

#### Umsatzrealisierung

Umsatzerlöse aus Maschinenverkäufen werden gemäß IAS 18 mit dem Eigentums- bzw. Gefahrenübergang an den Kunden erfasst, wenn ein Preis vereinbart oder bestimmbar ist und von dessen Bezahlung ausgegangen werden kann.

Ist in Verträgen neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und Endabnahme mit dem Kunden vereinbart, werden Umsatzerlöse erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind.

Umsätze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Serviceverträgen, zeitanteilig realisiert. Im Fall von Ersatzteilverkäufen wird der Umsatz bei Lieferung realisiert.

#### Umsatzkosten

Die Umsatzkosten umfassen die den Umsatzerlösen zuzuordnenden Herstellungs- und Beschaffungskosten der verkauften Erzeugnisse und Ersatzteile. Sie beinhalten neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch Gemeinkosten einschließlich der Abschreibungen auf die Produktionsanlagen und die immateriellen Vermögenswerte sowie die Abwertungen auf die Vorräte.

#### Forschungs- und Entwicklungskosten

Aufwendungen für Forschung und nicht aktivierungsfähige Entwicklungen werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge werden dem operativen Ergebnis zugeordnet und periodengerecht erfasst. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung.

#### Latente Steuern

Latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 („Income Taxes“) für alle temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermögenswerte und Schulden und deren Wertansätzen in der IFRS-Konzernbilanz sowie auf steuerliche Verlustvorträge gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. Latente Steueransprüche auf temporäre Differenzen bzw. Verlustvorträge werden nur dann angesetzt, sofern ihre Realisierbarkeit in näherer Zukunft hinreichend gesichert erscheint.

Auf temporäre Unterschiede beim Geschäfts- oder Firmenwert werden latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschreibungen auf derivative Geschäfts- oder Firmenwerte steuerlich geltend gemacht werden können.

#### Ergebnis pro Aktie (EPS – Earnings per Share)

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach IAS 33 („Earnings per Share“).

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem das Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird.

Das verwässerte Ergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien zuzüglich der zu einer Verwässerung führenden Aktienäquivalente dividiert wird.

#### Derivative Finanzinstrumente

Zur Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken werden in der SÜSS-Gruppe derivative Finanzinstrumente abgeschlossen.

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemäß IAS 39. Derivative Finanzinstrumente werden den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zugeordnet, zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Handelstag. Marktwertänderungen werden grundsätzlich erfolgswirksam unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. Aufwendungen erfasst. Die Gesellschaft wendet Hedge Accounting nicht an, obwohl es sich bei den derivativen Finanzinstrumenten um effektive Sicherungsgeschäfte handelt.

#### Bilanzierung von Zuschüssen

Zuwendungen aus der öffentlichen Hand werden gemäß IAS 20 („Accounting for Government Grants“) nur erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. Sie werden erfolgswirksam behandelt und grundsätzlich in den Perioden verrechnet, in denen die Aufwendungen anfallen, die durch die Zuwendungen kompensiert werden sollen. Zuschüsse, die sich auf aktivierungsfähige Entwicklungskosten beziehen, werden aktivisch abgesetzt.

#### Transaktionen in Fremdwährung

Einkäufe und Verkäufe in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tageskurs umgerechnet. Vermögenswerte und Schulden in Fremdwährung werden mit dem geltenden Währungskurs am Bilanzstichtag in die funktionale Währung umgerechnet. Die aus diesen Umrechnungen entstandenen Fremdwährungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam erfasst.

#### d) Verwendung von Schätzungen

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den IFRS verlangt Einschätzungen und Annahmen, die Einfluss auf den Ausweis von Vermögenswerten und Schulden, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen haben. Die tatsächlichen Werte können in Einzelfällen von den getroffenen Annahmen und Schätzungen abweichen.

#### Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen umfasst in erheblichem Maß Einschätzungen und Beurteilungen einzelner Forderungen, die auf der Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktuellen Konjunkturentwicklungen und der Analyse historischer Forderungsausfälle auf Portfoliobasis beruhen. Soweit das Unternehmen die Wertberichtigung aus historischen

Ausfallraten auf Portfoliobasis ableitet, vermindert ein Rückgang des Forderungsvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt. Zum 31. Dezember 2008 betrug die gesamte Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen T€ 994 (2007: T€ 538).

#### Wertminderungen

Die SÜSS MicroTec AG überprüft den Geschäfts- oder Firmenwert mindestens einmal jährlich auf mögliche Wertminderung. Die Bestimmung des erzielbaren Betrags einer Cash Generating Unit, der der Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet wurde, ist mit Schätzungen des Managements verbunden. Der erzielbare Betrag ist der höhere Wert aus dem beizulegenden Zeitwert, abzüglich der Verkaufskosten, und dem Nutzungswert. Die Gesellschaft bestimmt diese Werte grundsätzlich mit Bewertungsmethoden, die auf diskontierten Cashflows basieren. Diese diskontierten Cashflows werden für einen Fünf-Jahres-Zeitraum ermittelt. Dabei werden für die unmittelbare Zukunft die aus der Konzernplanung abgeleiteten Cashflows zugrunde gelegt. Für die über die Detailplanungsperiode hinausgehenden Cashflow-Prognosen werden geeignete Forecasts aus der Halbleiterzulieferindustrie herangezogen. Auf Basis dieser Forecasts wird für jedes Jahr des Betrachtungszeitraums eine Wachstumsrate ermittelt. Durchschnittlich errechnet sich dabei ein jährliches Wachstum von 1,9 % (2007: 1,5 %). Die Diskontierung der prognostizierten Netto-Cashflows wird unter Nutzung eines risikoadjustierten Zinssatzes in Höhe von 9,2 % (2007: 8,9 %) durchgeführt. Diese Prämissen sowie die zugrundeliegende Methodik können einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts haben.

Ist im Rahmen von Wertminderungstests bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Auch bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten ist die Bestimmung des erzielbaren Betrags der Vermögenswerte gleichermaßen mit Schätzungen des Managements verbunden, was einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung haben kann.

#### Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Verpflichtungen für Pensionen und damit zusammenhängende Aufwendungen und Erträge werden in Übereinstimmung mit versicherungsmathematischen Bewertungen ermittelt. Diese Bewertungen beruhen auf Schlüsselprämissen, darunter Abzinsungsfaktoren, die erwartete Rendite des Fondsvermögens, Gehaltstrends sowie Lebenserwartungen. Die angesetzten Abzinsungsfaktoren spiegeln die Zinssätze wider, die am Bilanzstichtag für hochwertige festverzinsliche Anlagen mit entsprechender Laufzeit erzielt werden.

Aufgrund schwankender Markt- und Wirtschaftslage können die zugrunde gelegten Prämissen von der tatsächlichen Entwicklung abweichen, was wesentliche Auswirkungen auf die Verpflichtungen für Pensionen haben kann.

#### Rückstellungen

Die Bestimmung von Rückstellungen für vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche ist in erheblichem Maß mit Einschätzungen verbunden. Soweit das Unternehmen diese Rückstellungen aus historischen Garantie- und Gewährleistungsfällen ableitet, vermindert ein Rückgang des Umsatzvolumens solche Vorsorgen entsprechend, und umgekehrt.

## e) Konsolidierung

### Konsolidierungsgrundsätze

In den Konzernabschluss werden die Abschlüsse der SÜSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhängig von der Beteiligungshöhe die Beherrschungsmöglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der Stimmrechte wird grundsätzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

### Umrechnung von Jahresabschlüssen in fremder Währung

Die Darstellungswährung des Konzerns ist der Euro, die der funktionalen Währung der Muttergesellschaft entspricht. Alle Angaben erfolgen in tausend Euro, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die jeweilige lokale Währung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.

	2008		2007	
	Bilanz	G&V	Bilanz	G&V
1 € vs 1 USD	1,398	1,474	1,472	1,374
1 € vs 100 JPY	126,400	152,522	165,000	161,628
1 € vs 1 GBP	0,960	0,799	0,735	0,686
1 € vs 1 CHF	1,486	1,585	1,656	1,643
1 € vs 100 TWD	46,267	46,614	47,897	45,118
1 € vs 100 SGD	2,018	2,078	2,115	2,065
1 € vs 100 CNY	9,663	10,301	10,736	10,317
1 € vs 1 KRW	1.784,480	1.604,175	–	–
1 € vs 100 THB	48,855	48,672	43,825	44,546

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (Kumuliertes übriges Eigenkapital) ausgewiesen.

### Angaben zum Konsolidierungskreis

Im vierten Quartal wurde die neugegründete Suss MicroTec Korea Co. Ltd. in den Konsolidierungskreis einbezogen, an der die SÜSS MicroTec AG mit 100 % beteiligt ist. Bei der Suss MicroTec Korea Co. Ltd. handelt es sich um eine reine Vertriebsgesellschaft, welche die Präsenz des Konzerns in Korea verstärken soll. Diese Veränderung im Konsolidierungskreis ist für die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns nicht wesentlich.

Ebenfalls im vierten Quartal wurde die Beteiligung der SÜSS MicroTec AG an der MFI Technologies Group, Vancouver, endkonsolidiert und befindet sich folglich nicht mehr im Konsolidierungskreis. Im Zuge der Vereinfachung der Beteiligungsstruktur im Konzern wurden die beiden zur MFI Technologies Group zählenden Gesellschaften MFI Technologies Inc., Vancouver, und MFI Technologies Corporation, USA, die seit Jahren weder über einen aktiven Geschäftsbetrieb

verfügen noch werthaltige Vermögenswerte halten, abgewickelt. Aus der Endkonsolidierung entstand dem Konzern ein Endkonsolidierungserfolg in Höhe von T€ 121.

Weitere Änderungen des Konsolidierungskreises ergaben sich im Geschäftsjahr 2008 nicht.

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2008 werden demzufolge folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SÜSS MicroTec AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresergebnis der einzelnen Gesellschaften gemäß lokalem Recht und in lokaler Währung):

Gesellschaft	Wäh- rung	gezeichnetes Kapital	Beteiligung	Eigenkapital	Jahresergebnis	Konsoli- dierung
Süss MicroTec AG, Garching	EUR	17.019.126,00	Holding	96.400.251,96	- 405.908,46	
Süss MicroTec Lithography GmbH, Garching	EUR	2.000.100,00	100 %	31.247.556,81	8.415.527,83	voll
Süss MicroTec Test Systems GmbH, Sacka *	EUR	511.291,88	100 %	8.793.426,02	-2.035.622,10	voll
Süss MicroTec Ltd., Coventry	GBP	10.000,00	100 %	1.124.695,86	623.606,11	voll
Süss MicroTec KK, Yokohama	JPY	30.000.000,00	100 %	392.422.800,00	-3.579.375,00	voll
Süss MicroTec S.A.S., Lyon	EUR	1.275.000,00	100 %	-359.291,00	-543.830,00	voll
Süss MicroOptics S.A., Neuchatel	CHF	500.000,00	85 %	3.132.713,38	-60.407,82	voll
Süss MicroTec Inc., Waterbury	USD	105.000,00	100 %	28.233.827,88	-13.455.445,23	voll
Süss MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu	TWD	5.000.000,00	100 %	77.586.344,00	65.230.496,00	voll
Süss MicroTec Company Ltd., Shanghai	CNY	1.655.320,00	100 %	3.840.571,02	-1.640.911,64	voll
Image Technology Inc., Palo Alto	USD	24.287,00	100 %	2.815.502,17	-179.550,45	voll
HUGLE Lithography Inc., San Jose **	USD	1.190.442,00	53,1 %	-39.579,00	1.200,00	at cost
Süss MicroTec Company Ltd, Bangkok ***	THB	4.000.000,00	49 %	15.229.941,87	1.527.639,27	voll
Süss MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim *	EUR	25.564,59	100 %	205.872,06	603.698,79	voll
Süss MicroTec (Singapore) Pte Ltd., Singapur	SGD	25.000,00	100 %	-687.512,67	-677.687,87	voll
Süss MicroTec Korea Co. Ltd., Seoul	KRW	50.000.000,00	100 %	2.743.673,10	-47.256.326,90	voll
Zentrum für Technologie- strukturentwicklung, Glaubitz	EUR	51.129,19	10 %	n/a	n/a	at cost
ELECTRON MEC. S.R.L., Mailand ****	EUR	52.000,00	10 %	1.172.523,00	-19.205,00	at cost

\* Jahresergebnis vor Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrags mit der SÜSS MicroTec AG

\*\* aufgrund von Unwesentlichkeit keine Konsolidierung

\*\*\* Vollkonsolidierung über Kontrollausübung

\*\*\*\* Zahlen laut Jahresabschluss 31.12.2007

Für alle einbezogenen Unternehmen liegen Abschlüsse zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zugrunde.

#### Unternehmenserwerbe

Die Gesellschaft hat weder im Geschäftsjahr 2008 noch im Vorjahr Akquisitionen vorgenommen.

#### Nicht fortgeführte Aktivitäten

Im Vorjahr hat sich die SÜSS MicroTec AG von ihrem Geschäft mit Device Bondern getrennt. Die in St. Jeoire, Frankreich, angesiedelte Suss MicroTec S.A.S., eine 100 %ige Tochter der Konzernholding, hat sich mit dem früheren Management der Suss MicroTec S.A.S. auf die Veräußerung des Device Bonder-Geschäfts an eine vom früheren Management der Suss MicroTec S.A.S. gehaltene Gesellschaft im Rahmen eines Management Buy-out geeinigt.

Im Wege eines Asset Deals wurden die wesentlichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Device Bonder-Geschäfts der Suss MicroTec S.A.S. veräußert. Die Übertragung des Device Bonder-Geschäfts erfolgte mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2007. Der Kaufpreis betrug T€ 2.000 und entsprach damit in etwa der Differenz zwischen übertragenen Vermögenswerten und von der Käuferin übernommenen Verbindlichkeiten zum wirtschaftlichen Übertragungstichtag. Cashwirksame Veränderungen der übertragenen Vermögenswerte und übernommenen Verbindlichkeiten im Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis zum 16. Juli 2007 wurden darüber hinaus zwischen den Parteien ausgeglichen. Aus Konzernsicht ergab sich insgesamt ein Abgangsverlust in Höhe von T€ 98.

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr wickelte der Konzern den zum Vorjahresstichtag noch vorhandenen Auftragsbestand an Device Bondern ab, so dass am Abschlussstichtag keine offenen Aufträge mit Device Bondern mehr vorhanden waren.

Die zum Vorjahresstichtag offenen Kaufpreisforderungen in Höhe von T€ 1.906 wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr vollständig beglichen.



Im Einzelnen stellten sich im Vorjahr die übertragenen Vermögenswerte bzw. die von der Käuferin übernommenen Verbindlichkeiten aus Konzernsicht wie folgt dar:

in T€	16.07.2007
<b>Übertragene Vermögenswerte</b>	
Immaterielle Vermögenswerte	4
Sachanlagen	589
Sonstige langfristige Vermögenswerte	1
Vorräte	4.624
Forderung aus Lieferungen und Leistungen	346
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	793
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	73
	<b>6.430</b>
<b>Von der Verkäuferin übernommene Verbindlichkeiten</b>	
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40
Langfristige Finanzschulden	992
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	3
Kurzfristige Rückstellungen	35
Kurzfristige Finanzschulden	178
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	676
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	196
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	565
	<b>2.685</b>

Die folgenden Erläuterungen zur Konzerngewinn- und Verlustrechnung beinhalten sowohl die fortgeführten als auch die nicht fortgeführten Aktivitäten des Konzerns. Eine getrennte Darstellung der fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten erfolgt in der Konzerngewinn- und Verlustrechnung.

#### Risikoberichterstattung

Auf die Ausführungen zur Risikoberichterstattung im Lagebericht wird verwiesen. Diese sind als Bestandteil dieses Anhangs zu betrachten.

## ERLÄUTERUNGEN ZUR IFRS- KONZERNGEWINN- UND -VERLUSTRECHNUNG

### (3) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2008	2007
Maschinen	122.188	115.294
Ersatzteile	14.219	13.848
Serviceleistungen	6.772	5.327
Sonstige	6.133	11.085
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>149.312</b>	<b>145.554</b>

Hinsichtlich der Aufteilung der Umsatzerlöse auf Produktlinien und Regionen verweisen wir auf die Segmentberichterstattung. Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus dem Maskengeschäft sowie aus den Bereichen Mikrooptik und C4NP.

### (4) Umsatzkosten

In den Umsatzkosten sind insgesamt Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen von T€ 10.925 (2007: T€ 1.888) enthalten, die zu einem Teil von T€ 8.784 außerordentlichen Charakter haben und im dritten Quartal vorgenommen wurden. Davon entfielen T€ 8.020 auf die Abwertung des C4NP-Projektes sowie T€ 663 bzw. T€ 101 auf die Abwertung von Entwicklungsprojekten im Bereich Substrat Bonder bzw. Test Systeme. Einzelheiten zur Abwertung des C4NP-Projekts finden sich unter Textziffer 11. Die Vorjahreszahl enthält keine Wertminderungen.

Zudem sind in die Umsatzkosten Wertminderungen auf Demogeräte und fertige Erzeugnisse von T€ 2.488 (2007: T€ 1.824) und auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie unfertige Erzeugnisse von T€ 2.548 (2007: T€ 2.635) eingeflossen. Diese umfassen Wertminderungen in Höhe von T€ 2.922, die aufgrund technologischer Veralterung vor allem im Bereich Substrat Bonder notwendig wurden. Zusätzlich fielen im Berichtsjahr T€ 1.181 an Wertminderungen (2007: T€ 1.889) im Rahmen der verlustfreien Bewertung angearbeiteter Lagerbestände für die noch auszuliefernden C4NP-Maschinen an.

Weiterhin enthalten die Umsatzkosten Abfindungen in Höhe von T€ 319 (2007: T€ 0), die im Rahmen von Personalabbaumaßnahmen in den Bereichen Substrat Bonder und Test Systeme anfielen.

## (5) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2008	2007
Fremdwährungsgewinne	4.416	2.637
Rückstellungsaufösungen	135	773
Sonstige Zuschüsse	219	65
Endkonsolidierung MFI	121	0
Versicherungsleistungen	44	24
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	578
Mieterträge	0	166
Sonstiges	692	139
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.627</b>	<b>4.382</b>

Durch die Abwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar und dem japanischen Yen im letzten Quartal des Berichtsjahres sind der Gesellschaft Fremdwährungsgewinne aus dem operativen Geschäft entstanden, das in den Fremdwährungen US-Dollar und japanischer Yen abgewickelt wurde. Zudem realisierte das Unternehmen vor allem im ersten Halbjahr Kursgewinne aus der Devisenkursicherung.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 135 (2007: T€ 773) gehen – analog zum Vorjahr – im Wesentlichen auf gesunkene Garantie- und Gewährleistungskosten zurück. Zudem resultierte im Vorjahr die Auflösung aus verminderten Risikovorsorgen bei der Muttergesellschaft.

Im Berichtsjahr fielen keine Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen an. Im Vorjahr konnten die auf Portfoliobasis gebildeten Einzelwertberichtigungen des Konzerns infolge einer sehr niedrigen Ausfallquote von Kundenforderungen reduziert werden.

Die sonstigen Zuschüsse betreffen – wie im Vorjahr – insbesondere erhaltene Aufwandszuschüsse aus Förderprojekten, welche ergebniswirksam zu vereinnahmen waren.

## (6) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2008	2007
Fremdwährungsverluste	3.723	3.797
Zuführung von Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen	563	0
Sonstige Steuern	282	242
Buchverluste aus dem Abgang von Sachanlagen	9	247
Sonstiges	679	1.107
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.256</b>	<b>5.393</b>

Insbesondere durch die weitere Abwertung des US-Dollars im Verhältnis zum Euro sind dem Unternehmen in der ersten Jahreshälfte Fremdwährungsverluste im operativen Geschäft entstanden. Zudem belasteten sowohl realisierte sowie noch unrealisierte Kursverluste aus geschlossenen Fremdwährungskontrakten im Bereich des US-Dollars und des japanischen Yen vor allem im letzten Quartal des Berichtsjahres das Währungsergebnis. Die noch im Vorjahr zu verzeichnenden unrealisierten Währungsverluste aus der Bewertung konzerninterner Fremdwährungsdarlehen, die von der SÜSS MicroTec AG an die Süss MicroTec Inc. ausgereicht wurden, traten im Berichtsjahr nur noch in geringem Umfang auf. Dies ist vor allem auf die Umwandlung wesentlicher Teile eines konzerninternen Fremdwährungsdarlehens in unbefristete Darlehen bzw. in Eigenkapital der US-Tochtergesellschaft zurückzuführen. Entsprechend IAS 21 weist das Unternehmen die Bewertungseffekte aus der Stichtagsbewertung dieser Darlehensposition nicht mehr in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern im Kumulierten übrigen Eigenkapital aus.

Die Zuführung von Wertberichtigungen in Höhe von T€ 563 wurde vor allem in den Segmenten Substrat Bonder und Test Systeme notwendig.

## (7) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich im Berichtsjahr aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen sowie dem sonstigen Finanzergebnis zusammen.

Die Zinsaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

in T€	2008	2007
Bankverbindlichkeiten	671	412
Pensionsrückstellungen	113	247
Optionsanleihe	26	39
Zinsswaps	389	10
Bezahlte Stückzinsen	66	0
Sonstige Zinsaufwendungen	94	0
<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>1.359</b>	<b>708</b>

Unter den Zinsaufwendungen aus Zinsswaps in Höhe von T€ 389 (2007: T€ 10) werden im Wesentlichen die Marktveränderungen der geschlossenen Zinssicherungskontrakte ausgewiesen.

Bei den Zinsaufwendungen aus der Optionsanleihe handelt es sich in Höhe von T€ 8 (2007: T€ 19) um Zinszahlungen an die Anleihegläubiger und in Höhe von T€ 18 (2007: T€ 20) um den Aufstockungsbetrag zur Erreichung des Rückzahlungsbetrags bei Laufzeitende.

Die Zinserträge in Höhe von T€ 584 (2007: T€ 522) resultieren überwiegend aus Geldmarktanlagen sowie Wertpapieren.

Das sonstige Finanzergebnis enthält im Berichtsjahr Avalprovisionen in Höhe von T€ 49. Im Vorjahr enthielt es Wertminderungen auf zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte in Höhe von T€ 108.

## (8) Ertragsteuern

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellen sich wie folgt dar:

in T€	2008	2007
Deutsche Körperschaftsteuer	675	-62
Deutsche Gewerbeertragsteuer	594	-33
Ausländische Ertragsteuer	785	1.245
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.054</b>	<b>1.150</b>
... davon laufend	1.607	1.668
... davon latent	447	-518

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand.

in T€	2008	2007
<b>Angenommener Steuersatz</b>		
Körperschaftsteuer	15,00 %	25,00 %
Solidaritätszuschlag	5,50 %	5,50 %
Gewerbesteuersatz	12,43 %	14,90 %
<b>Kombinierter Steuersatz</b>	<b>28,25 %</b>	<b>37,34 %</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-11.847</b>	<b>5.669</b>
<b>Erwartete Ertragsteuern</b>	<b>-3.347</b>	<b>2.117</b>
Abweichende Steuersätze im Ausland	-865	-642
Steuersatzänderung Inland	0	1.310
Außerplanmäßige Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts	1.250	0
Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen	94	25
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	933	385
Steueraufwand Vorjahre	5	230
Veränderung der Wertberichtigung auf latente Steueransprüche	2.698	-1.044
Veränderung permanenter Differenzen	1.289	0
Inanspruchnahme wertberechtigter Verlustvorträge	0	-1.224
Steuerfreie Erträge	-35	-26
Sonstiges	32	19
<b>Effektive Ertragsteuern</b>	<b>2.054</b>	<b>1.150</b>

Die Gegenüberstellung der erwarteten zu den effektiven Ertragsteuern zeigt eine Abweichung von T€ 5.401. Statt einen Steuerertrag in Höhe von T€ 3.347 auszuweisen, verbuchte das Unternehmen im Berichtsjahr einen Steueraufwand von T€ 2.054.

Der wesentliche Grund für diese Abweichung liegt in hohen Wertberichtigungen auf latente Steueransprüche begründet. Im Geschäftsjahr wurden insgesamt Wertberichtigungen auf latente Steueransprüche in Höhe von T€ 2.698 vorgenommen. Die Wertberichtigungen betrafen neben latenten Steueransprüchen auf Verlustvorträge in Höhe von T€ 2.279 auch gebildete Steueransprüche auf temporäre Differenzen in Höhe von T€ 419. Der größte Teil dieser Wertberichtigungen wurde bei der Suss MicroTec Inc. in den USA notwendig. Im Vorjahr waren auf saldierter Basis noch Zuschreibungen auf latente Steueransprüche in Höhe von T€ 1.044 erforderlich.

Weiterhin trugen die Wertminderung auf den Geschäfts- oder Firmenwert des Maskengeschäfts in Höhe von T€ 1.250 und nicht abzugsfähige Betriebsausgaben in Höhe von T€ 933 zur Abweichung der effektiven Ertragsteuern von den erwarteten Ertragsteuern bei. Die Wertminderung auf den Geschäfts- oder Firmenwert ist steuerlich nicht abzugsfähig und somit als Überleitungsposition anzusetzen. Die nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben beinhalten im Wesentlichen den bei der Muttergesellschaft erfassten Aufwand aus den Aktienoptionsplänen.

In Folge der konzerninternen Übertragung der Anteile an der Suss MicroTec Test Systems GmbH von der Suss MicroTec Inc. an die SÜSS MicroTec AG entstanden permanente Differenzen. Daraus resultiert eine Überleitungsposition zwischen effektiven und erwarteten Ertragsteuern in Höhe von T€ 1.289.

Es wurde keine Steuerabgrenzung auf nicht ausgeschüttete Gewinne von Tochtergesellschaften vorgenommen. Von einer Ermittlung der möglichen steuerlichen Auswirkungen wurde wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands abgesehen.

Die Abgrenzungsposten für latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

in T€	Aktiva		Passiva	
	2008	2007	2008	2007
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.579	1.308	12	5
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.125	781	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	249	37	18	21
Langfristige Rückstellungen	537	179	0	0
Immaterielle Vermögenswerte	2	0	1.029	3.078
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	3	3	350	110
Finanzschulden	0	0	108	30
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	1.097	861
Vorräte	1.474	1.376	48	91
Sachanlagen	1	0	2.688	2.329
Sonstiges	1	1	77	3
Verlustvorträge	3.086	6.809	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>9.057</b>	<b>10.494</b>	<b>5.427</b>	<b>6.528</b>

Der Konzern verfügt über Verlustvorträge in Höhe von T€ 36.841 (2007: T€ 38.747). Davon verfallen im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2013 insgesamt T€ 4.993. Im Zeitraum von 2022 bis 2028 verfallen insgesamt T€ 14.132. Verlustvorträge in Höhe von T€ 17.716 sind unbegrenzt nutzbar.

Die Verringerung der Verlustvorträge im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme von Verlustvorträgen bei der Süss MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec AG.

Für Verlustvorträge in Höhe von T€ 19.125 (2007: T€ 14.640) wurden keine latenten Steuern angesetzt.

In den Abgrenzungsposten für latente Steuern sind zum Bilanzstichtag insgesamt Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern in Höhe von T€ 10.021 (2007: T€ 7.411) enthalten. Diese entfallen in Höhe von T€ 7.944 (2007: T€ 6.004) auf Verlustvorträge und in Höhe von T€ 2.077 (2007: T€ 1.407) auf temporäre Differenzen.

## (9) Ergebnis je Aktie

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses je Aktie.

in T€	2008	2007
Gewinn/Verlust	-13.901	4.519
Abzüglich: Minderheitsanteile	-30	114
Gewinn, der auf die Aktionäre der SÜSS MicroTec AG entfällt	-13.871	4.405
Erhöhung des Gewinns		
durch verwässernd wirkende Optionsanleihe	0	26
<b>Gewinn, der auf Aktionäre der SÜSS MicroTec AG entfällt, nach Berücksichtigung von Verwässerungseffekten</b>	<b>-13.871</b>	<b>4.431</b>
Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien, unverwässert	17.019	17.012
Verwässerung aufgrund der bestehenden Aktienoptionsprogramme	0	61
Effekt aus der verwässernd wirkenden Optionsanleihe	0	373
<b>Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien, verwässert</b>	<b>17.019</b>	<b>17.446</b>
<b>Ergebnis je Aktie in €, unverwässert</b>	<b>-0,82</b>	<b>0,26</b>
<b>Ergebnis je Aktie in €, verwässert</b>	<b>-0,82</b>	<b>0,25</b>

Bestehende Aktienoptionspläne wurden bei der Berechnung des verwässerten Ergebnisses nicht berücksichtigt, da ihre Einbeziehung zu einem negativen Verwässerungseffekt führen würde.

Weitere Informationen zur Optionsanleihe sowie zu den Aktienoptionsprogrammen finden sich im Anhang unter Textziffer 22 und 25.

## (10) Sonstige Angaben zur IFRS – Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung

### Personalaufwand

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS-Gruppe sind im Folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen Positionen enthalten:

in T€	2008	2007
Löhne und Gehälter	40.235	39.915
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	4.458	4.461
Aufwendungen für Altersvorsorge	2.143	2.430
<b>Personalaufwand</b>	<b>46.836</b>	<b>46.806</b>

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung enthalten vor allem die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Die Aufwendungen für Altersvorsorge beinhalten Pensionsaufwendungen aus betrieblichen Versorgungsplänen sowie Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung.

### Materialaufwand

Die Materialaufwendungen betragen in 2008 T€ 56.977 (2007: T€ 52.714).

### Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2008	2007
Immaterielle Vermögenswerte	12.305	3.129
Geschäfts- oder Firmenwert	4.426	0
Sachanlagen	1.630	1.534
<b>Abschreibungen</b>	<b>18.361</b>	<b>4.663</b>

Neben aktivierten Entwicklungskosten in Höhe von T€ 10.925 (2007: T€ 1.888) wurden im Geschäftsjahr Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten in Höhe von T€ 1.380 (2007: T€ 1.239) abgeschrieben. Abschreibungen auf aktivierte immaterielle Leasinggegenstände gab es im Berichtsjahr nicht mehr (2007: T€ 2).

Die auf aktivierte Entwicklungsleistungen vorgenommenen Abschreibungen betreffen in Höhe von T€ 8.784 Wertminderungen. Sie entfallen in Höhe von T€ 8.020 auf das C4NP-Projekt und in Höhe von T€ 663 bzw. T€ 101 auf Produktentwicklungen im Bereich Substrat Bonder und Test Systeme. Die Wertminderungen sind in voller Höhe den Umsatzkosten zugeordnet. Einzelheiten zu den Abschreibungen auf das C4NP-Projekt finden sich unter Textziffer (11).



Der wesentliche Teil der Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten in Höhe von T€ 892 (2007: T€ 1.097) ist in den Verwaltungskosten enthalten.

Zu den Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert verweisen wir auf Textziffer (12) Geschäfts- oder Firmenwert.

Im entsprechenden Vorjahreszeitraum wurden keinerlei Wertminderungen auf das Anlagevermögen vorgenommen.

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN AKTIVA

### (11) Immaterielle Vermögenswerte

Unter den immateriellen Vermögenswerten werden zum Stichtag neben Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten in Höhe von T€ 4.768 (2007: T€ 3.292) Entwicklungsleistungen von T€ 10.345 (2007: T€ 16.191) ausgewiesen.

Die aktivierten Entwicklungsleistungen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Maschinen in den Segmenten Lithografie und Substrat Bonder. Auf aktivierte Entwicklungsleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Produktionslinie für die C4NP-Technologie wurden im Geschäftsjahr Wertminderungen in Höhe von T€ 8.020 vorgenommen. Damit sind alle mit dem C4NP-Projekt in Verbindung stehenden Entwicklungskosten voll wertberichtigt.

Im Berichtsjahr ist es dem Konzern nicht gelungen, neben der Erstinstallation bei IBM einen weiteren Kunden für die C4NP-Technologie zu gewinnen. Damit war die Erstellung eines belastbaren Umsatzszenarios für die C4NP-Maschinen nicht mehr möglich, so dass auf Basis eines im dritten Quartal durchgeführten Impairment-Tests die aktivierten Entwicklungskosten von insgesamt T€ 8.020 wertgemindert werden mussten.

### (12) Geschäfts- oder Firmenwert

Der Rückgang des Geschäfts- oder Firmenwerts im Berichtsjahr auf T€ 17.767 resultiert im Wesentlichen aus der Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts im Bereich Masken in Höhe von T€ 4.426. Der Bereich Masken ist im Segment Sonstige angesiedelt und identisch mit dem Tochterunternehmen Image Technology Inc.

Die Wertminderung wurde aufgrund einer veränderten Umsatz- und Ertragslage erforderlich. Ursache für die deutlich schwächere Entwicklung sind Probleme eines Schlüsselkunden, die sich nachhaltig auf die Geschäftsaussichten auswirken, sowie das im Bereich Maskengeschäft extrem schwierige Marktumfeld. Mit den bereits ergriffenen Kostensenkungsmaßnahmen bei dem Tochterunternehmen geht der Vorstand davon aus, die Basis für eine künftig erfolgreiche Entwicklung, wenngleich auf einem stark reduzierten Umsatzniveau, gelegt zu haben. Eine entsprechende Anpassung des Geschäfts- oder Firmenwerts war vor diesem Hintergrund jedoch unerlässlich.

Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Geschäfts- oder Firmenwert enthält keinen Fremdwährungsanteil mehr. Zum Vorjahresstichtag betrug dieser noch TUSD 9.588. Die aus der Vorjahresstichtagsbewertung resultierenden Fremdwährungsdifferenzen in Höhe von T€ -765 wurden gemäß IAS 21 erfolgsneutral im Kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst.

### (13) Sachanlagen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Sachanlagevermögens sowie ihre Entwicklung im Berichtsjahr sind im Anlagespiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, enthalten.

Im Sachanlagevermögen sind mit einem Restbuchwert in Höhe von T€ 461 (2007: T€ 481) auch geleaste Technische Anlagen und Maschinen, geleaste Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleaste Grundstücke, Gebäude und Einbauten enthalten, die wegen der Gestaltung der ihnen zugrundeliegenden Leasingverträge („Finance Lease“) dem Konzern als wirtschaftlichem Eigentümer zuzurechnen sind.

### (14) Sonstige Finanzanlagen

Der Konzern hält weitere Beteiligungen mit Anteilen von weniger als 20 %. Diese werden bei Vorliegen von Marktwerten mit diesen bewertet. Anderenfalls erfolgt die Bewertung zu Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Wertminderungen.

### (15) Sonstige (langfristige) Vermögenswerte

Die sonstigen langfristigen Vermögenswerte enthalten vor allem Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen, welche die Verrechnungskriterien mit bestehenden Pensionsrückstellungen nicht erfüllen, und von Zeitkontenrückdeckungen sowie geleistete Kautionen für angemietete Bürogebäude.

in T€	2008	2007
Rückdeckungsversicherung	514	398
Kautionen	149	120
Sonstiges	1	1
<b>Sonstige langfristige Vermögenswerte</b>	<b>664</b>	<b>519</b>

### (16) Vorräte

Die Vorräte lassen sich wie folgt aufteilen:

in T€	2008	2007
Materialien und Hilfsstoffe	23.447	25.862
Unfertige Erzeugnisse	19.999	17.795
Fertigerzeugnisse	10.852	6.830
Demonstrationsgeräte	11.722	14.412
Handelswaren	122	110
Wertberichtigungen	-11.546	-11.259
<b>Vorratsvermögen</b>	<b>54.596</b>	<b>53.750</b>

Von dem Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2008 bilanzierten Vorräte in Höhe von T€ 54.596 (2007: 53.750) sind T€ 15.669 (2007: T€ 22.308) zu ihrem Nettoveräußerungswert bilanziert.

## (17) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

in T€	2008	2007
Forderungen gegen Dritte	24.136	26.120
Wertberichtigungen	-994	-538
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>23.142</b>	<b>25.582</b>

Die folgende Tabelle gibt die Veränderungen in den Wertberichtigungen auf den Bestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wieder.

in T€	2008	2007
Wertberichtigungen zum Beginn des Geschäftsjahres	538	1.116
Ausbuchung von Forderungen	-107	-326
Zahlungseingänge und Wertaufholungen auf ursprünglich abgeschriebene Forderungen	-337	-790
Zuführung	900	538
<b>Wertberichtigungen zum Geschäftsjahresende</b>	<b>994</b>	<b>538</b>

## (18) Sonstige finanzielle Vermögenswerte

Unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten sind folgende Positionen ausgewiesen:

in T€	2008	2007
Offene Kaufpreisforderungen	0	1.906
Positive Marktwerte aus Devisentermingeschäften	132	397
Sonstiges	716	720
<b>Sonstige finanzielle Vermögenswerte</b>	<b>848</b>	<b>3.023</b>

Die Gesellschaft weist unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten die positiven Marktwerte aus den Devisentermingeschäften aus. Weitere Einzelheiten zu den Devisentermingeschäften finden sich in der Textziffer 31 „Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente“.

## (19) Wertpapiere

Die SÜSS MicroTec AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Teil ihrer Liquidität in zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere investiert. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Unternehmensanleihen. Dabei wurden ausschließlich Papiere von Unternehmen angeschafft, die über ein Rating im Investmentgradebereich verfügen. Die Bewertung der Wertpapiere erfolgt zu Marktpreisen. Etwaige Marktpreisschwankungen werden erfolgsneutral im Kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet. Zum Bilanzstichtag verfügte die Gesellschaft über Wertpapiere in Höhe von T€ 3.759 (2007: T€ 2).

## (20) Steuererstattungsansprüche

Die langfristigen Steuerforderungen resultieren ausschließlich aus der Aktivierung des Körperschaftsteuer-Guthabens deutscher Konzerngesellschaften in Höhe von T€ 573 (2007: T€ 619) in Folge des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG). Das Guthaben wird in zehn gleichen Jahresbeträgen in den Jahren 2008 bis 2017 ausbezahlt. Da der Auszahlungsbetrag unverzinslich ist, erfolgte eine entsprechende Abzinsung. Dabei wurde ein durchschnittlicher Effektivzinssatz von 3,77 % p. a. zugrunde gelegt.

Die kurzfristigen Steuerforderungen bestehen aus geleisteten Steuervorauszahlungen in Höhe von T€ 298 (2007: T€ 847).

## (21) Sonstige (kurzfristige) Vermögenswerte

Unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten sind folgende Positionen enthalten:

in T€	2008	2007
Aktive Rechnungsabgrenzung	668	716
Geleistete Anzahlungen	208	606
Umsatzsteuer	838	382
<b>Sonstige kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>1.714</b>	<b>1.704</b>

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält Vorauszahlungen für zukünftige Aufwendungen, zum Beispiel Versicherungsbeiträge oder Mietvorauszahlungen.

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PASSIVA

### (22) Eigenkapital

#### Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der SÜSS MicroTec AG betrug zum Vorjahresstichtag T€ 17.019. Da im Berichtsjahr keine Ausübungen von Bezugsrechten erfolgten, bleibt das Grundkapital unverändert. Es ist in 17.019.126 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Gezeichneten Kapital von EUR 1,00 eingeteilt. Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapitalentwicklung.

Jede Stammaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stammaktien sind nicht rückzahlbar und nicht konvertierbar. Dividenden können ausschließlich aus den ausschüttbaren Gewinnen gemäß handelsrechtlichem Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ausgeschüttet werden.

Das genehmigte Kapital beträgt zum Bilanzstichtag T€ 4.255 (2007: T€ 6.022).

Am 31. Dezember 2008 verfügt die Gesellschaft über ein bedingtes Kapital in Höhe von insgesamt T€ 5.369 (2007: T€ 4.469). Es kann bis zu T€ 3.674 für die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen genutzt werden. Der Restbetrag von T€ 1.695 ist für die Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte des Konzerns vorgesehen. Dabei sind T€ 45 dem Aktienoptionsplan 2002, T€ 750 dem Aktienoptionsplan 2005 und T€ 900 einem neuen Aktienoptionsplan zuzuordnen.

in T€	2008	2007
Grundkapital	17.019	17.019
Genehmigtes Kapital	4.255	6.022
Bedingtes Kapital	5.369	4.469

#### Rücklagen

Die Rücklagen des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2008	2007
Kapitalrücklage	92.842	92.212
Gewinnrücklage	433	433
Bilanzverlust	-19.133	-5.262
<b>Rücklagen</b>	<b>74.142</b>	<b>87.383</b>

Der Kapitalrücklage wurden aus der Gewährung von Bezugsrechten im Rahmen der bestehenden Aktienoptionspläne T€ 630 ergebniswirksam zugeführt. Ausübungen von Aktienoptionen gab es im Berichtsjahr nicht.

Die Gewinnrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der Bilanzverlust erhöhte sich durch das negative Jahresergebnis von T€ -13.871 vor Berücksichtigung von Minderheiten auf T€ -19.133.

### Kumuliertes übriges Eigenkapital

Die Entwicklung des Kumulierten übrigen Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

in T€	2008	2007
Fremdwährungsanpassungen	-2.111	-291
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren	0	-63
<b>Stand zu Beginn der Periode</b>	<b>-2.111</b>	<b>-354</b>
<b>Veränderungen vor Steuern</b>		
Fremdwährungsanpassungen	1.358	-1.820
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren	-53	101
<b>Steuereffekte</b>		
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren	15	-38
<b>Stand am Ende der Periode</b>	<b>-791</b>	<b>-2.111</b>

### Eigenkapitalmanagement

Der Vorstand der Gesellschaft geht nach derzeitigem Planungsstand davon aus, im kommenden Geschäftsjahr aus dem operativen Geschäft einen positiven Cashflow zu erwirtschaften. Unabhängig davon besteht bei einer Verfehlung der Planung die Gefahr, dass sich das Eigenkapital in Folge eines Jahresfehlbetrags weiter verringern könnte.

### Aktionsoptionspläne der SÜSS MicroTec AG

#### Aktionsoptionsplan 2002

In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu T€ 500 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 500.000 Aktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften bis zum 31. Dezember 2007 zu erhöhen. Die Bezugsrechte können nach Ablauf einer Wartefrist von zwei Jahren zu 100 % ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- + der Börsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts den Basispreis um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgeübten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts (entspricht 7,5 % für 12 Monate) übersteigt und zusätzlich sich im selben Zeitraum der Börsenkurs prozentual gleich oder besser entwickelt hat als der Nemax Technology Index oder ein eventuell an seine Stelle tretender vergleichbarer Nachfolgeindex

oder

- + der Börsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Ausübung den Basispreis um mindestens durchschnittlich 0,833 % pro vollem Kalendermonat (10 % pro Jahr) zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgeübten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausübung übersteigt.

Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. drei Jahre nach dem Ende der Erwerbsfrist.

#### Aktienoptionsplan 2005

In der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu T€ 750 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 750.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungsstichtag. Die Bezugsrechte können erst nach Ablauf einer Wartefrist von rund zwei Jahren ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- + der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist und der Börsenkurs der SÜSS MicroTec Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDax entwickelt hat

oder

- + der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,8333 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist.

Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. am Ende der Laufzeit. Die Laufzeit der Aktienoptionen beginnt mit dem Ausgabetag und endet nach Ablauf von fünf Jahren.

#### Aktienoptionsplan 2008

In der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu T€ 900 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 900.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungsstichtag. Die Bezugsrechte können erst nach Ablauf einer Wartefrist von rund zwei Jahren ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- + der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist und der Börsenkurs der SÜSS MicroTec Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDax entwickelt hat

oder

- + der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,8333 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist.

Im Geschäftsjahr wurde eine erfolgswirksame Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von T€ 630 (2007: T€ 619) für diese Pläne vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden keine Aktienoptionen ausgegeben. Im Vorjahr wurden aus dem in der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 genehmigten Kapital insgesamt 350.300 Bezugsrechte mit einem Bezugskurs von EUR 8,39 gewährt. Am 31. Dezember 2008 bestanden insgesamt 587.650 Bezugsrechte (2007: 668.950 Bezugsrechte).

Der gewichtete durchschnittliche Marktwert der im Vorjahr gewährten Optionen in Höhe von EUR 3,0392 wurde unter Verwendung des Black-Scholes Optionsbewertungsmodells berechnet.

Die von der Gesellschaft gewährten Bezugsrechte zum Aktienwerb haben sich wie folgt entwickelt:

	Anzahl	gewichteter durchschnittlicher Bezugspreis in €
<b>01.01.2007</b>	<b>413.900</b>	<b>10,85</b>
gewährt 2007	350.300	8,39
ausgeübt 2007	12.200	2,58
verfallen 2007	83.050	30,58
<b>31.12.2007</b>	<b>668.950</b>	<b>7,26</b>
gewährt 2008	0	0,00
ausgeübt 2008	0	0,00
verfallen 2008	81.300	7,30
<b>31.12.2008</b>	<b>587.650</b>	<b>7,26</b>
noch begebbar	900.200	

Nachfolgende Tabelle fasst die Informationen hinsichtlich aller durch die Gesellschaft ausgegebenen Bezugsrechte nochmals zusammen:

Bereich des Bezugspreises	Anzahl Bezugsrechte	gewichteter durchschnittl. Bezugspreis €	gewichtete durchschnittl. Restlaufzeit Monate
unter 2,50 €	4.500	1,11	5
2,50 € – 4,99 €	141.550	4,78	21
5,00 € – 7,49 €	0	0,00	0
7,50 € – 9,99 €	441.600	8,12	25
ab 10,00 €	0	0,00	0
	<b>587.650</b>	<b>7,26</b>	<b>24</b>



## (23) Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Das Unternehmen gewährt verschiedene Versorgungszusagen, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invalidität berücksichtigen. Die Pläne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder. Die Leistungen berechnen sich i.d.R. auf Basis der Gehälter der versicherten Mitarbeiter.

Es ist zwischen leistungs- und beitragsorientierten Versorgungssystemen zu unterscheiden. Bei leistungsorientierten Versorgungszusagen besteht die Verpflichtung des Konzerns darin, die zugesagten Leistungen an ehemalige Mitarbeiter zu erfüllen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet werden.

Bei beitragsorientierten Versorgungsplänen geht der Konzern über die Entrichtung von Beitragszahlungen an zweckgebundene Fonds hinaus keine weitere Verpflichtung ein. Die Beitragszahlungen werden ergebniswirksam erfasst, Rückstellungen werden hier nicht gebildet.

Die Pensionsverpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2008	2007
Inländische Verpflichtungen	1.839	1.935
Ausländische Verpflichtungen	1.187	803
<b>Gesamt</b>	<b>3.026</b>	<b>2.738</b>

### Leistungsorientierte Pläne („Defined Benefit Plans“)

Der Konzern verfügt in Deutschland, Japan und in der Schweiz über leistungsorientierte Pensionspläne. Die vorhandenen Pensionszusagen in Deutschland umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhängigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewählte Personen der Geschäftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

	2008	2007
Abzinsungsfaktor	5,60 %	5,45 % – 5,62 %
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	4,30 % – 5,20 %	3,80 % – 5,00 %
Gehaltssteigerung	0,0 %	0,0 %
Rentensteigerung	2,0 %	1,0 %

Lebenserwartung gem. Richttafeln Dr. Heubeck 2005

Beim Gehalt wurden keine Steigerungsraten berücksichtigt, da in den deutschen Plänen keine aktiven Anwärter mehr enthalten sind.

Die Tochtergesellschaft in Japan verfügt über einen beitragsfreien und ungedeckten leistungsorientierten Pensionsplan, aus dem bestimmte Mitarbeiter nach Ausscheiden aus dem Unternehmen eine Pensionszahlung erhalten. Die Höhe der Pensionszahlung richtet sich nach einem festgelegten Berechnungsschema und sieht für jeden anspruchsberechtigten Mitarbeiter eine Zuwendung von 80 % eines Monatsgehalts pro Beschäftigungsjahr vor. Anspruchsberechtigt ist jeder Mitarbeiter der Gesellschaft nach einer Betriebszugehörigkeit von mindestens drei Jahren.

Die Pensionszusagen der Tochtergesellschaft in der Schweiz umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet in Abhängigkeit vom Grundgehalt. Anspruchsberechtigt sind alle Angestellten und Geschäftsführer der Tochtergesellschaft.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

	2008	2007
Abzinsungsfaktor	3,50 %	3,25 %
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	3,50 %	3,50 %
Gehaltssteigerung	1,5 %	1,5 %
Rentensteigerung	0,8 %	0,8 %

Die Anwartschaftsbarwerte der Versorgungsverpflichtungen und die Marktwerte des Fondsvermögens haben sich in den Geschäftsjahren 2008 und 2007 wie folgt entwickelt:

in T€	2008	2007
<b>Anwartschaftsbarwert am 01.01.</b>	<b>4.174</b>	<b>3.986</b>
Erstmaliger Ansatz Schweiz	0	320
Dienstzeitaufwand	125	168
Zinsaufwand	173	306
Pensionszahlungen	-271	-234
Versicherungsmathematischer (+) Gewinn/(-) Verlust	359	-335
Währungsveränderungen	259	-37
<b>Anwartschaftsbarwert am 31.12.</b>	<b>4.819</b>	<b>4.174</b>

Der versicherungsmathematische Verlust des Geschäftsjahres beruht maßgeblich auf der Erhöhung der prognostizierten Rentensteigerung.

in T€	2008	2007
<b>Planvermögen am 01.01.</b>	<b>1.640</b>	<b>1.281</b>
Erstmaliger Ansatz Schweiz	0	320
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	60	59
Geleistete Fondsdotierungen	-80	1
Versicherungsmathematischer (+) Gewinn / (-) Verlust	1	-21
Währungsveränderungen	43	0
<b>Planvermögen am 31.12.</b>	<b>1.664</b>	<b>1.640</b>

Die Abstimmung des Deckungsstatus mit dem in der Konzernbilanz ausgewiesenen Betrag ergibt folgendes Bild:

in T€	2008	2007
Barwert der Pensionsverpflichtungen	4.819	4.174
Zeitwert des Planvermögens	-1.664	-1.640
<b>Errechnete Pensionsverbindlichkeit</b>	<b>3.155</b>	<b>2.534</b>
Nicht realisierte versicherungsmathematische (+) Gewinne und (-) Verluste	-129	204
<b>Rückstellung</b>	<b>3.026</b>	<b>2.738</b>

Der Barwert der Pensionsverpflichtungen entfällt in Höhe von T€ 2.794 (2007: T€ 2.303) auf fondsfinanzierte Versorgungsansprüche.

Die Pensionsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

in T€	2008	2007
Dienstzeitaufwand	125	168
<b>Personalaufwandskomponente</b>	<b>125</b>	<b>168</b>
Zinsaufwand	173	306
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	-60	-59
<b>Zinsaufwandskomponente</b>	<b>113</b>	<b>247</b>

Die Personalaufwandskomponente des Geschäftsjahres entfällt in Höhe von T€ 36 (2007: T€ 168) auf die Verwaltungskosten und in Höhe von T€ 89 (2007: T€ 0) auf die Vertriebskosten.

Die Entwicklung des Anwartschaftsbarwerts, des Planvermögens sowie der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste unterteilt nach Anwartschaftsbarwert und Planvermögen zeigt folgende Tabelle:

in T€	2008	2007	2006	2005
Anwartschaftsbarwert	4.819	4.174	3.986	4.013
Planvermögen	1.664	1.640	1.281	1.265
<b>Deckungsstatus</b>	<b>3.155</b>	<b>2.534</b>	<b>2.705</b>	<b>2.748</b>

Erfahrungsbedingte Anpassungen gem. IAS 19.120 Ap waren im Betrachtungszeitraum aufgrund des im Rahmen der Bewertung unveränderten Mengengerüsts nicht notwendig.

#### Beitragsorientierte Pläne („Defined Contribution Plans“)

Der Konzern hat für seine Mitarbeiter in den USA, die 21 Jahre oder älter sind und die ein Minimum von 1.000 Stunden pro Jahr arbeiten, einen „Defined Contribution Plan“ eingerichtet. Der Plan beinhaltet zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401 (k) Plan.

Die in den Gewinnbeteiligungsplan einfließenden Beiträge werden jährlich neu bestimmt. Sämtliche Beiträge des Unternehmens werden in einem „Trust Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch über einen Zeitraum von sechs Jahren.

Unter dem 401 (k) Plan beträgt der Arbeitgeberbeitrag USD 0,50 für jeden USD 1,00 des Arbeitnehmerbeitrags bis zu einem maximalen Arbeitnehmerbeitrag von USD 2.000 (d. h. der maximale Arbeitgeberbeitrag beträgt USD 1.000). Anspruch auf den vollen Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf Arbeitgeberbeiträge.

Im Geschäftsjahr 2008 betragen die Aufwendungen des Konzerns für den Gewinnbeteiligungsplan TUSD 0 (2007: TUSD 0) und für den 401 (k) Plan TUSD 120 (2007: TUSD 145).

Weiterhin wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von T€ 1.832 (2007: T€ 1.956) abgeführt.

## (24) (Langfristige) Rückstellungen

Die langfristigen Rückstellungen beinhalten Verpflichtungen des Konzerns aus Altersteilzeitvereinbarungen. Die Rückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

in T€	Stand 01.01.2008	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2008
Altersteilzeit	737	-70	-11	246	902

Die im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geschlossene Altersteilzeitregelung gilt für Arbeitnehmer der Süss MicroTec Lithography GmbH, der SÜSS MicroTec AG und der Süss MicroTec Test Systems GmbH, die das 57. Lebensjahr vollendet haben und im aktuellen Arbeitsverhältnis in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens drei Jahre eine Vollzeitbeschäftigung/Teilzeitbeschäftigung ausgeübt haben.

Während der Dauer der Altersteilzeit wird die bisherige Regelarbeitszeit auf 50 % reduziert. Die während der Altersteilzeit-Gesamtdauer zu erbringende Arbeitszeit wird regelmäßig so verteilt, dass diese vollständig in der ersten Hälfte der Altersteilzeit geleistet wird (Arbeitsphase) und der Mitarbeiter in der zweiten Hälfte von der Arbeitsleistung freigestellt wird (Freistellungsphase).

Zusätzlich zum auf 50 % reduzierten Bruttoarbeitsentgelt erhält der Mitarbeiter einen Aufstockungsbetrag, der so zu bemessen ist, dass das monatliche Altersteilzeit-Nettoentgelt mindestens 82 % des monatlichen Vollzeitnettoarbeitsentgelts beträgt. Der Aufstockungsbetrag wird steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt.

## (25) Finanzschulden

Die Fälligkeitsstruktur der Anleihen, der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing ergibt sich zum 31. Dezember 2008 bzw. zum Vorjahresstichtag wie folgt:

31. Dezember 2008		Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
in T€	Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.614	9.047	0	14.661
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	144	152	0	296
<b>Gesamt</b>	<b>5.758</b>	<b>9.199</b>	<b>0</b>	<b>14.957</b>

31. Dezember 2007		Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
in T€	Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.624	9.082	0	11.706
Verbindlichkeiten aus Anleihen	355	0	0	355
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	205	173	0	378
<b>Gesamt</b>	<b>3.184</b>	<b>9.255</b>	<b>0</b>	<b>12.439</b>

### Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich in Höhe von T€ 5.538 (2007: T€ 1.874) aus der Inanspruchnahme eingeräumter Kreditlinien sowie in Höhe von T€ 9.123 (2007: T€ 9.832) aus langfristigen Darlehensverträgen zusammen.

Die Gesellschaft verfügt über diverse Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten. Die gesamten Kreditlinien und deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	2008	2007
Kreditlinie	10.388	16.188
Inanspruchnahme	5.538	1.874
<b>Verfügbare Kreditlinie</b>	<b>4.850</b>	<b>14.314</b>

Die Reduzierung der Kreditlinien resultiert im Wesentlichen aus der Neustrukturierung der bestehenden Inlandskreditlinie. So wurde die bisher zur Verfügung gestellte Kreditlinie von T€ 12.000 auf T€ 6.000 reduziert und das Bankenkonsortium von drei auf zwei Banken verkleinert. Zum Bilanzstichtag lagen die entsprechenden Kreditzusagen dieser Banken vor. Mit einer dieser Banken wurden die erforderlichen Kreditverträge noch im Berichtsjahr unterzeichnet, so dass ein Teil der Linie von T€ 3.000 zum Bilanzstichtag effektiv zur Verfügung stand. Die Kreditvereinbarung mit der zweiten Bank des Konsortiums wurde im Januar 2009 unterschrieben.

Die neue Linie wurde ohne Covenants vereinbart und ist zunächst bis zum 31. März 2009 befristet. Sie ist – unverändert zur abgelaufenen Kreditlinie – mit der Verpfändung von Umlaufvermögen der betroffenen Inlandsgesellschaften verbunden und kann wahlweise als Bar- oder Avallinie in Anspruch genommen werden. Zum Bilanzstichtag ist die Linie in Höhe von T€ 2.089 in Form von Avalen genutzt.

Im Gegenzug konnte eine lokale Kreditlinie in Japan von Mio. YEN 300 im Vorjahr auf Mio. YEN 700 ausgeweitet werden. Diese Linie wird von zwei Banken gestellt und wurde ohne Sicherheiten gewährt. Sie ist zum Bilanzstichtag voll in Anspruch genommen.

Der durchschnittliche Zinssatz für die Inanspruchnahme der Kreditlinien betrug 1,98 % (2007: 4,34 %).

Die Gesellschaft hat im Vorjahr unter der Führung der UniCredit (HVB) ein Schuldscheindarlehen in Höhe von insgesamt T€ 9.000 platziert. Das Schuldscheindarlehen besteht aus drei Platzierungen in Höhe von jeweils T€ 3.000, wobei eines mit 6 % verzinst wird und zwei eine variable Verzinsung haben. Das Darlehen hat eine Laufzeit von fünf Jahren und dient der Refinanzierung kurzfristiger Verbindlichkeiten sowie der mittel- bis langfristigen Unternehmens- und Investitionsfinanzierung. Es ist unbesichert und an die Einhaltung verschiedener Financial Covenants gebunden. Zur Vermeidung von Zinsrisiken wurden die beiden variablen Schuldscheine von der Gesellschaft mit laufzeitkongruenten Swap-Kontrakten gesichert.

Die Darlehensstände per Ende des Geschäftsjahres waren wie folgt:

Konzerngesellschaft in T€	2008	2007	Zinssatz	Fälligkeit
SÜSS MicroTec AG	2.976	2.970	6,00 %	18.12.2012
SÜSS MicroTec AG	2.976	2.970	6,17 %	18.12.2012
SÜSS MicroTec AG	2.976	2.970	6,06 %	21.12.2012
Suss MicroTec Test Systems GmbH	0	318	3,25 %	31.3.2008
Suss MicroTec Lithography GmbH	13	366	3,75 %	30.4.2011
Image Technology Inc.	182	238	9,27 %	26.3.2011
Sonstige Darlehen < 1 Mio. €	0	0		
<b>Gesamt</b>	<b>9.123</b>	<b>9.832</b>		
davon kurzfristig fällig	76	750		
davon langfristig fällig	9.047	9.082		
... fällig in 2009	76			
2010	84			
2011	35			
2012	8.928			
2013	0			
... später	0			
	<b>9.123</b>			

#### Verbindlichkeiten aus Anleihen

Die SÜSS MicroTec AG hat vereinbarungsgemäß am 31. Oktober 2008 den noch offenen Teil der in 2004 begebenen Optionsanleihe zurückgezahlt. Sie war mit 6 % p.a. verzinst. Der Bilanzausweis der Optionsanleihe erfolgte nach Verrechnung mit den über die Laufzeit der Anleihe zu amortisierenden Ausgabekosten.

### Verbindlichkeiten aus Finance Lease

Die Gesellschaft least derzeit diverse Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände sowohl im Fertigungs- wie auch im Verwaltungsbereich unter Operating-Lease-Verträgen. Darüber hinaus bestehen bezüglich Gebäuden, Grundstücken und Einbauten, Technischen Anlagen und Maschinen sowie anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Finance-Lease-Verträge, deren zugrundeliegende Vermögenswerte aktiviert und planmäßig abgeschrieben werden. Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten sowie die künftigen finanziellen Verpflichtungen aus Operating Lease stellen sich wie folgt dar:

in T€	Finance Lease	Operating Lease	davon Operating Lease mit nahestehenden Personen
Abschreibungen/Aufwendungen 2008	186	3.053	931
Abschreibungen/Aufwendungen 2007	186	2.769	1.785
Künftige Verpflichtungen ... fällig in 2009	189	2.899	0
2010	54	2.600	0
2011	53	1.884	0
2012	35	1.758	0
2013	2	1.250	0
... später			
<b>Gesamt zukünftig</b>	<b>333</b>	<b>10.391</b>	<b>0</b>
Zinsanteil	37		
<b>Verbindlichkeit 31.12.2008</b>	<b>296</b>		
davon kurzfristig	144		
davon langfristig	152		

### (26) Sonstige (langfristige) finanzielle Verbindlichkeiten

Zum Bilanzstichtag weist die Gesellschaft sonstige langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von T€ o (2007: T€ 51) aus.

### (27) (Kurzfristige) Rückstellungen

Die kurzfristigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2008	2007
Garantierückstellungen	1.907	1.838
Abfindungen	683	9
Übrige Rückstellungen	571	1.075
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>3.161</b>	<b>2.922</b>



Die Garantierückstellungen wurden für gesetzliche und vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche von Kunden aus Maschinenlieferungen in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

In der Rückstellung für Abfindungen sind durchgeführte Personalabbaumaßnahmen an den Standorten Dresden und Lyon, Frankreich, sowie das Ausscheiden von Herrn Dr. Schneidewind berücksichtigt.

Die kurzfristigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt

in T€	Stand 01.01.2008	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2008
Garantierückstellungen	1.838	-1.062	-59	1.190	1.907
Abfindungen	9	-3	-6	683	683
Übrige Rückstellungen	1.075	-1.001	-59	556	571
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>2.922</b>	<b>-2.066</b>	<b>-124</b>	<b>2.429</b>	<b>3.161</b>

## (28) Sonstige (kurzfristige) finanzielle Verbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in T€	2008	2007
Prämien und Provisionen	1.743	1.116
Fremdleistungen	1.591	1.660
Aufsichtsratsvergütung	87	165
Negative Marktwerte aus Devisentermingeschäften	361	0
Negative Marktwerte aus Zinsswaps	351	10
Sonstiges	1.232	1.138
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>	<b>5.365</b>	<b>4.089</b>

Die Gesellschaft weist unter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten die negativen Marktwerte aus den Devisentermingeschäften und Zinsderivaten aus. Weitere Einzelheiten zu den Devisentermingeschäften und Zinssicherungsgeschäften finden sich in Textziffer 31 „Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente“.

## (29) Sonstige (kurzfristige) Verbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in T€	2008	2007
Erhaltene Anzahlungen	19.368	14.323
Abgegrenzte Personalkosten	3.489	4.914
Passive Rechnungsabgrenzung	776	597
Umsatzsteuer	555	183
<b>Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>24.188</b>	<b>20.017</b>

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten alle Kundenanzahlungen für Maschinen vor der endgültigen Abnahme. Nach erfolgter Abnahme und entsprechender Umsatzrealisierung werden die Anzahlungen mit den entstandenen Forderungen verrechnet.

In den abgegrenzten Personalkosten sind im Wesentlichen Verpflichtungen für Urlaubsrückstände und Gleitzeitguthaben enthalten.

## (30) Steuerschulden

Die Steuerverbindlichkeiten enthalten inländische Ertragsteuern in Höhe von T€ 201 (2007: T€ 2.005) und ausländische Ertragsteuern in Höhe von T€ 600 (2007: T€ 208).

## SONSTIGE ANGABEN

### (31) Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente

Unter Finanzinstrumente fallen nach IAS 32 grundsätzlich sämtliche auf vertraglicher Basis vorgenommene wirtschaftliche Vorgänge, die einen Anspruch auf Zahlungsmittel beinhalten. Hierzu gehören einerseits originäre Finanzinstrumente wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen als auch Finanzforderungen und -verbindlichkeiten. Weiterhin umfassen die Finanzinstrumente auch derivative Instrumente, die zur Sicherung von Währungs- und Zinsänderungsrisiken eingesetzt werden. Die geschätzten Marktwerte der Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer tatsächlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren würde. Folgender Abschnitt gibt einen umfassenden Überblick über die Bedeutung von Finanzinstrumenten für das Unternehmen und liefert zusätzliche Informationen über Bilanzpositionen, die Finanzinstrumente enthalten.

Die folgende Tabelle zeigt die Buchwerte aller Kategorien von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:

in T€	2008	2007
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>		
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	3.759	2
Kredite und Forderungen	23.858	28.208
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	132	397
	<b>27.749</b>	<b>28.607</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>		
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten	712	10
Finanzielle Verbindlichkeiten	24.430	25.019
	<b>25.142</b>	<b>25.029</b>

Die folgende Tabelle stellt die Marktwerte sowie die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dar.

in T€	2008		2007	
	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	20.603	20.603	20.092	20.092
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.142	23.142	25.582	25.582
Sonstige Finanzanlagen	5	5	5	5
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	848	848	3.023	3.023
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	716	716	2.626	2.626
bewertet zum Marktwert	132	132	397	397
Wertpapiere, bewertet zum Marktwert	3.759	3.759	2	2
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.116	5.116	8.828	8.828
Finanzschulden	14.957	14.939	12.439	12.524
Optionsanleihe	0	0	355	391
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.661	14.617	11.706	11.758
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	296	322	378	375
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	5.365	5.365	4.140	4.140
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	4.653	4.653	4.130	4.130
bewertet zum Marktwert	712	712	10	10

Für die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

**Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente:** Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen den Marktwerten der Instrumente.

**Forderungen/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:** Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

**Sonstige Finanzanlagen:** Eine zuverlässige Ermittlung des Marktwerts der sonstigen Finanzanlagen ist nicht möglich. Die sonstigen Finanzanlagen sind für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens von untergeordneter Bedeutung.

**Sonstige finanzielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten:** Die Buchwerte der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in etwa dem Marktwert.

Die Bewertung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu Marktwerten bewertet werden, hängt von ihrem Typ ab. Der Marktwert von Devisentermingeschäften bestimmt sich in Abhängigkeit von Devisenterminkursen. Der Marktwert von Zinsderivaten bestimmt sich durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme über die Restlaufzeit des Kontrakts auf der Basis aktueller Marktzinsen und der Zinsstrukturkurve.

**Wertpapiere:** Der Marktwert der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte entspricht dem Kurswert in einem aktiven Markt.

**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:** Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

**Optionsanleihe:** Zur Ermittlung des Marktwerts der auf Basis der Optionsanleihe bestehenden Finanzverbindlichkeiten wurde die bestehende Verzinsung mit einem Referenzzinssatz verglichen, den ein Kreditinstitut verwenden würde. Dabei wurden insbesondere die Nachrangigkeit und die fehlende Besicherung der Optionsanleihe berücksichtigt. Ebenso wurden Annahmen für das aktuelle Rating des Konzerns getroffen.

**Verbindlichkeiten aus Finance Lease:** Der Marktwert der Verbindlichkeiten aus Finance Lease wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Die Nettogewinne bzw. -verluste aus Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	2008	2007
Kredite und Forderungen	107	326
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	-967	32
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	8	-108

Nettogewinne bzw. -verluste aus Krediten und Forderungen enthalten Veränderungen in den Wertberichtigungen, Gewinne und Verluste aus der Ausbuchung sowie Zahlungseingänge auf ursprünglich abgeschriebene Darlehen und Forderungen.

Nettogewinne bzw. -verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten enthalten Marktwertveränderungen der derivativen Finanzinstrumente.

Im Berichtsjahr wurde die Marktwertveränderung der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte in Höhe von T€ 53 – nach der Berücksichtigung latenter Steuern – im Kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst. Im Vorjahr erfolgte die Berücksichtigung der Marktpreisveränderung aufgrund der nachhaltigen Wertminderung unmittelbar in der Gewinn- und Verlustrechnung. Darüber hinaus wurden aus dem gleichen Grund die in Vorjahren im Kumulierten übrigen Eigenkapital erfassten Marktschwankungen in Höhe von T€ 101 ergebniswirksam angepasst.

#### Derivative Finanzinstrumente

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen und Zinsrisiken zu begrenzen.

Die Marktwerte der einzelnen Arten von derivativen Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	2008		2007	
	Aktiva	Passiva	Aktiva	Passiva
Devisentermingeschäfte	132	361	397	0
Zinsswaps	0	351	0	10

Konzerninterne Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwährungen entstehen durch grenzübergreifende Lieferbeziehungen zwischen den Tochtergesellschaften. Dies betrifft vor allem die Konzerngesellschaften in den Währungsräumen des US-Dollars und des japanischen Yen, die Produkte von Schwestergesellschaften aus dem Euro-Währungsraum beziehen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrags werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um Währungsveränderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschäft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen. Die Veränderung der Marktwerte weist das Unternehmen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Die potenziellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Währungskurse und andererseits im Bonitätsrisiko der Gegenpartei, die ausschließlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonität besteht.

Das Unternehmen ist bestrebt, Zinsrisiken, die sich aus der Sensitivität von Finanzschulden in Bezug auf Schwankungen des Marktzinssniveaus ergeben können, durch den Einsatz von Zinsderivaten, wie Zinsswaps, zu begrenzen. So hat die Gesellschaft den variablen Teil des im Vorjahr begebenen Schuldscheindarlehens mit laufzeitkongruenten Swap-Kontrakten gesichert. Die Zinsswaps gleichen die Auswirkung zukünftiger Veränderungen der Zinssätze auf die Zahlungsströme der zugrunde liegenden variabel verzinslichen Anlagen aus. Das Unternehmen weist die Zinsswaps zum Marktwert in der Konzernbilanz aus. Da Hedge Accounting nicht angewendet wird, werden die Marktwertschwankungen in den Zinserträgen bzw. -aufwendungen erfasst.

### (32) Nahestehende Personen

Nach IAS 24 müssen Personen angegeben werden, die die SÜSS MicroTec AG beherrschen oder von ihr beherrscht werden, soweit sie nicht bereits in den Konzernabschluss einbezogen wurden.

Beherrschung liegt vor, wenn ein Aktionär mehr als die Hälfte der Stimmrechte der SÜSS MicroTec AG hält oder kraft Satzung oder vertraglicher Vereinbarung die Möglichkeit besitzt, die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG zu steuern.

Darüber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach IAS 24 auf Geschäfte mit Joint Ventures sowie auf Geschäfte mit Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG ausüben, einschließlich naher Familienangehöriger oder zwischengeschalteter Unternehmen. Ein maßgeblicher Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik des Konzerns kann hierbei auf einem Anteilsbesitz an der SÜSS MicroTec AG von 20 % oder mehr, einem Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG oder einer anderen Schlüsselposition im Management beruhen.

Der Konzern wird im Geschäftsjahr 2008 von den Angabepflichten nach IAS 24 in Bezug auf die Geschäftsbeziehungen zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG und deren nahen Familienangehörigen berührt.

Am 19. Juni 2008 hat Dr. Winfried Süß sein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec niedergelegt. Alle bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Aufwendungen, die oben genannte Kriterien erfüllen, sind im Folgenden dargestellt.

#### SÜSS Grundstücksverwaltungsgesellschaft GbR und Hunger Mountains

Verschiedene Konzerngesellschaften (Suss MicroTec Lithography GmbH, Suss MicroTec Test Systems GmbH, Suss MicroTec Inc.) mieten ihre Geschäftsräumlichkeiten von der SÜSS Grundstücksverwaltungs GbR oder der Grundstücksgesellschaft Hunger Mountains, USA. Die daraus resultierenden Mietaufwendungen sind unter Textziffer 25 dargestellt.

in T€	2008	2007
Mietaufwendungen	931	1.785

#### Familie Süß

Die nachfolgende Tabelle stellt die wesentlichen Beziehungen zwischen dem Unternehmen und der Familie Süß dar. Die Pensionsansprüche sind unter Textziffer 23 dargestellt.

in T€	2008	2007
Gehälter und Pensionen	233	415

#### Peter Heinz

Herr Peter Heinz, der bis zum 19. Juni 2008 Mitglied des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG war, ist seit 2007 Mitglied des Boards der Image Technology Inc., einer 100 %igen Tochtergesellschaft der Suss MicroTec Inc. Für seine Tätigkeit erhielt Herr Heinz anteilig eine Vergütung von T€ 4.

Hinsichtlich der Vergütungen an den Aufsichtsrat und den Vorstand verweisen wir auf Textziffer 36.

### (33) Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2008	2007
Bestellobligo	10.458	9.142
Mietverpflichtungen	9.843	3.722
Sonstiges	1.123	267
<b>Summe</b>	<b>21.424</b>	<b>13.131</b>

Das Bestellobligo verpflichtet das Unternehmen zu einer späteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

In Folge des Ausscheidens von Herrn Dr. Süß aus dem Aufsichtsrat enthalten die Verpflichtungen aus Mietverträgen keine Verpflichtungen gegenüber nahestehenden Unternehmen bzw. Personen mehr (2007: T€ 3.335).

### (34) Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung

In der Konzern-Kapitalflussrechnung des SÜSS-Konzerns wird entsprechend IAS 7 („Cash Flow Statements“) zwischen Zahlungsströmen aus betrieblicher Geschäftstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d. h. Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten ohne nennenswerte Wertschwankungen verfügbar sind. Im Berichtsjahr diente ein Teil von T€ 350 (2007: T€ 350) der ausgewiesenen flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag als Sicherheit für einen Kautionsversicherungsvertrag. Zudem wurde ein Guthaben von T€ 362 (2007: T€ 0) zur Deckung einer Mietbürgschaft verpfändet.

Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden zahlungsbezogen ermittelt. Demgegenüber wird der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ausgehend vom Jahresergebnis indirekt abgeleitet.

Im Rahmen der indirekten Ermittlung werden die berücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen um Effekte aus der Währungsumrechnung bereinigt. Die Veränderungen der betreffenden Bilanzpositionen können daher nicht mit den entsprechenden Werten auf Grundlage der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in Höhe von T€ - 1.628 (2007: T€ 2.090) beinhalten im Wesentlichen Währungseffekte.

### (35) Segmentberichterstattung

#### Informationen zu den Segmenten

Die Aktivitäten des SÜSS-Konzerns werden im Rahmen der Segmentberichterstattung gemäß den Regeln von IAS 14 („Segment Reporting“) nach Produktlinien als primärem Berichtsformat und nach Regionen als sekundärem Berichtsformat abgegrenzt. Diese Aufgliederung orientiert sich an der internen Steuerung sowie Berichterstattung und berücksichtigt die unterschiedlichen Risiko- und Ertragsstrukturen der Segmente.

Die Aktivitäten des SÜSS-Konzerns werden in die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Test Systeme aufgeteilt. Das im Juli 2007 aufgegebenes Segment Device Bonder wurde im Berichtsjahr letztmals als eigenes Segment dargestellt, da der zum Übertragungstichtag vorhandene Auftragsbestand an Device Bondern bis zum Bilanzstichtag abgearbeitet war. Zudem werden im Segment Sonstige weitere Aktivitäten des Konzerns sowie die nicht zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen gebündelt.

Im Segment **Lithografie** entwickelt, produziert und vertreibt der SÜSS-Konzern die Produktlinien Mask Aligner und Coater. Die Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten sind in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Vaihingen bei Stuttgart angesiedelt. Darüber hinaus sind wesentliche Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien für dieses Segment tätig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäfts der Gruppe dar und ist in den Märkten Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Advanced Packaging vertreten.

Im Segment **Substrat Bonder** sind die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb der Produktlinie Substrat Bonder ausgewiesen. Die Aktivitäten in diesem Segment sind vor allem am Standort Waterbury, Vermont, in den USA konzentriert. Der Vertrieb ist über Waterbury hinaus weltweit in kleinen Einheiten an Standorten in Europa und in Asien ansässig. Insbesondere der sogenannte Bond Cluster, der vakuumfreies Bonden ermöglicht, stellt ein wesentliches Standbein dieses Segmentes dar. Daneben werden vor allem manuelle Maschinen für 6 und 8 Zoll Wafer-Anwendungen angeboten.

Das Segment **Test Systeme** ist in Sacka bei Dresden beheimatet. Entwicklung, Produktion sowie der Vertrieb in Europa sind dort angesiedelt. In den internationalen Vertriebsorganisationen (Nordamerika, Asien) arbeiten nach der Lithografie die meisten Mitarbeiter für dieses Segment. Die Test Systeme sind im Wesentlichen für Laboranwendungen, insbesondere z. B. für die Fehleranalyse, aber auch teilweise für Anwendungen im Produktionsumfeld (Mikrosystemtechnik, LED-Testsysteme) bestimmt.

Das im Vorjahr verkaufte Segment Device Bonder befasste sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb der Produktlinie Device Bonder. Die Segmentaktivitäten waren in St. Jeoire, Frankreich, ansässig. An diesem Standort befanden sich neben der Entwicklung und Produktion auch wesentliche Teile der Vertriebsorganisation. Aufgrund der technischen Komplexität und der geringen Größe des Markts waren keine weiteren wesentlichen Vertriebsorganisationen innerhalb des Konzerns für dieses Segment tätig.

Im Segment **Sonstige** werden neben den nicht zuordenbaren Kosten der SÜSS MicroTec AG die operativen, nicht den Segmenten zugeordneten Aktivitäten im Maskenbereich, im Bereich Mikrooptik sowie im Bereich C4NP gezeigt.

#### Sonstige Erläuterungen zur Segmentberichterstattung

Die Segmentdaten wurden auf der Grundlage der im Konzernabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ermittelt. In Folge der gesellschaftsübergreifenden Segmentierung des Konzerns nach Produktlinien treten grundsätzlich keine wesentlichen intersegmentären Transaktionen auf. Eine Ausnahme bilden die Weiterbelastungen der SÜSS MicroTec AG, die im Segment Sonstige erfasst sind, an die anderen Segmente für die Wahrnehmung bestimmter Konzernfunktionen wie Finanzierungs- und Strategiefragen. Diese Weiterbelastungen enthalten im Berichtsjahr erstmals die in der Holding angefallenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Systembetrieb von SAP.



Abweichend zur Darstellung im Konzernabschluss des Vorjahres wurde die Ermittlung des Segmentergebnisses angepasst. Es enthält nun auch Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung und aus Anlagenabgängen. Die Summe der Segmentergebnisse entspricht damit dem operativen Konzernergebnis (EBIT). Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie Ertragsteuern fließen bislang nicht ins Segmentergebnis ein. Der Ausweis der Vorjahreszahlen wurde entsprechend angepasst.

Unter den wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen werden neben Wertberichtigungen auf Forderungen und Abwertungen auf das Vorratsvermögen auch der Personalaufwand aus den Aktienoptionsplänen sowie die Auflösung von Rückstellungen gezeigt.

Das Segmentvermögen stellt das betriebsnotwendige Vermögen der einzelnen Segmente dar. Es umfasst die immateriellen Vermögenswerte inkl. Geschäfts- oder Firmenwert, die Sachanlagen sowie das Vorratsvermögen und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den Segmentschulden sind die operativen Schulden und Rückstellungen der einzelnen Segmente enthalten.

Bei den Investitionen handelt es sich um Zugänge von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen.

Die Abschreibungen enthalten im Berichtsjahr Wertminderungen in Höhe von T€ 13.210. Diese fielen in Höhe von T€ 663 im Segment Substrat Bonder, in Höhe von T€ 101 im Segment Test Systeme und in Höhe von T€ 12.446 im Segment Sonstige an. Die Wertminderungen im Segment Sonstige setzen sich in Höhe von T€ 4.426 aus der Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts des Bereichs Masken und in Höhe von T€ 8.020 aus der Wertminderung auf die aktivierten Entwicklungskosten für das C4NP-Projekt zusammen. Im Vorjahr wurden keine Wertminderungen vorgenommen.

Abweichend zur Darstellung im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2007 hat die SÜSS MicroTec AG den Ausweis der Mitarbeiterzahlen in der Segmentberichterstattung angepasst. Die Mitarbeiter in den Verwaltungsbereichen des Konzerns werden erstmals im Berichtsjahr dem Segment zugeordnet, für das sie überwiegend tätig sind. Bisher wurden diese Mitarbeiter dem Segment „Sonstige“ zugeordnet. Der Ausweis in der entsprechenden Vorjahresperiode wurde angepasst.

Für die geographische Segmentberichterstattung werden die Umsatzerlöse nach dem Standort der Kunden segmentiert. Das Vermögen und die Investitionen wurden auf der Grundlage des Standorts der jeweiligen Konzerngesellschaft ermittelt.

## (36) Vorstand und Aufsichtsrat

### Vorstand der Konzernobergesellschaft

Mitglieder des Vorstands der SÜSS MicroTec AG im Jahr 2008 waren:

**Dr. Stefan Schneidewind** Dipl.-Ingenieur, Oberschleißheim, Vorstandsvorsitzender bis 2. Oktober 2008

Zuständigkeitsbereiche: Forschung und Entwicklung, Patentwesen, Materialwirtschaft und Logistik, Produktion, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement und Umweltschutz, Vertrieb und Marketing, Konzernstrategie

**Michael Knopp** Diplomkaufmann, Ratingen, Mitglied des Vorstands

Zuständigkeitsbereiche: Finanz- und Rechnungswesen, Informatik, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal, Facility Management, Investor Relations (interimistisch ab 2. Oktober 2008: Vertrieb und Marketing, Forschung und Entwicklung, Patentwesen, Konzernstrategie)

**Christian Schubert** Diplomkaufmann, Metten, Mitglied des Vorstands seit 2. Oktober 2008

Zuständigkeitsbereiche: Materialwirtschaft und Logistik, Produktion, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Umweltschutz

Die Bezüge des Vorstands enthalten fixe und variable Bestandteile. Als fixe Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder monatliche Gehaltszahlungen, Zuschüsse zur Sozialversicherung sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit.

Als kurzfristige variable Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen orientiert. Eine nachträgliche Änderung der definierten Ziele ist ausgeschlossen.

Die gesamte Barvergütung des Vorstands betrug im Geschäftsjahr T€ 598. Neben dem bezogenen Fixgehalt (einschließlich der Zuschüsse zur Sozialversicherung und dem geldwerten Vorteil aus der privaten Nutzung des Firmenfahrzeugs) wurden Herrn Dr. Schneidewind und Herrn Knopp insgesamt T€ 141 bzw. T€ 29 aus der zum Vorjahresstichtag gebildeten Rückstellung für den variablen Gehaltsbestandteil ausbezahlt.

Herr Dr. Schneidewind wurde mit Wirkung zum 2. Oktober 2008 als Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft abberufen.

Für den Jahresbonus 2008 von Herrn Dr. Schneidewind, Herrn Knopp und Herrn Schubert wurde im Geschäftsjahr eine Rückstellung von T€ 100 gebildet.

Diese Vergütungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder auf:

	2008			2007			
in T€	Dr. Stefan Schneide-wind	Michael Knopp	Christian Schubert	Dr. Stefan Schneide-wind	Michael Knopp	Dr. Stefan Reineck	Stephan Schulak
<b>Barvergütung</b>							
Fixum	221	215	62	295	70	200	58
Erfolgsbezogen	32	53	15	158	33	0	0
<b>Summe</b>	<b>253</b>	<b>268</b>	<b>77</b>	<b>453</b>	<b>103</b>	<b>200</b>	<b>58</b>
<b>Aktioptionen</b>							
Anzahl	–	–	–	70.000	30.000	40.000	0
Ausübungspreis	–	–	–	8,39	8,39	8,39	n/a

Weiterhin wurden aufgrund der in 2006 und 2007 an Vorstände gewährten Optionen T€ 287 (2007: T€ 222) als Personal-aufwand in der Holding erfasst.

Für ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft besteht eine Pensionsrückstellung von T€ 5 (2007: T€ 4).

Zudem wurden Gehaltszahlungen in Höhe von T€ 74 (2007: T€ 0) an ein ehemaliges Vorstandsmitglied geleistet sowie eine Rückstellung von T€ 282 (2007: T€ 0) für noch zu zahlende Gehälter gebildet.

### Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr 2008:

**Dr. Winfried Süs**                            München, Geschäftsführer i.R., Aufsichtsratsvorsitzender bis 19. Juni 2008

**Gerhard Rauter**                            Dresden, Produktionsvorstand bei der Q-Cells AG in Bitterfeld-Wolfen, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender bis 19. Juni 2008

weitere Mandate:                            SOLIBRO GmbH, Bitterfeld-Wolfen (Mitglied im Beirat)  
 Calyxo GmbH, Bitterfeld-Wolfen (Mitglied im Beirat)  
 Sontor GmbH, Bitterfeld-Wolfen (Mitglied im Beirat)  
 Westsächsische Hochschule Zwickau (Kuratoriumsmitglied)

**Peter Heinz**                                    Waterbury, Vermont, USA, Geschäftsführer i.R., bis 19. Juni 2008

weitere Mandate:                            H&H Associates Inc., Waterbury, Vermont, USA (Mitglied im Aufsichtsrat)  
 Image Technology Inc., Palo Alto, Kalifornien, USA (Mitglied im Board)

- Prof. Dr. Anton Heuberger** München, Professor an der TU CAU Kiel, bis 19. Juni 2008
- Heinz-Peter Verspay** Köln, Rechtsanwalt in der Kanzlei Hecker, Werner, Himmelreich & Nacken, Köln, bis 19. Juni 2008
- weitere Mandate: Lang Audiovision AG, Lindlar (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  
Pharma Benchmark AG, Köln (Mitglied im Aufsichtsrat)  
Advent Solar AG, Köln (Mitglied im Aufsichtsrat)  
World Timers Association AG, Bergisch Gladbach (Mitglied im Aufsichtsrat)
- Dr. Franz Richter** Eichenau, Vorstand der Thin Materials AG in Eichenau, Aufsichtsratsvorsitzender ab 19. Juni 2008
- Weitere Mandate: Siltronic AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats)  
EpiSpeed AG, Zug, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)  
Replisaurus Technologies, Inc., Kista, Schweden (Chairman of the Board of Directors)  
Semi International, San Jose, Kalifornien, USA (Member of the Board of Directors)
- Dr. Stefan Reineck** Kirchartd, Geschäftsführer der Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender ab 19. Juni 2008
- weitere Mandate: AttoCube Systems AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  
NanoScape AG, Martinsried (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  
aleo solar Aktiengesellschaft, Prenzlau (Mitglied im Aufsichtsrat)  
TF Instruments Inc., Monmouth Junction, New Jersey, USA  
(Member of the Board of Directors)  
Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA (Member of the Board of Directors)  
Johanna Solar Technology GmbH, Brandenburg an der Havel (Beiratsvorsitzender)
- Jan Teichert** Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau / Isar, ab 19. Juni 2008

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält außer dem Ersatz seiner ihm bei Wahrnehmung seines Amtes entstandenen Auslagen eine feste Vergütung pro Geschäftsjahr. Gemäß der Satzungsänderung vom 19. Juni 2008 erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats € 45.000 p. a., sein Stellvertreter € 40.000 p. a. und das weitere Mitglied des Aufsichtsrats € 35.000 p. a. Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen Teil des Geschäftsjahres an, bestimmt sich die Vergütung pro rata temporis. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von € 1.500 für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse.

Im Einzelnen setzen sich die Aufsichtsratsvergütungen für das abgelaufene Geschäftsjahr wie folgt zusammen:

<b>2008</b>					
in €	Zeitraum der Zugehörigkeit	Feste Vergütung	Sitzungsgeld	Auslagenersatz und Umsatzsteuer	<b>Gesamt</b>
Dr. Winfried Süß	bis 19.06.2008	22.500,00	10.500,00	0,00	33.000,00
Gerhard Rauter	bis 19.06.2008	11.250,00	3.000,00	412,00	14.662,00
Peter Heinz	bis 19.06.2008	7.500,00	4.500,00	4.338,08	16.338,08
Prof. Dr. Anton Heuberger	bis 19.06.2008	7.500,00	3.000,00	3.385,00	13.885,00
Heinz-Peter Verspay	bis 19.06.2008	7.500,00	3.000,00	2.156,25	12.656,25
Dr. Franz Richter	ab 19.06.2008	22.500,00	9.000,00	25.416,83	56.916,83
Dr. Stefan Reineck	ganzjährig	27.500,00	19.500,00	20.521,46	67.521,46
Jan Teichert	ab 19.06.2008	17.500,00	9.000,00	5.086,00	31.586,00

Im Vorjahr setzten sich die Aufsichtsratsvergütungen wie folgt zusammen:

<b>2007</b>					
in €	Zeitraum der Zugehörigkeit	Feste Vergütung	Sitzungsgeld	Auslagenersatz und Umsatzsteuer	<b>Gesamt</b>
Dr. Winfried Süß	ganzjährig	–	–	0,00	0,00
Gerhard Rauter	ganzjährig	22.500,00	22.500,00	2.684,87	47.684,87
Dr. h.c. Horst Görtz	bis 30.09.2007	11.250,00	19.500,00	9.202,91	39.952,91
Peter Heinz	ganzjährig	15.000,00	13.500,00	9.923,94	38.423,94
Prof. Dr. Anton Heuberger	ganzjährig	15.000,00	10.500,00	7.649,93	33.149,93
Dr. Stefan Reineck	ab 01.10.2007	3.750,00	1.500,00	997,50	6.247,50
Dr. Christoph Schücking	bis 06.07.2007	7.500,00	9.000,00	3.983,38	20.483,38
Heinz-Peter Verspay	ab 06.07.2007	7.500,00	6.000,00	0,00	13.500,00

Aus seiner Zeit als Geschäftsführer der heutigen Süss MicroTec Lithography GmbH besteht für Herrn Dr. Süß, dem Aufsichtsratsvorsitzenden bis zum 19. Juni 2008, zum Bilanzstichtag eine Pensionsrückstellung in Höhe von T€ 2.025 (2007: T€ 1.871).

## Aktien- und Optionsbestände der Organmitglieder zum Jahresende:

in T€	2008		2007	
	Aktien	Optionen	Aktien	Optionen
Dr. Stefan Schneidewind (bis 2.10.2008)	18.278	150.000	18.278	150.000
Michael Knopp	22.500	30.000	5.000	30.000
Christian Schubert (ab 2.10.2008)	0	0	–	–
Dr. Winfried Süß (bis 19.06.2008)	–	–	1.131.000	0
Dr. Franz Richter (ab 19.06.2008)	101.040	0	–	–
Jan Teichert (ab 19.06.2008)	0	0	–	–
Gerhard Rauter (bis 19.06.2008)	–	–	0	0
Dr. h.c. Horst Görtz (bis 30.09.2007)	–	–	17.216	0
Peter Heinz (bis 19.06.2008)	–	–	1.338	0
Dr. Christoph Schücking (bis 06.07.2007)	–	–	500	0
Prof. Dr. Anton Heuberger (bis 19.06.2008)	–	–	0	0
Heinz-Peter Verspay (bis 19.06.2008)	–	–	0	0
Dr. Stefan Reineck	6.600	40.000	1.600	40.000

## (37) Mitarbeiter

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 699 Mitarbeiter (2007: 753 Mitarbeiter) in der SÜSS-Gruppe beschäftigt.

Stand am Jahresende:

	2008	2007
Verwaltung	91	98
Marketing und Vertrieb	267	283
Produktion und Technik	316	350
<b>Summe</b>	<b>674</b>	<b>731</b>

Abweichend zum Vorjahr sind in der Mitarbeiterzahl des Berichtsjahres Vorstände und Auszubildende nicht enthalten. Der Ausweis der Vorjahreszahlen wurde nicht angepasst. Bei analoger Ermittlung der Mitarbeiterzahl hätte sich für das Vorjahr eine Zahl von 709 Mitarbeitern zum Jahresende bzw. von 735 Mitarbeitern im Jahresdurchschnitt ergeben.

### (38) Honorare des Abschlussprüfers

Der im Geschäftsjahr 2008 für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erfasste Honoraraufwand nach § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB beträgt T€ 425 (2007: T€ 340) und setzt sich wie folgt zusammen:

in T€	2008	2007
Abschlussprüfung	296	297
Steuerberatung	51	2
Sonstige Leistungen	78	41
<b>Gesamt</b>	<b>425</b>	<b>340</b>

Die Position Abschlussprüfung enthält das gesamte Honorar für die Jahresabschlussprüfung der SÜSS MicroTec AG sowie die Konzernabschlussprüfung und die durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschlüsse von Tochtergesellschaften.

In der Position Steuerberatung ist das Honorar für die steuerliche Beratung der SÜSS MicroTec AG in ausgewählten steuerlichen Einzelfragen enthalten.

Wesentlicher Inhalt der sonstigen Leistungen sind Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung von SAP.

### (39) Corporate Governance

Wie bereits in den Vorjahren haben Vorstand und Aufsichtsrat am 7. November 2008 die Entsprechungserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 14. Juni 2007 mit zwei Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D & O-Versicherung und Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern – entsprechen haben und zukünftig der aktualisierten Fassung vom 6. Juni 2008 mit drei Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D & O-Versicherung, Bildung von Ausschüssen und Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern – entsprechen werden. Die Erklärung ist im Internet unter [www.suss.com](http://www.suss.com) dauerhaft zugänglich gemacht.

### (40) Angabe gemäß § 160 Nr. 8 AktG

Im Geschäftsjahr wurden gegenüber der Gesellschaft folgende Mitteilungen gemäß § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 32 Abs. 2 InvG gemacht:

Am 22. Februar 2008 hat uns Herr Tito Tettamanti, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 19. Februar 2008 die Schwelle von 10 % überschritten hat und zu diesem Tag 10,34 % beträgt (1.760.491 Stimmrechte von 17.019.126 Stimmrechten). Davon sind ihm 10,34 % (1.760.491 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die ihm

zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands.

Am 22. Februar 2008 hat uns die Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 19. Februar 2008 die Schwelle von 10 % überschritten hat und zu diesem Tag 10,34 % beträgt (1.760.491 Stimmrechte von insgesamt 17.019.126 Stimmrechten).

Am 18. März 2008 hat uns Herr Tito Tettamanti, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG nachfolgende Korrekturen seiner bereits erfolgten Stimmrechtsmitteilungen mitgeteilt:

In Korrektur meiner Mitteilung vom 12. November 2007 teile ich hiermit gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mit, dass mein Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 12. November 2007 die Schwelle von 3 % überschritten hat und an diesem Tag 3,99 % (678.431 Stimmrechte) betrug. Davon waren mir 3,99 % (678.431 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Mir zugerechnete Stimmrechte wurden dabei über folgende von mir kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Gritlot Limited, Douglas, Isle of Man
- + Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands

In Korrektur meiner Mitteilung vom 20. Dezember 2007 teile ich hiermit gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mit, dass mein Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 19. Dezember 2007 die Schwelle von 5 % überschritten hat und an diesem Tag 8,53 % (1.451.567 Stimmrechte) betrug. Davon waren mir 8,53 % (1.451.567 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Mir zugerechnete Stimmrechte wurden dabei über folgende von mir kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Gritlot Limited, Douglas, Isle of Man
- + Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands

In Korrektur meiner Mitteilung vom 21. Februar 2008 teile ich hiermit gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mit, dass mein Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 19. Februar 2008 die Schwelle von 10 % überschritten hat und an diesem Tag 10,34 % (1.760.491 Stimmrechte) betrug. Davon waren mir 10,34 % (1.760.491 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Mir zugerechnete Stimmrechte wurden dabei über folgende von mir kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Gritlot Limited, Douglas, Isle of Man
- + Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands

Am 18. März 2008 hat uns die Gritlot Limited, Douglas, Isle of Man, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG nachfolgende Stimmrechtsmitteilungen mitgeteilt:

Hiermit teilen wir gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mit, dass unser Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 12. November 2007 die Schwelle von 3 % überschritten hat und an diesem Tag 3,99 % (678.431 Stimmrechte) betrug. Davon



waren uns 3,99 % (678.431 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Uns zugerechnete Stimmrechte wurden dabei über folgende von uns kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands

Hiermit teilen wir gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mit, dass unser Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 19. Dezember 2007 die Schwelle von 5 % überschritten hat und an diesem Tag 8,53 % (1.451.567 Stimmrechte) betrug. Davon waren uns 8,53 % (1.451.567 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Uns zugerechnete Stimmrechte wurden dabei über folgende von uns kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands

Hiermit teilen wir gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mit, dass unser Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 19. Februar 2008 die Schwelle von 10 % überschritten hat und an diesem Tag 10,34 % (1.760.491 Stimmrechte) betrug. Davon waren uns 10,34 % (1.760.491 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Uns zugerechnete Stimmrechte wurden dabei über folgende von uns kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands

Am 29. April 2008 hat uns die Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA, Köln, Deutschland, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG folgende Korrektur ihrer Stimmrechtsmitteilung vom 5. März 2007 mitgeteilt:

In Korrektur unserer Mitteilung vom 5. März 2007 teilen wir hiermit gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mit, dass unser Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 27. Februar 2007 die Schwelle von 5 % unterschritten hat und an diesem Tag 0 % (0 Stimmrechte) betrug.

Am 7. Juli 2008 hat uns Herr Tito Tettamanti, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 2. Juli 2008 die Schwelle von 15 % überschritten hat und zu diesem Tag 15,02 % beträgt (2.555.569 Stimmrechte von 17.019.126 Stimmrechten). Davon sind ihm 15,02 % (2.555.569 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die ihm zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Gritlot Limited, Douglas, Isle of Man
- + Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands

Am 7. Juli 2008 hat uns die Gritlot Limited, Douglas, Isle of Man, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 2. Juli 2008 die Schwelle von 15 % überschritten hat und zu diesem Tag 15,02 % beträgt (2.555.569 Stimmrechte von insgesamt 17.019.126 Stimmrechten). Davon sind ihr 15,02 % (2.555.569 Stimmrechte)

nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die ihr zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

+ Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands

Am 7. Juli 2008 hat uns die Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 2. Juli 2008 die Schwelle von 15 % überschritten hat und zu diesem Tag 15,02 % beträgt (2.555.569 Stimmrechte von insgesamt 17.019.126 Stimmrechten).

Am 23. Oktober 2008 hat uns Herr Tito Tettamanti, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 22. Oktober 2008 die Schwelle von 20 % überschritten hat und zu diesem Tag 20,073 % beträgt (3.416.191 Stimmrechte von 17.019.126 Stimmrechten). Davon sind ihm 20,073 % (3.416.191 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die ihm zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

+ Gritlot Limited, Douglas, Isle of Man

+ Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands

Am 23. Oktober 2008 hat uns die Gritlot Limited, Douglas, Isle of Man, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 22. Oktober 2008 die Schwelle von 20 % überschritten hat und zu diesem Tag 20,073 % beträgt (3.416.191 Stimmrechte von insgesamt 17.019.126 Stimmrechten). Davon sind ihr 20,073 % (3.416.191 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die ihr zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

+ Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands

Am 23. Oktober 2008 hat uns die Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 22. Oktober 2008 die Schwelle von 20 % überschritten hat und zu diesem Tag 20,073 % beträgt (3.416.191 Stimmrechte von insgesamt 17.019.126 Stimmrechten).

Am 7. Januar 2009 hat uns Herr Dr. Winfried Süß, Deutschland, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 31. Dezember 2008 die Schwellen von 5 % und 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 0 % beträgt (0 Stimmrechte).

Am 7. Januar 2009 hat uns die Süß SCS, Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 31. Dezember 2008 die Schwellen von 3 % und 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 7,53 % beträgt (1.281.000 Stimmrechte).

Am 7. Januar 2009 hat uns die Falcivest, SCS, Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 31. Dezember 2008 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,04 % beträgt (518.194 Stimmrechte).

Am 7. Januar 2009 hat uns die Falcinvest, SCS, Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 2. Januar 2009 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,99 % beträgt (508.194 Stimmrechte).

Am 7. Januar 2009 hat uns die Terramater (Stichting), Amsterdam, Niederlande, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 31. Dezember 2008 die Schwellen von 3 %, 5 % und 10 % überschritten hat und zu diesem Tag 10,57 % beträgt (1.799.194 Stimmrechte). Davon werden ihr 10,57 % (1.799.194 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet. Die der Terramater zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Süss SCS, Strassen, Luxemburg
- + Falcinvest, SCS, Strassen, Luxemburg

Am 7. Januar 2009 hat uns die Crest Capital S.A., Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 31. Dezember 2008 die Schwellen von 3 %, 5 % und 10 % überschritten hat und zu diesem Tag 10,57 % beträgt (1.799.194 Stimmrechte). Davon werden ihr 10,57 % (1.799.194 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet. Die der Crest Capital S.A. zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten:

- + Süss SCS, Strassen, Luxemburg
- + Falcinvest, SCS, Strassen, Luxemburg

Am 23. Januar 2009 hat uns die Falcinvest, SCS, Strassen, Luxemburg, gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2009 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,02 % beträgt (513.194 Stimmrechte).

#### (41) Freigabe des Abschlusses

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG hat den IFRS Konzernabschluss am 10. März 2009 zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Konzernabschluss zu prüfen und zu erklären, ob er den Konzernabschluss billigt.

Garching, 10. März 2009

Der Vorstand



Frank Averdung



Michael Knopp



Christian Schubert

## BILANZEID

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Garching, 10. März 2009



Frank Averdung



Michael Knopp



Christian Schubert

# BESTÄTIGUNGSVERMERK

## des Abschlussprüfers

Wir haben den von der Süss MicroTec AG, Garching, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang – sowie ihren Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, den 12. März 2009

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Renner  
Wirtschaftsprüfer

Jenuwein  
Wirtschaftsprüfer

# GLOSSAR

## 3D-Integration

3D-Integration unterteilt sich in zwei Hauptkategorien: das 3D-Packaging und 3D-Interconnect. 3D-Packaging bezeichnet Bauteile, die auf Wafer Level Packaging-Ebene gestapelt werden ohne durch sogenannte „Through Silicon Vias“ (TSVs) miteinander verbunden zu sein. Unter 3D-Packaging werden Technologien wie SOC (Systems-on-Chip) sowie weitere Verfahren subsummiert, bei denen die Verbindung üblicherweise auf Wire-Bonding („Drahtbonden“) basiert. 3D-Interconnect beinhaltet dagegen Bauteile die durch „Through Silicon Vias“ (TSVs) verbunden sind. Dabei handelt es sich um vertikale Durchkontaktierungen durch das in der Regel stark gedünnte massive Silizium.

## 300mm-Technologie

Wafer sind runde Scheiben z.B. aus einkristallinem Reinst-Silizium, das als Grundmaterial für die Herstellung von Mikrochips dient. Der allergrößte Teil (~42 %) der heute weltweit verwendeten Silizium-Scheiben hat einen Durchmesser von 300 Millimeter. Je größer der Durchmesser des Wafers, umso größer ist auch die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können. Je höher die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können, desto geringer sind die Produktionskosten pro individuellem Chip.

## Advanced Packaging

Mit dem Begriff „Packaging“ wird die Technologie des „Verpackens“ von Mikrochips in Gehäuse bezeichnet. Dabei müssen alle Anschlusskontakte des Mikrochips einzeln auf die Außenseite des Gehäuses geführt werden, um dann die Verbindung zur Leiterplatte zu gewährleisten. Unter „Advanced Packaging“ versteht man weiterentwickelte Packagingverfahren, die in der Regel Methoden einsetzen, die bisher nur bei der Herstellung der Mikrochips selbst, also im sogenannten „Frontend“ der Chipfertigung eingesetzt wurden. Als Beispiel können hier Lithografie und Fotoresist-Techniken genannt werden.

## Backend

„Backend“ bezeichnet den zweiten (hinteren) Teil der Fertigungskette in der Mikrochipfertigung. Nachdem der Wafer sämtliche Prozessschritte zur Herstellung des eigentlichen Mikrochips durchlaufen hat (Frontend), beginnt der Backend-Prozess. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet und ggf. für das Bonden vorbereitet. Danach werden die Wafer in die einzelnen Mikrochips zersägt und diese werden in Gehäuse „verpackt“. Aus Kostengründen findet der Backend-Prozess überwiegend in Asien statt, wo die Halbleiterhersteller eigene Backend-Werke betreiben oder Test und Packaging bei Drittfirmen (Foundries) durchführen lassen.

## Bonden

Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen oder Wafern mithilfe verschiedener chemischer und physikalischer Effekte, z. B. bedeutet „adhesives Bonden“ das Verkleben zweier Bauteile durch Klebstoffe (meistens Epoxidharze oder Fotoresist); „Fusion Bond“ oder „Direct Bond“ ist das direkte Verbinden zweier Wafer, die zunächst nur durch die schwachen atomaren Kräfte von Wassermolekülen in der Grenzschicht (van-der-Waals-Kräfte) miteinander verbunden werden. Durch ein anschließendes Ausheizen werden die Wassermoleküle aufgebrochen und die frei werdenden Sauerstoffatome verbinden sich mit Siliziumatomen des Wafers zu Siliziumoxid (kovalente Bindung). Diese Bindung stellt eine sehr feste, nichtlösbare Verbindung der beiden Wafer dar.

## Bump

(engl.: Unebenheit); Metallische (Lot, Gold, o.Ä.), dreidimensionale Kontaktstelle auf einem Chip. Kann vereinfacht auch als Lotkügelchen auf einem einzelnen Anschlusskontakt eines Mikrochips bezeichnet werden.

## Chip

Allgemeiner Begriff für Halbleiterbauelemente. In der Elektronik versteht man unter einem Chip oder Mikrochip den IC (Integrated Circuit), der in ein Gehäuse eingebettet ist. Von außen sieht man in der Regel nur das schwarze Gehäuse und die Anschlussstelle, mit denen der Chip mit der Leiterplatte verbunden wird (durch Wire- oder Flip-chip-Bonding). Als Chip oder Mikrochip wird häufig aber auch nur das Stück Silizium bezeichnet, das im Gehäuse sitzt.

## Cluster

Eine Gerätegruppe von einzelnen Prozessmodulen (z. B. Coater, Aligner), die von einem zentral angeordneten Roboter mit den zu bearbeitenden Wafern bestückt wird.

## Coater (Beschichtungsgerät)

Coater sind Spezialmaschinen für die Halbleiterfertigung, die einen fotoempfindlichen Lack mittels Rotationskraft auf dem Wafer verteilen.

## Compound Semiconductor

Siehe Verbindungshalbleiter.

### Cost of Ownership (CoO)

Bewertet Anschaffungs- und Betriebskosten sowie die Kosten für Reinraumfläche, Verbrauch und Wartung der Maschinen. Diese Kosten werden dann in Bezug auf den Anteil funktionsfähiger Bauteile am Ende des Herstellungsverfahrens berechnet. Je höher die Ausbeute an perfekten Chips, desto besser ist die „Cost of Ownership“ der Maschinen für den Kunden. Eine hervorragende CoO ist besonders im Rahmen der Massenproduktion von großer Bedeutung.

### C4NP

IBM hat in den späten sechziger Jahren den Weg für das Flip-Chip-Bonding bereitet. Zum ersten mal wurde diese Technologie 1973 in dem „IBM System 3“ eingesetzt. Seither wurden unter dem Namen „IBM C4“ Milliarden Chips in diesem Verfahren mit der Außenwelt kontaktiert. „C4“ steht für „Controlled Collapse Chip Connection“ und wird teilweise auch synonym für Flip-Chip-Bonding verwendet. „C4NP“ ist die Technologie der nächsten Generation, die IBM gemeinsam mit SÜSS MicroTec auf Basis des bewährten C4-Prozesses entwickelt hat. „NP“ steht dabei für New Process.

### Die

„Die“, „IC“ (Integrated Circuit), „Chip“ sind oft synonym verwendete Begriffe. „Die“ heißen die ICs, solange sie noch nicht in das Gehäuse integriert wurden. Solange der Wafer also die einzelnen Prozessschritte durchläuft, spricht man von Dies. Erst nach dem Vereinzeln und Verpacken der Dies spricht man von „Chips“.

### DRAM

DRAM=Dynamic Random Access Memory. Elektronischer Speicherbaustein, der hauptsächlich in Computern eingesetzt wird. Weltweit verbreitetster Speicherchip.

### Fab

(engl.: Fabrik); Fabriken, die sich auf die Produktion von ICs auf Wafern (Chips) spezialisiert haben. Die Errichtung einer großen modernen Fab mit den erforderlichen Reinräumen und Maschinen (Equipment) kostet heute von ca. 1,5 bis zu 4 Milliarden US Dollar.

### Flip-Chip-Bonding

Fortschrittliche Verbindungstechnik zwischen Mikrochip und Chipgehäuse, die höhere Taktfrequenzen bei der Signalübertragung ermöglicht. Die aktive Chipseite zeigt dabei nach unten, d.h. der Chip muss vor der Montage umgedreht (engl.: to flip) werden.

### Fotoresist

Lichtempfindliches Material, das zunächst als Schicht auf den Wafer aufgetragen wird und dann mithilfe von UV-Licht durch eine Maske hindurch belichtet wird. An den belichteten Stellen werden durch das UV-Licht chemische Veränderungen erzeugt. Diese Teilbereiche werden während der Entwicklung aus der Schicht herausgelöst, so dass eine reliefartige Struktur im Fotoresist entsteht. Dieser Prozess ist dem in der Fotografie sehr ähnlich.

### Foundry

Eine Fabrik zur Chipherstellung, in der Mikrochips nach einem vom Kunden vorgegebenen Design der Schaltkreise gefertigt werden. Es handelt sich somit um eine Art Auftragsfertigung. Da den Foundry-Betreibern keine Kosten für das Chipdesign sowie für den Vertrieb und das Marketing ihrer Produkte entstehen, können sie ihre F&E-Ressourcen vollständig auf die Prozesstechnologie konzentrieren. Die weltweit führenden Foundries sind in Taiwan und Singapur angesiedelt.

### Frontend

Frontend-Prozesse sind sämtliche Produktionsschritte, die der Wafer als Ganzes durchläuft. Hier wird der Chip an sich hergestellt. Danach schließt sich das Backend an. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet, der Wafer anschließend in die einzelnen Chips zersägt, die dann mit einem Gehäuse versehen werden.

### Halbleiter

Einkristalliner Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand sich durch das Implantieren von Fremdatomen in das Kristallgitter verändern lässt. Silizium ist das wichtigste und am häufigsten vorkommende Halbleiterelement. Auch ICs aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

### IC

Integrated Circuit. Ein integrierter Schaltkreis besteht aus elektronischen Bauelementen wie Transistoren, Widerständen und Kondensatoren, die auf engstem Raum auf einem Mikrochip integriert sind. Heute werden viele zehn Millionen solcher Zellen auf einem Chip integriert und miteinander verschaltet. Die hohe Integrationsdichte von Mikrochips hat zu einer enormen Leistungsfähigkeit der Chips geführt.

**LED**

Light Emitting Diode. Leuchtdioden sind Halbleiterbauteile, die Licht erzeugen können. LEDs leuchten sehr hell und verbrauchen gleichzeitig sehr wenig Energie. Darüber hinaus haben sie eine mehr als zehnfach so große Lebensdauer wie eine normale Glühlampe.

**Lithografie**

Die elektrischen Schaltkreise der ICs werden durch Strukturierung einzelner Ebenen auf einem Siliziumwafer in einer Art Schichtenaufbau hergestellt. Um die sehr kleinen Strukturen in den einzelnen Schichten zu erzeugen, wird der Wafer mit einem lichtempfindlichen Material (Fotoresist) beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske belichtet. Die Strukturen auf der Maske werden so mittels Schattenwurf auf den Wafer aufgebracht. An Stellen, an denen die Maske lichtundurchlässig ist, wird der Fotoresist auf dem Wafer nicht belichtet. An lichtdurchlässigen Stellen der Maske fällt Licht auf den Wafer und der Fotoresist wird belichtet. Während der Entwicklung im Anschluss an die Belichtung werden die Stellen des Fotoresists, die durch die transparenten Stellen der Maske belichtet wurden, aus der Schicht herausgelöst und der Wafer wird an diesen Stellen freigelegt. Typische Strukturgrößen für Lithografieanwendungen im Frontend liegen heute in einer Größenordnung von 32nm (0,032 Mikrometer) bis 0,6 Mikrometer. Im Backend werden Strukturgrößen von einigen Mikrometern bis einigen zehn Mikrometern fotolithografisch erzeugt, z.B. um die Bumps für das Flip-Chip-Bonding herzustellen.

**Maske**

Eine teiltransparente Platte aus Glas oder Quarzglas, auf der die Muster abgebildet sind, die zur Herstellung eines ICs benötigt werden. Die Muster bestehen aus durchsichtigen und undurchsichtigen Bereichen entsprechend der Größe und Form der gewünschten Schaltkreise.

**Mask Aligner (Belichtungsgerät)**

Mask Aligner richten eine Glasmaske submikrometergenau zu einem Wafer aus. Das mikroskopische Bild auf der Glasmaske wird mittels Belichtung auf den belackten Wafer übertragen.

**MEMS**

Micro Electro Mechanical System. MEMS ist der vor allem in Nordamerika verwendete Begriff für die Mikrosystemtechnik (MST, in Europa gebräuchlicher). Fertigungstechnologien und Prozesse der Halbleiterfertigung werden eingesetzt, um mechanische und andere nichtelektronische Elemente herzustellen. MEMS-Produkte werden beispielsweise in der Automobilindustrie, der Telekommunikation, der Optoelektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

**Mikrometer/Mikron**

Metrisches Längenmaß. Symbol:  $\mu\text{m}$ . Ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter. Zur Veranschaulichung: Der Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt ca. 60  $\mu\text{m}$ .

**Mikrosystem**

Ein aus verschiedenen Bauteilen, die in der Dimension unterhalb eines Millimeters liegen, zusammengesetztes System.

**Mikrosystemtechnik**

Je nach Region gibt es die unterschiedlichsten Definitionen des Begriffs. In Europa wird damit die gesamte Verkleinerung von Bauteilen aus der Feinwerktechnik in den Bereich von Strukturen unterhalb eines Millimeters verstanden. In den USA und Asien bedeutet Mikro System Technology oder der häufiger verwendete Begriff Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) den Einsatz von Techniken der Halbleiterelektronik zur Erzeugung kleinster Sensoren oder aber auch komplexer Systeme, wie z.B. einer kompletten chemischen oder biologischen Analyseeinheit. MEMS-Baugruppen sind z.B. der Beschleunigungssensor aus Silizium, er wird zum Auslösen des Airbags eingesetzt, oder aber die Düse in der Patrone des Tintenstrahldruckers.

**Nanoimprinting/ Nano Imprint Lithografie (NIL)**

Ein mechanisches Verfahren, mit dem zwei- oder dreidimensionale Strukturen im Nanometerbereich mit einem Abformwerkzeug oder Stempel hergestellt werden. Im Gegensatz zur fotolithografischen Erzeugung von Schaltungen auf Halbleiter Wafern werden die Strukturen durch „Stempeln“ in einem weichen Kunststoff vorgegeben. Man erhofft sich vom Nanoimprinten in der Zukunft einen Preisvorteil, weil die Fortsetzung der Fotolithografie in Richtung höchste Auflösung extrem kurze Wellenlängen der Lichtstrahlung (EUV, Röntgen) benötigen wird und das entsprechende Equipment unangemessen teuer zu werden droht.

**Nanotechnologie**

(Griech.: nānos = Zwerg) ist ein Sammelbegriff für eine breite Auswahl von Technologien, die sich mit Strukturen und Prozessen im Größenbereich von einem bis mehrere hundert Nanometer befassen. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter ( $10^{-9}$  m) und bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die typischen Abmessungen von einzelnen Molekülen liegen. Nanotechnologie ist eine konsequente Fortsetzung und Erweiterung der Mikrotechnik mit meist völlig unkonventionellen neuen Ansätzen: Die Nanotechnologie beschäftigt sich damit, Werkstoffe und Strukturen im Nanometer-Bereich zu schaffen.

**Optoelektronik**

Durch das gezielte Kombinieren von Technologien der Halbleiterelektronik mit sogenannten III/V-Materialien wie z.B. Galliumarsenid kann Licht erzeugt oder detektiert werden (Halbleiterlaser, LED, Fotodioden etc.). Diese Technologie



wird hauptsächlich in der Telekommunikation für die Übertragung sehr großer Datenmengen (Faseroptische Netze) eingesetzt. Allerdings finden LEDs wegen ihrer vielen Vorteile wie des geringen Energiebedarfs, der sehr hohen Helligkeit und der sehr langen Lebensdauer zunehmend Verwendung im Automobilbau und im Haushalt.

#### Packaging Foundries

Siehe Backend.

#### Prober (Test- und Prüfsysteme)

Prober führen individuelle analytische Tests von Mikrochips durch. Mithilfe von Mess-Spitzen werden elektrische Signale von mikroskopisch kleinen Strukturen innerhalb des Chips aufgegriffen und ausgewertet. Oder Belastungstests mittels Druck, Strom, Kraft, Hitze oder Kälte zeigen, ob die Chips den Anforderungen gerecht werden, und weisen frühzeitig auf Fehler hin. Der modulare Aufbau unserer Prober macht diese äußerst flexibel, was insbesondere in Entwicklungsprojekten sehr geschätzt wird.

#### Sensor

Ein Bauteil zum Erfassen und Umwandeln von Messgrößen wie Temperatur, Druck oder Beschleunigung. Diese Größe wird in ein elektrisches Signal gewandelt und an eine Signalauswertungseinheit weitergegeben.

#### Silizium

Werkstoff mit dem Aufbau eines Kristallgitters mit halbleitenden Eigenschaften. Halbleitend bedeutet, dass je nach Einbau von bestimmten Fremdatomen der Werkstoff als elektrischer Leiter oder als Nichtleiter verwendet werden kann. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in Form von Scheiben eines Einkristalls als der wesentliche Grundstoff verwendet.

#### Substrat Bonder (Verbindungsgerät)

Der Substrat Bonder verbindet zwei oder mehr äußerst präzise zueinander ausgerichtete Substrate, meist Wafer, durch Löten, Kleben oder andere physikalisch-chemische Verfahren miteinander. Viele MEMS-Bausteine benötigen diesen Prozessschritt. Erst dann können unsere Airbags, Reifendruckensoren, GPS-Sensoren, Tintenstrahldrucker, etc. funktionieren.

#### Systems-on-Chip

Hochkomplexe ICs, die viele verschiedene Funktionen enthalten. Bis vor Kurzem musste man diese noch auf mehreren ICs unterbringen. Die gewaltige Innovationskraft in der Prozesstechnik, die die Fertigung von ICs mit immer kleineren Strukturbreiten erlaubt, ermöglicht heute, dass auf einem Chip verschiedene Sorten von Speichern, digitale Signalprozessoren und analoge Funktionen untergebracht werden können. Vorteil hiervon ist, dass anstatt vieler Chips nur noch sehr wenige oder ein einzelner erforderlich ist und sich so der Platzbedarf, der Montageaufwand (und damit

die Kosten des Endprodukts) und, was sehr wichtig ist, die Leistungsaufnahme verringern. In batteriebetriebenen Geräten (Notebooks, Handys) verlängert sich so die Lebensdauer der Batterien. Der Trend zu immer kleineren und mobilen Geräten, die zudem immer günstiger werden sollen, verleiht Systems-on-Chips immer größere Wichtigkeit.

#### Through-Silicon-Vias (TSVs)

Bei der „Through-Silicon-Vias“-Technik werden die einzelnen Chip-Komponenten übereinander gestapelt und mittels vertikaler Durchkontaktierungen („Through-Silicon-Vias“) miteinander verbunden. Dadurch verkürzt sich der Weg des Datenstroms zwischen den einzelnen Chipkomponenten und lassen sich Kapazitätsverluste wesentlich reduzieren. Through-Silicon-Vias tragen somit zu einer Verringerung der Baugröße von Chips bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsfähigkeit bei.

#### Tool

Maschinen, Werkzeuge, Roboter usw. Tools sind alle Einzelsysteme, die in einer Halbleiterfabrik zur einer Produktionslinie kombiniert werden.

#### Verbindungshalbleiter

Halbleiter, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzen (Galliumarsenid, Indiumphosphid, Siliziumgermanium etc.). Vorteile gegenüber einfachen Elementhalbleitern: Verbindungshalbleiter sind besonders schnell und können auch bei sehr hohen Temperaturen arbeiten und verbrauchen trotzdem weniger Energie als einfache Siliziumchips.

#### Wafer

Runde Scheiben z.B aus Reinst-Silizium oder Verbindungshalbleitern (Galliumarsenid, Indiumphosphid etc.), auf denen Chips produziert werden. In den letzten zehn Jahren hat sich der Durchmesser von 150 über 200 auf heute sogar 300 Millimeter vergrößert. Auf die Grundfläche der neuesten 300mm-Wafer passen doppelt so viele Chips wie auf einen 200mm-Wafer – die Produktionskosten sind dadurch ca. 30 % niedriger.

#### Wire-Bonding

Gängiges Kontaktverfahren, um Chips über Metalldrähte mit einem Gehäuse zu verbinden.

#### Yield

Die Ausbeute – ist eine der wesentlichen Kenngrößen in der Halbleiterfertigung. Sie bezeichnet die Ausbeute der funktionsfähigen Mikrochips im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer. Je höher der Yield, desto effektiver und kostengünstiger ist die Chipproduktion für den Kunden.

# FINANZKALENDER 2009

Geschäftsbericht 2008	26. März 2009
SCF – Small Cap Forum, Frankfurt	28. – 29. April 2009
Quartalsbericht 2009	07. Mai 2009
Analystenkonferenz, Hotel Hessischer Hof, Frankfurt	07. Mai 2009
Hauptversammlung, Haus der Bayerischen Wirtschaft, München	24. Juni 2009
Halbjahresfinanzbericht 2009	06. August 2009
Neunmonatsbericht 2009	05. November 2009
Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt	09. – 11. November 2009

## Impressum

Herausgeber: SÜSS MicroTec AG  
Redaktion: Investor Relations, Finance  
Wirtschaftsprüfer: KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Aktiengesellschaft,  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Konzept und Gestaltung: IR-One AG & Co., Hamburg  
Druck: Hartung Druck + Medien GmbH, Hamburg

## Kontakt

SÜSS MicroTec AG  
Schleißheimer Straße 90  
85748 Garching, Deutschland  
Fon: +49 (0)89-32007-0  
E-Mail: [info@suss.com](mailto:info@suss.com)

### Investor Relations

Fon: +49 (0)89-32007-161  
E-Mail: [ir@suss.com](mailto:ir@suss.com)

**Zukunftsorientierte Aussagen:** Die Jahresberichte enthalten zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der SÜSS MicroTec AG. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.

# HIGHLIGHTS 2008

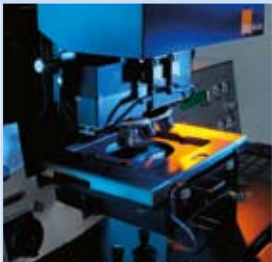
JAN



## Suss MicroTec Lithography besteht ISO-Zertifizierung mit Bravour

Die Suss MicroTec Lithography GmbH wird für die erfolgreiche Einführung ihres Qualitätsmanagement-Systems nach ISO 9001 vom TÜV Süd ausgezeichnet. Das ISO-Zertifikat stellt einen Beleg für die gleichbleibend hohe Qualität der Produktionsabläufe in den Werken Garching bei München sowie Vaihingen an der Enz dar, die damit höchsten internationalen Standards entsprechen.

MRZ



## Neues Nano Imprint Lithografie-Tool (NIL) erstmals vorgestellt

SÜSS MicroTec stellt das erste Nano Imprint Lithografie-Tool (NIL) der Fachöffentlichkeit vor. Das neue NIL-Tool, das mit geringem Aufwand auf alle manuellen Mask Aligner von SÜSS MicroTec nachgerüstet werden kann, ermöglicht Kunden den kostengünstigen Einstieg in die Welt der Nanostrukturierung und damit die Prägung von Strukturen die kleiner 100nm sind.

APR



## SÜSS MicroTec schließt Lizenzvereinbarung mit Philips Research

SÜSS MicroTec schließt Lizenzvereinbarung mit Philips Research zum exklusiven Vertrieb der SCIL-Technologie („Substrate Conformal Imprint Lithography“) ab. SCIL stellt eine neue Technologie zum Prägen von Nanostrukturen im sub-50nm-Bereich dar. Das entsprechende Zubehör kann auf jeden manuellen Mask Aligner von SÜSS MicroTec nachgerüstet werden.

## SÜSS MicroTec installiert weltweit erstes 300mm WLR Test System bei japanischem Hersteller

Das weltweit erste 300mm WLR-Testsystem (WLR – Wafer Level Reliability) von SÜSS MicroTec wird bei einem führenden japanischen Halbleiterhersteller installiert. Das speziell für Zuverlässigkeitsprüfungen entwickelte Testsystem PM300WLR ermöglicht Prüfvorgänge bereits auf Wafer-Ebene und damit noch vor der Verpackung des Bauteils, was zu einer Verkürzung der Durchlaufzeiten sowie zu einer Reduzierung des Ausschusses auf Ebene der Bauteile beiträgt.

JUN



## Hauptversammlung – Neuwahlen Aufsichtsrat

Am 19. Juni 2008 stimmt die ordentliche Hauptversammlung der Verkleinerung des Aufsichtsrats auf nunmehr drei Mitglieder zu und wählt die vorgeschlagenen Kandidaten Dr. Franz Richter, Dr. Stefan Reineck und Jan Teichert mit großer Mehrheit in den Aufsichtsrat. Dr. Winfried Süß hat im Zuge dieser turnusmäßig anstehenden Neuwahlen des Aufsichtsrats sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats nach mehr als 50 Jahren Tätigkeit und Engagement für SÜSS MicroTec altersbedingt niedergelegt.

JUL



## SÜSS MicroTec stellt 300mm Mask Aligner für 3D-Packaging vor

SÜSS MicroTec stellt die zweite Generation des MA300 Produktions-Mask Aligners auf der SEMICON West in San Francisco dem Fachpublikum vor. Das mit einer höheren Leistungsfähigkeit ausgestattete 300mm-System bietet neben einer hochpräzisen Vorderseitenjustage auch eine Rückseiten- und Infrarot (IR)-Justage, wodurch die Verarbeitung von beidseitig strukturierten Wafer, wie sie im 3D-Packaging vorkommen, ermöglicht wird.

## Going live SAP-System

Planmäßig zum 1. Juli 2008 werden die ersten drei deutschen Gesellschaften der SÜSS MicroTec-Gruppe auf das neue SAP-System umgestellt. Insgesamt acht Systemmodule von der Finanzbuchhaltung bis zum Life Cycle-Management wurden in nur sechs Monaten auf SÜSS angepasst und erfolgreich an den Standorten implementiert.

AUG



## SÜSS MicroTec hält am Geschäftsbereich Test Systeme weiter fest

SÜSS MicroTec teilt mit, dass das Unternehmen nach eingehender Prüfung weiterhin an seinem Geschäftsbereich Test Systeme festhält. Der Vorstand hatte trotz des schwierigen Investitionsklimas strategische Optionen zur möglichen Trennung von dem Geschäftsbereich geprüft.

## SÜSS MicroTec bietet CB Wafer Bonder Serie für Advanced MEMS an

SÜSS MicroTec kündigt CB Serie mit halb- und vollautomatischen Wafer Bonder für den Advanced MEMS-Markt der Automobil- und Elektronikindustrie an. Die neue CB Wafer Bonder-Serie ist speziell auf die Anwendungen des Metall-Bondens ausgerichtet, indem es extremen Druck- und Temperaturverhältnissen von 90kN bzw. bis zu 600°C standhält.

OKT



**Christian Schubert zum neuen Vorstandsmitglied ernannt**

Dr. Stefan Schneidewind wurde mit sofortiger Wirkung vom Aufsichtsrat aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens abberufen. Der Diplom-Kaufmann Christian Schubert wird mit Wirkung zum 2. Oktober 2008 in den Vorstand der SÜSS MicroTec AG berufen.

**SÜSS MicroTec stellt Mask Aligner für großflächige Nanoimprinting-Lithografie vor**

SÜSS MicroTec stellt erstmals einen manuellen Mask Aligner mit integrierter Funktionalität für großflächige Nanoimprinting-Lithografie vor. Die gemeinsam mit Philips Research und MiPlaza im niederländischen Eindhoven entwickelte Technologie SCIL (Substrate Conformal Imprint Lithography) ermöglicht erstmals das großflächige Prägen von Strukturen < 200 nm.

**Neuer manueller Mask Aligner der nächsten Generation für die industrielle Forschung vorgestellt**

SÜSS MicroTec bringt die dritte Generation des MA/BA8 auf den Markt. Der neue manuelle Mask und Bond Aligner verfügt über eine speziell für die Belichtung dicker Resist-Schichten entwickelte Belichtungsoptik und eignet sich darüber hinaus für die Verarbeitung nahezu aller Arten von Wafer- und Substratmaterialien. Darüber hinaus kann er schnell und einfach für die Anforderungen neuer Technologien wie UV-Nanoimprinting, Mikrolinslithografie, UV-Bonden und erweiterte Bond-Justage umgerüstet werden.

SEP



**US-Tochter schließt ISO-Zertifizierung erfolgreich ab**

Die Süss MicroTec Inc., Waterbury, schließt als ein weiteres Tochterunternehmen der SÜSS MicroTec-Gruppe erfolgreich die international anerkannte Zertifizierung nach ISO 9001 ab. Nach der Zertifizierung der Süss MicroTec Lithography GmbH im Januar des Jahres hat damit auch der amerikanische Entwicklungs- und Produktionsstandort die Zuverlässigkeit sowie die Prozess- und Systemorientierung des SÜSS-weiten Qualitätsmanagements bestätigt.

**SÜSS MicroTec führt XBC Wafer Bonder für CMOS-Bildsensoren ein**

SÜSS MicroTec stellt die neue 300mm Wafer Bonder-Produktserie speziell für die Herstellung von CMOS-Bildsensoren auf der SEMICON Taiwan vor. Der neue XBC300 zeichnet sich durch einen hohen Durchsatz sowie die Fähigkeit aus, eine Reihe von Bond-Prozessen auf der aktuell marktweit kleinsten Stellfläche auszuführen.

NOV



**Frank P. Averdung zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen**

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG beruft Frank P. Averdung in den Vorstand der Gesellschaft. Der Geschäftsführer der Carl Zeiss SMS (Semiconductor Metrology Systems) soll spätestens zum 1. Juni 2009 das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernehmen.

DEZ



**Süss MicroTec Test Systeme gibt strategische Allianz bekannt**

Süss MicroTec Test Systems, Dresden, schließt eine strategische Allianz mit MPI Corporation und Chain Logic International Corporation, Taiwan, zur Optimierung des Produkt- und Serviceangebots für den Halbleitertestbereich ab. Die strategische Geschäftsbeziehung umfasst sowohl eine weltweite Vertriebspartnerschaft für Halbleitertestanlagen und -produkte als auch ein zukünftig bilaterales Outsourcing im Bereich Forschung und Entwicklung von Test Systemen.

SÜSS MicroTec AG  
Schleißheimer Straße 90  
85748 Garching, Deutschland  
Fon: +49 (0)89-32007-0  
E-Mail: [info@suss.com](mailto:info@suss.com)

[www.suss.com](http://www.suss.com)